

证券代码：688484

证券简称：南芯科技



上海南芯半导体科技股份有限公司

Southchip Semiconductor Technology (Shanghai) Co.,Ltd.
(中国(上海)自由贸易试验区盛夏路 565 弄 54 号(4 幢)1601)

向不特定对象发行可转换公司债券

募集说明书

摘要



保荐机构（主承销商）

 **中信建投证券股份有限公司**
CHINA SECURITIES CO.,LTD.
(北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)

二〇二六年六月

声 明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读募集说明书相关章节。

一、不满足投资者适当性要求的投资者所持本次可转债不能转股的风险

公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人将不能将其所持的可转债转换为公司股票。

公司本次发行可转债设置了赎回条款，包括到期赎回条款和有条件赎回条款，本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债；有条件赎回价格为面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在所持可转债面临赎回的情况下，考虑到其所持可转债不能转换为公司股票，如果公司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格（或成本），投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。

公司本次发行可转债设置了回售条款，包括有条件回售条款和附加回售条款，回售价格为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在满足回售条款的前提下，公司可转债持有人要求将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司，公司将面临较大可转换公司债券回售兑付资金压力并存在影响公司生产经营或募集资金投资项目正常实施的风险。

二、公司本次发行的可转换公司债券未提供担保

公司本次发行的可转债未提供担保措施。如果本次可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而增加风险。

三、关于公司本次发行可转换公司债券的信用评级

中证鹏元对本次可转债进行了评级，根据中证鹏元出具的信用评级报告，公司主体信用等级为“AA+sti”，本次可转债信用等级为“AA+sti”，评级展望为稳定。

在本次发行的可转债存续期间，评级机构将对公司主体和本次可转债进行跟踪评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素导致公司或本次可转债的信用评级级别发生变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。

四、特别风险提示

公司提请投资者仔细阅读募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以下风险：

（一）公司业绩下滑的风险

尽管报告期内全球模拟芯片市场保持增长，但是受地缘政治和国际贸易摩擦的影响，全球经济增长预期或将放缓，终端消费市场需求难以大幅提振，全球同行业公司竞争持续加剧，对公司经营产品产生不利影响，从而带来公司营业收入和利润无法持续增长、甚至下滑的风险。

2025年度，公司实现营业收入326,053.93万元，同比增长27.01%；实现归属于母公司所有者的净利润23,860.02万元，同比下降22.26%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润19,979.95万元，同比下降33.45%，主要系公司充分把握市场机遇加大投入拓展产品品类，人员数量增加导致薪酬费用和研发投入增长，叠加相关投入的效益释放存在一定周期，最终导致公司最近一期净利润出现下滑。

报告期内，公司与同行业可比公司营业收入金额如下：

单位：万元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
圣邦股份	389,805.46	334,698.31	261,571.64
杰华特	265,502.48	167,875.07	129,674.87

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
纳芯微	336,782.31	196,027.42	131,092.72
思瑞浦	214,209.13	121,953.82	109,351.91
艾为电子	285,353.14	293,292.99	253,092.15
发行人	326,053.93	256,720.99	178,040.23

报告期内，公司与同行业可比公司的净利率比较情况如下：

项目	2025 年	2024 年度	2023 年度
圣邦股份	14.03%	14.95%	10.73%
杰华特	-27.01%	-35.94%	-40.98%
纳芯微	-6.80%	-20.55%	-23.29%
思瑞浦	8.08%	-16.17%	-3.17%
艾为电子	11.11%	8.69%	2.02%
可比公司平均	-0.12%	-9.81%	-10.94%
发行人	7.32%	11.95%	14.68%

注：净利率=归母净利润/营业收入。

报告期内，虽然公司营业收入规模均实现了持续增长、净利润的总体表现良好，最近一年营业收入规模、净利率均处于同行业可比公司的较高水平，但 2025 年度公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润出现了同比下滑。

2026 年一季度，公司实现营业收入 75,707.95 万元，同比增长 10.48%；实现归属于母公司所有者的净利润 333.83 万元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 132.66 万元，同比下降超过 30%。其中：①公司主营业务未出现重大不利变化，营业收入、主营业务毛利额、其他业务毛利额均实现同比增长；②由于公司持续高强度研发投入，且随着业务规模扩大、员工人数大幅增长、职工薪酬特别是研发人员薪酬随之增加等因素，短期内费用增速超过营业收入和营业毛利增速，对盈利表现产生了直接影响，而相关投入的效益释放存在一定周期，故在相关因素叠加影响下，公司 2026 年一季度净利润水平有所下降。

如果随着未来市场竞争加剧，公司无法通过产品迭代、精细化管理等方式改善产品毛利、优化成本费用，或是前期研发投入的效益释放不及预期，则可能会导致公司未来经营业绩持续承压、导致业绩继续下滑的风险。

（二）市场竞争加剧的风险

中国是全球最大的模拟芯片消费市场，随着新技术和产业政策的双轮驱动，未来中国模拟芯片需求也愈发旺盛。目前，全球模拟芯片市场由德州仪器等欧美厂商主导，该等欧美厂商占据了我国模拟芯片行业的高端产品市场，凭借在资本、平台、研发等方面的优势，对国内试图进入中高端产品市场的企业造成较大的竞争压力。面对该等头部厂商的竞争压力，对于性能相似的产品，公司可能采取为客户提供更佳性价比的策略获取订单，存在因此导致产品利润水平和现金流承压的风险。此外，近年来国内模拟芯片厂商数量增多，行业竞争加剧，公司可能面临盈利能力下降的风险。

（三）商誉减值风险

报告期内，公司收购珠海昇生微形成商誉 17,351.48 万元。珠海昇生微产品主要面向可穿戴、消费、工业等端侧设备市场，具有庞大的应用潜力和增长前景。

2025 年度，昇生微商誉及所在资产组对应的营业收入为 9,167.26 万元。昇生微采用 Fabless 模式经营，属于典型的轻资产高研发投入型公司，该类企业由于要投入大额的研发投入和流片费用，其发展的前期基本处于亏损或接近盈亏平衡状态。

根据《企业会计准则》的规定，本次收购形成的商誉将每年进行减值测试。未来若由于市场竞争加剧、原材料供应短缺或价格上涨、下游市场需求萎缩以及重要客户合作关系等因素发生变化，导致珠海昇生微相关业务的经营效益受到挤压，有可能出现经营业绩不及预期的情况，则会导致商誉减值的风险，并将对公司未来的当期损益造成不利影响。

（四）公司产品毛利率波动风险

报告期各期，公司综合毛利率分别为 42.30%、40.12%和 37.74%，存在毛利波动的情况，整体略有下降。公司主要产品毛利率主要受下游需求、产品售价、产品结构、材料及加工成本及公司技术水平等多种因素影响。若出现行业复苏情况不及预期，出现地缘政治不稳定或市场竞争加剧等对下游市场不利的情况，则不排除公司毛利率出现进一步下降的风险，如果公司不能通过持续进行技术迭代、优化产品结构以及降低产品单位成本等方法优化毛利率水平，可能导致公司毛利

率下降，从而影响公司的盈利能力及业绩表现。

（五）募集资金投资项目相关风险

1、募投项目建设进度不及预期的风险

公司本次募集资金投资的建设项目包括智能算力领域电源管理芯片研发及产业化项目、车载芯片研发及产业化项目、工业应用的传感及控制芯片研发及产业化项目，是在发行人现有业务的基础上依据业务发展规划所制定的。虽然公司根据行业发展现状和趋势对本次募投项目可行性进行了深入研究和充分论证，并在技术、人员、市场等方面作了较为充分的准备，但若出现募集资金不能及时到位、项目延期实施、市场或产业环境出现重大变化等情况，可能导致项目实施过程中的某一环节出现延误或停滞，公司募投项目存在不能全部按期建设完成的风险。

2、募投项目实施、新产品的市场开拓不及预期的风险

公司本次募投项目中，智能算力领域电源管理芯片研发及产业化项目、车载芯片研发及产业化项目、工业应用的传感及控制芯片研发及产业化项目将使公司新进入智能算力领域，并在车载芯片、工业传感控制芯片领域推出新产品。虽然该等募投项目是围绕公司主营业务，在目前现有产品线与既有业务上进行的产品升级、迭代及拓展，与公司现有业务高度关联并具有较强的协同效应，但若未来募投项目实施、新产品的市场开拓、以及相关产品验证进度不及预期或下游客户的采购需求不及预期，可能存在募投项目短期内无法盈利的风险，进而对公司整体经营业绩产生不利影响。

3、募投项目新增研发费用影响公司利润的风险

公司本次募集资金投资项目中包含规模较大的研发费用支出和一定的资本性支出。项目的实施主要会导致公司未来研发费用增长，虽然公司已对本次募集资金投资项目进行了较为充分的市场调查及可行性论证，但鉴于未来行业发展趋势、下游客户需求以及市场竞争情况等存在不确定性，在本次募投项目对公司经营整体促进作用体现之前，公司存在因研发费用增加而导致利润下降的风险。

4、募投项目效益不达预期的风险

公司对本次募投项目智能算力领域电源管理芯片研发及产业化项目、车载芯片研发及产业化项目、工业应用的传感及控制芯片研发及产业化项目进行了效益测算，待项目建设完成并达产后，预计可获得较好的经济效益。本次募投项目效益测算是基于项目如期建设完毕并按计划投产后实现销售，因此若项目建设进度不及预期、产品价格或成本出现大幅波动或者未来行业技术发展趋势出现重大变化，可能对本次募投项目的效益释放带来一定影响，募投项目可能面临短期内不能实现预测收入和利润的风险。同时，由于下游客户实际采购需求和本次募投项目的测算可能存在差距，如果本次募投项目的销售进展无法达到预期，可能导致本次募投项目面临营业收入和利润总额等经营业绩指标下滑，投资回报率降低的风险。

（六）产品研发及技术创新风险

公司所处行业下游应用领域快速发展，因此公司需要对市场变化及主流技术迭代趋势保持较高的敏感度，制定动态的技术发展战略。未来若公司技术研发水平落后于行业升级换代水平，将导致公司研发资源浪费并错失市场发展机会，对公司产生不利影响。

（七）核心技术泄密风险

公司核心技术贯穿公司产品研发设计及生产的过程，对公司控制生产成本、改善产品性能和质量至关重要，是公司的核心竞争力。如果出现核心技术保护不利或核心技术人员外流导致关键技术外泄、被盗用、或被竞争对手模仿的情形，则可能对公司的技术创新、业务发展乃至经营业绩将会产生不利影响。

（八）研发人员流失的风险

集成电路设计企业通常需要长期培养研发设计人员、搭建经验丰富的设计团队，并不断引进优秀的设计人才，伴随着市场竞争的日趋激烈，行业内公司对于研发人才的竞争不断加剧。如果未来公司出现薪酬水平缺少竞争力、人力资源管理及内部晋升制度得不到有效执行、缺乏有效的股权激励措施等情形，将难以引进更多的优秀技术人才，甚至导致现有骨干技术人员流失，进而对公司技术研发产生不利影响。

五、关于应对本次发行摊薄即期回报的应对措施及相关主体的承诺

（一）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

为保护广大投资者的合法权益，降低本次发行可能摊薄即期回报的影响，公司拟采取多种措施保证本次发行募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险，增强公司持续回报能力。公司填补即期回报的具体措施如下：

1、持续发展公司主营业务，把握行业发展机遇

本次发行的募集资金投资项目是在公司现有技术优势的基础上，进一步拓展公司在主营业务领域的竞争能力。募集资金使用计划已经管理层、董事会的详细论证，符合国家相关的产业政策和公司整体发展战略，是公司把握行业发展机遇，加强核心业务优势的重要举措。

2、稳健推进募投项目建设，助力公司业务发展

本次募投项目均围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策和行业发展趋势，其顺利实施将增强公司的盈利能力及核心竞争实力，优化公司的资本结构，提升公司的影响力。

本次募集资金到位前，公司将积极调配资源，充分做好募投项目开展的筹备工作；募集资金到位后，公司将提高资金使用效率，稳健推进募投项目的实施，争取募投项目早日实现预期效益，从而提高公司的盈利水平，降低本次发行导致的即期回报被摊薄的风险，维护全体股东的长远利益。

3、加强募集资金管理，确保募集资金规范有效使用

为规范公司募集资金的管理和运用，切实保护投资者利益，公司已经制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户储存、使用管理、投向变更等方面进行了明确规定。本次发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的募投项目、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

4、持续完善公司治理、提升公司经营管理水平

公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上

市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。公司将进一步加强经营管理和内部控制，全面提升经营管理水平，提升经营和管理效率，控制经营和管理风险。

5、完善利润分配政策，强化投资者回报机制

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，公司已制定了健全有效的利润分配政策和股东回报机制。公司将严格执行《公司章程》等相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，结合公司经营情况与发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。上述填补回报措施的实施，有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，增厚未来收益，填补股东回报。由于公司经营所面临的风险客观存在，上述填补回报措施的制定和实施，不等于对公司未来利润做出保证。

(二) 相关主体对公司填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关要求，为维护广大投资者的利益，公司就本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体情况如下：

1、控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东、实际控制人对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的填补措施事宜，郑重作出以下承诺：

“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、切实履行公司制定的有关填补回报相关措施以及对此作出的任何有关填

补回报措施的承诺，如本人违反前述承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

3、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，如中国证券监督管理委员会、上交所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求，且上述承诺不能满足证券监管机构该等新的监管规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。”

2、董事、高级管理人员承诺

公司全体董事、高级管理人员对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行事宜，郑重作出以下承诺：

“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益；

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、承诺支持公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、承诺若公司实施股权激励的，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本人切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

7、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、上交所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会、上交所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会、上交所的最新规定出具补充承诺。”

目 录

声 明	1
重大事项提示	2
一、不满足投资者适当性要求的投资者所持本次可转债不能转股的风险	2
二、公司本次发行的可转换公司债券未提供担保	2
三、关于公司本次发行可转换公司债券的信用评级	3
四、特别风险提示	3
五、关于应对本次发行摊薄即期回报的应对措施及相关主体的承诺	8
第一节 释义	13
一、一般释义	13
二、专业术语释义	14
第二节 本次发行概况	18
一、发行人基本情况	18
二、本次发行的背景和目的	18
三、本次发行基本情况	21
四、本次发行的有关机构	37
五、发行人与本次发行有关中介机构及其相关人员之间的关系	39
第三节 发行人基本情况	40
一、本次发行前的股本总额及前十名股东的持股情况	40
二、公司控股股东、实际控制人基本情况	40
第四节 财务会计信息与管理层分析	42
一、最近三年及一期审计意见类型及重要性水平	42
二、最近三年及一期财务报表	42
三、发行人财务报表的编制基础、合并报表的范围及变化情况	50
四、主要财务指标及非经常性损益明细表	52
五、会计政策变更、会计估计变更及重大会计差错更正	54
六、主要税种和税率	56
七、财务状况分析	59
八、盈利能力分析	83
九、现金流量分析	99

十、资本性支出分析	101
十一、技术创新分析	103
十二、重大担保、诉讼或仲裁、其他或有事项和重大期后事项对发行人的影响	106
十三、本次发行对发行人的影响情况	107
十四、经营业绩下滑的相关情况	108
第五节 本次募集资金运用	115
一、本次发行募集资金使用计划	115
二、募集资金投资项目的基本情况及可行性分析	116
三、本次募集资金投资于科技创新领域的说明，以及募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式	136
第六节 备查文件	138

第一节 释义

在本募集说明书摘要中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：

一、一般释义

《可转换公司债券募集说明书》、募集说明书	指	《上海南芯半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
本次发行	指	上海南芯半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的行为
发行人、南芯科技、公司	指	上海南芯半导体科技股份有限公司
南芯有限	指	上海南芯半导体科技有限公司，发行人前身
北京南芯	指	南芯科技（北京）有限公司
珠海楠欣	指	珠海楠欣半导体科技有限公司
深圳楠欣	指	深圳楠欣半导体科技有限公司
浙江南芯	指	浙江南芯半导体有限公司
珠海昇生微	指	珠海昇生微电子有限责任公司
深圳万感芯	指	深圳万感芯科技有限公司
成都万智芯	指	成都万智芯科技有限公司
珠海揽芯	指	珠海揽芯科技有限公司
深圳科萨微	指	深圳市科萨微电子有限责任公司
上海昇生微	指	昇生微电子（上海）有限责任公司
成都昇生微	指	昇生微电子（成都）有限责任公司
辰木信息	指	上海辰木信息技术合伙企业（有限合伙）
源木信息	指	上海源木信息技术合伙企业（有限合伙）
闰木信息	指	上海闰木信息技术合伙企业（有限合伙）
新加坡南芯	指	Southchip Semiconductor Technology Pte. Ltd.
新加坡贸易	指	Southchip Semiconductor Trading Pte. Ltd.
韩国南芯	指	Southchip Semiconductor korea Ltd.
夸克国贸	指	POWERQUARK SEMICONDUCTOR INTERNATIONAL TRADINGPTE. LTD
美国南芯	指	Southchip US Inc.
星核有限	指	SparkCore Limited
德国南芯	指	Southchip Technik Deutschland GmbH

香港南芯	指	Southchip HK Limited
奥地利南芯	指	Southchip Technik GmbH
嘉善瑞芯鸿	指	嘉善瑞芯鸿信息技术合伙企业（有限合伙）
Frost & Sullivan	指	弗若斯特沙利文咨询公司，是一家全球化的企业增长咨询公司，研究板块覆盖了信息和通讯技术、汽车与交通、航空航天等各个细分板块
境内	指	中华人民共和国境内区域，就本募集说明书摘要而言，不包括中国台湾地区、中国香港特别行政区及中国澳门特别行政区
境外	指	境内以外的国家和地区
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
保荐机构、保荐人、 中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
律师、锦天城律师	指	上海市锦天城律师事务所
会计师、容诚会计师	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构、中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2023 年度、2024 年度、2025 年度
报告期各期末	指	2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、专业术语释义

DC-DC	指	Direct Current - Direct Current，是将直流电转换为直流电的一种技术和方法，可实现升压或降压功能
AC-DC	指	Alternating Current - Direct Current，是将交流电转换成直流电的一种技术和方法
PD	指	Power Delivery，功率传输，USB-PD 是一种充电协议
Buck	指	开关电源三大基础拓扑之一，Buck 电路是降压电路，其输出平均电压小于输入电压
Boost	指	开关电源三大基础拓扑之一，Boost 电路是升压电路，其输出平均电压大于输入电压
Buck-Boost	指	开关电源三大基础拓扑之一，其输出平均电压大于或小于输入电压
GaN	指	氮化镓，是一种直接能隙的半导体，其较高功率密度意味着在更小的尺寸、更少的元件、更小的系统和更轻的体重的条件下，可实现更高的功率，有助于提供更可靠和更高效的系统

NVDC	指	Narrow Voltage Direct Current, 限定的直流电压, 用于充电器上来限定充电电压值, 以保护电池内部的化学物质
MOSFET	指	Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor, 金属-氧化物半导体场效应晶体管, 简称金氧半场效晶体管, 是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效晶体管
Tx	指	Transmit, 发射
Rx	指	Receive, 接收
MCU	指	Micro Controller Unit 的简称, 即微控制单元, 是把 CPU 的频率与规格作适当缩减, 并将内存、计数器、USB 等周边接口甚至驱动电路整合在单一芯片中, 形成芯片级的计算机
PWM	指	Pulse width modulation, 脉冲宽度调制, 一种模拟控制方式, 根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或 MOS 管栅极的偏置, 来实现晶体管或 MOS 管导通时间的改变, 从而实现开关稳压电源输出的改变
AMOLED	指	Active-matrix organic light-emitting diode, 有源矩阵有机发光二极管, 一种显示屏技术
Type-C	指	一种 USB 接口形式, 特点在于更加纤薄的设计、更快的传输速度以及更强的电力传输。除此之外, Type-C 支持双面都可插入接口的设计
PHY	指	Physical, 端口物理层
BC1.2	指	Battery Charging v1.2, 是 USB-IF 下属的 BC (Battery Charging) 小组制定的协议, 主要用于规范电池充电的需求, 该协议最早基于 USB2.0 协议来实现
UFCS	指	Universal Fast Charging Specification, 电信终端产业协会发布的融合快充标准
SCP	指	Super Charge Protocol, 华为低压大电流快充协议的一种, 可实现 22.5W 和 40W 大功率充电
Fabless	指	无晶圆生产设计企业, 指企业只从事集成电路研发和销售, 而将晶圆制造、封装和测试环节分别委托给专业厂商完成
IDM	指	Integrated Device Manufacturer 的简称, 即垂直整合制造商, 代表涵盖集成电路设计、晶圆制造、封装及测试等各业务环节的集成电路企业
ESD	指	Electro-Static discharge, 静电释放
LDO	指	low dropout regulator, 是一种低压差线性稳压器
PMIC	指	Power Management IC, 电源管理集成电路
SoC	指	System on Chip 的简称, 即片上系统、系统级芯片, 是将系统关键部件集成在一块芯片上, 可以实现完整系统功能的芯片电路
ADAS	指	Advanced Driving Assistance System, 高级驾驶辅助系统
WPC	指	Wireless Power Consortium, 无线充电联盟, 成立于 2008 年 12 月 17 日, 是由多家独立公司组成的合作组织。旨在创造和促进市场广泛采用与所有可再充电电子设备兼容的国际无线充电标准 Qi
BMS	指	Battery Management System, 即电池管理系统, 主要为了智能化管理及维护各个电池单元, 防止电池出现过充电和过放电, 延长电池的使用寿命, 监控电池的状态
集成电路、芯片、IC	指	Integrated Circuit 的简称, 是采用一定的工艺, 将一个电路中所

		需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线连在一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构
模拟集成电路	指	由电阻、电容、晶体管等组成的模拟电路集成在一起，用来处理连续函数形式模拟信号（如声音、光线、温度等）的集成电路
晶圆	指	经过特定工艺加工，具备特定电路功能的硅半导体集成电路圆片，经切割、封装等工艺后可加工制作各种电路元件结构，成为有特定电性功能的集成电路产品
封装	指	将芯片转配为最终产品的过程，即把晶圆上的半导体集成电路，用导线及各种连接方式，加工成含外壳和管脚的可使用的芯片成品，起着安放、固定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用
测试	指	集成电路晶圆测试及成品测试
嵌入式、嵌入式系统	指	以应用为中心、以计算机技术为基础、软件硬件可裁剪、适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗严格要求的专用计算机系统
电荷泵	指	也称为开关电容式电压变换器，是一种利用电容，而非电感或变压器来储能的直流变换器，能使输入电压升高或降低，也可以用于产生负电压。其内部的 MOSFET 开关阵列以一定的方式控制快速电容器的充电和放电，使输入电压以一定因数倍增或降低，从而得到所需要的输出电压
原边	指	电压的输入侧
副边	指	电压的输出侧
反激（Flyback）	指	当开关管接通时，输出变压器充当电感，电能转化为磁能，此时输出回路无电流；相反，当开关管关断时，输出变压器释放能量，磁能转化为电能，输出回路中有电流。反激控制器用于将交流电转换为稳定、隔离的直流电以供给应用系统
同步整流	指	采用通态电阻极低的专用功率 MOSFET，来取代整流二极管以降低整流损耗的一项新技术，可以提高转换器的效率
电容器	指	一类电子元器件，两个相互靠近的导体，中间夹一层不导电的绝缘介质，就构成了电容器
开关充电	指	充电器的电流断续注入电池，电流恒定大小，但却是充电、停止交替进行，这种充电方式称为充电的“开关模式”
线性充电	指	充电器的电流持续注入电池，但电流会随着电池电压的不断上升而线性地减小，这种充电方式称为充电的“线性模式”
版图设计	指	将电路设计电路图或电路描述语言映射到物理描述层面，从而可以将设计好的电路映射到晶圆上生产
处理内核	指	通常指计算机系统中负责执行指令和处理数据的核心部分
先进 PID	指	通常是指在传统 PID 控制基础上进行了改进、优化或拓展，以提升性能、适用性等的 PID 控制技术。PID 即比例-积分-微分控制器，是一种常见的控制算法，广泛应用于工业控制等领域
模糊控制	指	模糊控制是一种基于模糊集合论、模糊语言变量及模糊逻辑推理的计算机智能控制技术。其核心是将人的控制经验（通常以自然语言形式表达）转化为计算机可处理的算法，通过模糊化、推理和解模糊化等步骤实现对复杂系统的控制
Limp home	指	跛行模式，指汽车的电控设备出现故障的时候，一开始主要集中于发动机控制和变速箱单片机，在模块或者传感器信号出现故障的时候，模块仍旧能够完成基本的功能，使得汽车仍能以最低要求的性能水平行驶

德州仪器	指	TI (Texas Instruments), 德州仪器, 全球领先的半导体公司之一
亚德诺	指	ADI (Analog Devices, Inc.), 亚德诺半导体技术有限公司, 全球领先的半导体公司之一
意法半导体	指	ST (STMicroelectronics), 意法半导体有限公司, 全球领先的半导体公司之一
英飞凌	指	Infineon, 英飞凌科技公司, 全球领先的半导体公司之一
艾迈斯	指	AMS AG, 艾迈斯半导体, 是一家全球领先的高性能传感器解决方案供应商。该公司专注于光学、图像及音频传感器的研发与制造, 为智能手机、汽车、工业、医疗等多个领域提供传感器及相关解决方案
博通	指	Broadcom, 美国博通公司, 一家全球领先的半导体和基础设施软件解决方案供应商
威世	指	Vishay, 是全球知名的电子元器件制造商
东电化	指	TDK 株式会社是一家总部位于日本东京的全球化科技公司, 以材料科学为核心, 专注于电子元件和系统解决方案的研发、生产和销售
博世	指	Bosch (Robert Bosch GmbH) 及其关联的企业, 全球知名企业, 从事汽车与智能交通技术、工业技术、消费品和能源及建筑技术的产业
埃戈罗	指	Allegro (AllegroMicroSystems), 全球传感器和功率集成电路和光子学领域的半导体制造商
鲁棒性	指	robustness 的音译, 用于反映一个系统在面临着内部结构或外部环境的改变时也能够维持其功能稳定运行的能力, 芯片的鲁棒性指其在不同工艺、电压、温度等环境变化下维持稳定运行的能力。

注: 本募集说明书摘要在讨论、分析时, 部分合计数与各数直接相加之和存在尾数差异, 系四舍五入所致。

第二节 本次发行概况

一、发行人基本情况

中文名称	上海南芯半导体科技股份有限公司
英文名称	Southchip Semiconductor Technology (Shanghai) Co., Ltd.
注册资本	42,766.3170 万元（截至报告期末）
股票简称	南芯科技
股票代码	688484
股票上市地	上海证券交易所
法定代表人	阮晨杰
成立日期	2015 年 8 月 4 日
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 565 弄 54 号（4 幢）1601
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 565 弄 54 号（4 幢）1201
邮政编码	201210
公司网址	www.southchip.com
电子信箱	investors@southchip.com
联系电话	021-50182236
联系传真	021-58309622

二、本次发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、AI 算力跃升催生新一代电源方案，国外厂商垄断亟待突破

随着 AI 大模型参数规模从百亿级迈向万亿级、多模态应用（文本+图像+音频+视频）普及，以及边缘 AI 场景（自动驾驶、工业质检等）的渗透，传统算力供给模式已难以满足“高吞吐、低延迟、低能耗”的需求，算力跃升成为 AI 技术落地与产业升级的核心支撑。AI 算力的跃升对包括 CPU、GPU 在内的大芯片提出了更高性能（更高主频/更大算力）的要求，其主板对供电系统的要求也随之升级。因此，传统的供电方案无法满足其需求，行业逐步衍生出多相电源方案及其他大电流场景的供电方案。多相电源方案是较主流的 CPU/GPU 等各类大负载芯片/终端的供电方案，其优势在于通过多相轮流工作可将每一路应力降低，

输出纹波更小、器件更紧凑、效率更高、发热更低。此外，多相电源还可以根据 CPU/GPU 负载实时调整供电相数，既可以满足高负载时的供电需求，也可以在低负载状态下起到节能的作用。

目前大电流场景的供电方案核心供应商以 MPS、英飞凌、瑞萨、AOS 等国际厂商为代表，凭借技术积累、产品成熟度及长期客户合作优势，在市场份额与技术话语权上保持领先。国内部分厂商也已在该领域开始布局，但产品研发到产业化落地仍需要一定时间。从行业趋势来看，随着国内企业在芯片设计、可靠性验证、供应链整合等环节的持续发力，叠加下游终端厂商对供应链安全的重视度提升，后续大电流场景的供电方案的国产替代进程有望加速推进。同时，在 PC、服务器等领域，我国均是全球最主要的消费市场及生产基地，因此，国内电源管理芯片厂商更贴近终端客户，在产品的协同开发、售后响应速度等方面具备优势，市场格局存在进一步优化的空间。

2、汽车芯片市场增长空间广阔，国内厂商目前仍处于追赶阶段

根据中国汽车工业协会统计数据，2025 年，我国新能源汽车产销分别完成 1,662.6 万辆和 1,649 万辆，同比分别增长 29%和 28.2%，连续 11 年位居全球第一，彰显汽车产业蓬勃活力。

新能源汽车渗透率的提升及车辆智能化的发展将持续打开汽车芯片的增长空间，进一步凸显了车载芯片自主化的战略紧迫性。与传统燃油车相比，纯电动车动力系统更多依赖电动机和电动系统，对芯片的需求量也相应提升。另外随着车辆智能化的发展，自动驾驶级别升高，传感器、主控芯片、存储芯片、功率半导体等多类型芯片的搭载量也将随之提升。据统计，L3 级别自动驾驶平均搭载 8 个传感器，而 L5 级别自动驾驶所需传感器芯片数量提升至 20 个。中国汽车工业协会数据显示，传统燃油车所需汽车芯片数量为 600-700 颗，电动车所需数量则提升至 1,600 颗/辆，而智能汽车对芯片的需求量约为 3,000 颗/辆。

据统计，我国汽车芯片行业整体国产化率偏低，各类产品的国产化率均不足 10%，部分品类如计算、控制类芯片国产化率更低。核心原因在于汽车芯片行业准入门槛较高，企业需经过长期技术积淀与生产经验积累才可实现关键技术突破。长期以来，国际大型汽车电子企业如英飞凌、恩智浦、瑞萨、德

州仪器、意法半导体等国际头部汽车电子企业凭借其深厚的技术积累与丰富的产业经验，在全球汽车芯片市场中占据主导地位，国内厂商目前仍处于追赶阶段。

3、传感及控制芯片应用场景持续增加，高端产品受制于海外企业

随着汽车电子、人形机器人、低空经济、AI 终端设备与工业互联网等行业的爆发式增长，下游行业对传感器的需求激增，传感芯片的应用场景也随之增加。

当前，我国传感芯片市场高度依赖进口。核心技术与高端产品供给高度受制于海外企业，各细分领域“卡脖子”问题突出：光传感领域，艾迈斯、博通、威世的环境光、ToF 传感器在工业安全防护、物流智能分拣、精密制造检测、车载电子中市场份额较高；惯性传感领域，东电化、博世、意法半导体的六轴/九轴 IMU，凭借高精度、高可靠性优势几乎垄断高端无人机、工业自动化及汽车电子稳定程序（ESC）、高级辅助驾驶（ADAS）市场；磁传感领域，东电化、英飞凌、埃戈罗的 TMR/AMR 磁阻传感器长期占据高端位置。

国内企业虽已在中低端霍尔开关、简单三轴加速度计等单品上取得突破，但仍在灵敏度、温漂控制、长期稳定性等核心指标上表现不足，与海外高端产品仍存在明显差距，无法满足高端整机厂商的技术要求。导致高端整机厂被迫采用“碎片化”进口模式，需从不同海外厂商采购各类传感芯片，不仅推高了供应链管理成本，更面临地缘政治、贸易摩擦等带来的断供风险，严重制约下游高端制造业的稳定发展。

（二）本次发行的目的

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目为智能算力领域电源管理芯片研发及产业化项目、车载芯片研发及产业化项目、工业应用的传感及控制芯片研发及产业化项目，是在现有主营业务的基础上，结合市场需求和未来发展趋势，加强公司研发实力，加大对公司核心业务领域重点产品及重要研究方向实施的投资。

本次募投项目建成投产后，将有利于丰富公司产品矩阵，打造新的业务增长极，增加技术储备，提升公司核心竞争力。同时，本次发行将有利于进一步优化公司资本结构，提升抗风险能力，有利于促进公司高质量发展。

三、本次发行基本情况

(一) 本次发行的证券类型

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该 A 股可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。

(二) 发行数量、证券面值、发行价格

本次可转债的拟发行数量为 15,868,810 张（含本数），发行规模为不超过人民币 158,688.10 万元（含本数）。本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行。

(三) 预计募集资金量（含发行费用）及募集资金净额、募集资金专项存储的账户

本次可转债发行预计募集资金总额不超过人民币 158,688.10 万元（含本数），募集资金净额将扣除发行费用后确定。公司已建立募集资金管理制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中。

(四) 募集资金投向

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 158,688.10 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金额
1	智能算力领域电源管理芯片研发及产业化项目	45,923.95	39,109.08
2	车载芯片研发及产业化项目	84,334.43	66,363.24
3	工业应用的传感及控制芯片研发及产业化项目	63,079.74	53,215.78
合计		193,338.11	158,688.10

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施的重要性、紧迫性等实际情况先行投入自有或自筹资金，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，经公司股东会授权，公司董事会（或董事会授权人士）将根据募集资金用途的重

要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

（五）发行方式与发行对象

1、发行方式

本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人（主承销商）包销。

2、发行对象

本次可转换公司债券的发行对象如下：

（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 2026 年 6 月 17 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。

（2）网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转换公司债券申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知（2025 年 3 月修订）》（上证发〔2025〕42 号）的相关要求。

（3）本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。

（六）承销方式及承销期

本次发行以余额包销方式承销。本次发行认购金额不足 158,688.10 万元的部分由保荐人（主承销商）包销，包销基数为 158,688.10 万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 47,606.43 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向上交所报告，公告中止

发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

本次可转换公司债券的承销期为 2026 年 6 月 16 日至 2026 年 6 月 25 日。

（七）发行费用

本次发行费用总额预计为 1,312.00 万元（不含增值税），具体明细如下：

- 1、保荐及承销费用：1,150.48 万元；
- 2、审计及评级费用：87.74 万元；
- 3、律师费用：48.12 万元；
- 4、信息披露及发行手续费等费用：25.67 万元。

注：①以上金额均为不含增值税金额；

②各项费用根据发行结果可能会有调整；

③如各项费用之和与发行费用总额不一致，系四舍五入造成。

（八）证券上市的时间安排、申请上市的证券交易所

本次发行期间的主要日程示意性安排如下（如遇不可抗力则顺延）：

交易日	发行安排
T-2 日 (2026 年 6 月 16 日)	刊登《募集说明书》及其摘要、《发行公告》、《网上路演公告》
T-1 日 (2026 年 6 月 17 日)	网上路演；原股东优先配售股权登记日
T 日 (2026 年 6 月 18 日)	刊登《发行提示性公告》；原股东优先配售（缴付足额资金）；网上申购（无需缴付申购资金）；确定网上中签率
T+1 日 (2026 年 6 月 22 日)	刊登《网上中签率及优先配售结果公告》；网上发行摇号抽签
T+2 日 (2026 年 6 月 23 日)	披露《网上中签结果公告》；网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的转债认购资金）
T+3 日 (2026 年 6 月 24 日)	根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4 日 (2026 年 6 月 25 日)	刊登《发行结果公告》

上述日期为交易日，如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。

本次可转债发行承销期间公司股票正常交易，不进行停牌。本次发行可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

（九）本次发行证券的上市流通，包括各类投资者持有期的限制或承诺

本次发行可转换公司债券不设持有期的限制。本次发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转换公司债券在上海证券交易所上市交易，具体上市时间将另行公告。

（十）本次发行的可转换公司债券的基本条款

1、发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。

2、发行数量

本次可转换公司债券拟发行数量不超过 15,868,810 张（含本数）。

3、发行规模

本次可转债的拟发行数量为 15,868,810 张（含本数），发行规模为不超过人民币 158,688.10 万元（含本数）。

4、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。

5、债券期限

本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年，即自 2026 年 6 月 18 日（T 日）至 2032 年 6 月 17 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

6、债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

7、还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

(1) 年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率。

(2) 付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由债券持有人承担。

8、转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2026年6月25日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2026年12月25日，非交易日顺延）起至可转换公司债券到期日（2032年6月17日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

9、转股价格的确定及其调整

（1）初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为43.84元/股，不低于募集说明书公告前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正。

前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量

前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量

（2）转股价格的调整方式和计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$

派送现金股利： $P1=P0-D$

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制定。

10、转股价格向下修正条款

(1) 修正权限与幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

(2) 修正程序

如公司股东会审议通过向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

11、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q 指可转换公司债券的转股数量；V 指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P 指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的公司股份须为整股数。转股时不足转换 1 股的可转换公司债券余额，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定，在转股日后五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额以及该余额对应当期应计利息。

12、赎回条款

(1) 到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。

(2) 有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

上述当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整日及调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

13、回售条款

(1) 有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司，当期应计利息的计算方式参见“12、赎回条款”的相关内容。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

(2) 附加回售条款

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利，当期应计利息的计算方式参见“12、赎回条款”的相关内容。可转换公司债券持有人在满足回售条件后，可以在回售申报期内进行回售，在该次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。

14、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与现有 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

15、发行方式及发行对象

本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人（主承销商）包销。

本次可转换公司债券的发行对象如下：

（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 2026 年 6 月 17 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。

（2）网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转换公司债券申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知（2025 年 3 月修订）》（上证发〔2025〕42 号）的相关要求。

（3）本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。

16、向现有股东配售的安排

（1）发行对象

在股权登记日（2026年6月17日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。

（2）优先配售数量

原股东可优先配售的南芯转债数量为其在股权登记日（2026年6月17日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数量按每股配售3.725元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.003725手可转债。若至本次发行可转债股权登记日（T-1日）公司可参与配售的股本数量发生变化导致优先配售比例发生变化，发行人和保荐人（主承销商）将于申购日（T日）前（含）披露原股东优先配售比例调整公告。

原股东应按照该公告披露的实际优先配售比例确定可转债的可优先配售数量。原股东网上优先配售不足1手部分按照精确算法取整，即先按照优先配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足1手的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可优先配售总量一致。

发行人现有总股本427,663,170股，剔除公司回购专户库存股1,752,889股后，可参与原股东优先配售的股本总额为425,910,281股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为1,586,881手。

（3）原股东的优先认购方法

①优先配售日期

1) 股权登记日：2026年6月17日（T-1日）；

2) 原股东优先配售认购及缴款日：2026年6月18日（T日）在上交所交易系统的正常交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00进行，逾期视为自动放弃优先配售权。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行；

3) 原股东优先配售缴款时间：2026年6月18日（T日）。

②原股东的优先认购方式

所有原股东的优先认购均通过上交所交易系统进行，认购时间为2026年6

月 18 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“726484”，配售简称为“南芯配债”。每个账户最小认购单位为 1 手（10 张，1,000 元），超出 1 手必须是 1 手的整数倍。

若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效申购量获配南芯转债，请投资者仔细查看证券账户内“南芯配债”的可配余额。若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。

原股东持有的“南芯科技”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数，且必须依照上交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。

③原股东的优先认购程序

1) 投资者应于股权登记日收市后核对其证券账户内“南芯配债”的可配余额。

2) 原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。

3) 投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。

4) 投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定办理委托手续。

5) 投资者的委托一经接受，不得撤单。

④若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际申购量获配南芯转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。

(4) 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

17、债券持有人会议相关事项

(1) 可转换公司债券持有人的权利

- 1) 依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；
- 2) 根据可转换公司债券募集说明书约定条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股票；
- 3) 根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行使回售权；
- 4) 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转换公司债券；
- 5) 依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- 6) 按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债券本息；
- 7) 依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- 8) 法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

(2) 可转换公司债券持有人的义务

- 1) 遵守公司所发行的本次可转换公司债券条款的相关规定；
- 2) 依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；
- 3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- 4) 除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；
- 5) 法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转换公司债券持有人承担的其他义务。

(3) 可转换公司债券持有人会议的召开情形

在本次可转债存续期间及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

- 1) 公司拟变更《募集说明书》的约定；

- 2) 拟修改可转换公司债券持有人会议规则;
- 3) 拟变更债券受托管理人或变更受托管理协议的主要内容;
- 4) 公司未能按期支付当期应付的可转换公司债券本息;
- 5) 公司发生减资(因员工持股计划、股权激励或履行业绩承诺导致股份回购的减资,以及为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外)、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化,需要决定或者授权采取相应措施;
- 6) 公司发生分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序;
- 7) 保证人(如有)或担保物(如有)或者其他偿债保障措施发生重大变化;
- 8) 公司、单独或合计持有本次可转债 10%以上未偿还债券面值总额的持有人书面提议召开债券持有人会议;
- 9) 公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性,需要依法采取行动的;
- 10) 公司提出债务重组方案;
- 11) 发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项;
- 12) 根据法律、行政法规、中国证监会、上交所及债券持有人会议规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

(4) 下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议

- 1) 债券受托管理人;
- 2) 公司董事会;
- 3) 单独或合计持有当期可转债 10%以上未偿还债券面值的债券持有人书面提议;
- 4) 相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。

投资者认购、持有或受让本次发行的可转换公司债券,均视为其同意本次发行的可转换公司债券持有人会议规则的规定。

18、本次募集资金用途

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 158,688.10 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金额
1	智能算力领域电源管理芯片研发及产业化项目	45,923.95	39,109.08
2	车载芯片研发及产业化项目	84,334.43	66,363.24
3	工业应用的传感及控制芯片研发及产业化项目	63,079.74	53,215.78
合计		193,338.11	158,688.10

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施的重要性、紧迫性等实际情况先行投入自有或自筹资金，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，经公司股东会授权，公司董事会（或董事会授权人士）将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

19、募集资金管理及存放账户

公司已建立《募集资金管理制度》，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会（或董事会授权人士）确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

20、担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

21、评级事项

中证鹏元对本次发行的可转债进行了评级，根据中证鹏元出具的信用评级报告，主体信用等级为“AA+ sti”，本次可转债信用等级为“AA+ sti”，评级展望为稳定。

在本次发行的可转债存续期间，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级，并出具跟踪评级报告。

22、本次发行方案的有效期限

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期限为十二个月，自发行方案经股东会审议通过之日起计算。

(十一) 违约责任及争议解决机制

1、以下任一事件均构成公司在受托管理协议和本期可转债项下的违约事件

(1) 在本期可转债到期时，公司未能偿付到期应付本金和/或利息；

(2) 公司不履行或违反受托管理协议项下的任何承诺或义务（第（1）项所述违约情形除外）且将对公司履行本期可转债的还本付息产生重大不利影响，在经可转债受托管理人书面通知，或经单独或合并持有本期可转债未偿还面值总额10%以上的可转债持有人书面通知，该违约在上述通知所要求的合理期限内仍未予纠正；

(3) 公司在其资产、财产或股份上设定担保以致对公司就本期可转债的还本付息能力产生实质不利影响，或出售其重大资产等情形以致对公司就本期可转债的还本付息能力产生重大实质性不利影响；

(4) 在本期可转债存续期间内，公司发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的法律程序；

(5) 任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、立法或司法机构或权力部门的指令、法令或命令，或上述规定的解释的变更导致公司在受托管理协议或本期可转债项下义务的履行变得不合法；

(6) 在本期可转债存续期间，公司发生其他对本期可转债的按期兑付产生重大不利影响的情形。

2、违约责任及其承担方式

上述违约事件发生时，公司应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照募集说明书的约定向可转债持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延支付本金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就可转债受托管理人因公司违约事件承

担相关责任造成的损失予以赔偿。

3、可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制

本期可转债发行适用于中国法律并依其解释。本期可转债发行和存续期间所产生的争议，首先应在争议各方之间协商解决；协商不成的，应在公司住所所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。

当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各方有权继续行使本期可转债发行及存续期的其他权利，并应履行其他义务。

(十二) 本次发行公司的审议程序

公司本次发行已经 2025 年 9 月 5 日召开的第二届董事会第九次会议、2025 年 9 月 26 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过。公司本次发行的修订方案已经 2026 年 1 月 12 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过。

四、本次发行的有关机构

(一) 发行人

名称：	上海南芯半导体科技股份有限公司
法定代表人：	阮晨杰
注册地址：	中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 565 弄 54 号（4 幢）1601
办公地址：	中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 565 弄 54 号（4 幢）1201
联系电话：	021-50182236
传真：	021-58309622
董事会秘书：	梁映珍

(二) 保荐机构（主承销商）

名称：	中信建投证券股份有限公司
法定代表人：	刘成
注册地址：	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
联系电话：	021-68801585
传真：	021-68801551
保荐代表人：	周洋、贾兴华
项目协办人：	冯晓松

项目组其他成员：	颜宇程、景浩伟
----------	---------

(三) 律师事务所

名称：	上海市锦天城律师事务所
负责人：	沈国权
注册地址：	上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层
联系电话：	021-20511000
传真：	021-20511999
经办律师：	王立、王倩倩、李贝玲

(四) 会计师事务所

名称：	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：	刘维
注册地址：	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26
联系电话：	010-66001391
传真：	010-66001392
经办注册会计师：	高平、廖传宝、王凤艳、钱明、张玉卿、王爱娣（已离职）

(五) 资信评级机构

名称：	中证鹏元资信评估股份有限公司
法定代表人：	张剑文
注册地址：	深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道 7008 阳光高尔夫大厦 1509
联系电话：	0755-82872897
传真：	0755-82872090
经办评级人员：	董斌、曾彬杰

(六) 申请上市的证券交易所

名称：	上海证券交易所
办公地址：	上海市浦东新区杨高南路 388 号
联系电话：	021-68808888
传真：	021-68804868

（七）证券登记机构

名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：	中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 188 号
联系电话：	021-58708888
传真：	021-58899400

（八）保荐人、主承销商收款银行

收款银行：	中信银行北京京城大厦支行
户名：	中信建投证券股份有限公司
银行账号：	8110701013302370405

五、发行人与本次发行有关中介机构及其相关人员之间的关系

截至 2026 年 4 月 30 日，中信建投证券及子公司共持有发行人 2,434,353 股股票，占发行人本次向不特定对象发行可转换债券前股本比例为 0.57%。

除此之外，截至报告期末，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。

第三节 发行人基本情况

一、本次发行前的股本总额及前十名股东的持股情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司股本总额为 427,663,170 股，公司股本结构如下：

股份类别	股份数量（股）	股份比例（%）
一、有限售条件的流通股股份	132,487,466	30.98
二、无限售条件的流通股股份	295,175,704	69.02
三、股份总数	427,663,170	100.00

截至 2025 年 12 月 31 日，公司前十名股东及其持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量（股）
1	阮晨杰	72,780,573	17.02	72,780,573
2	上海辰木信息技术合伙企业（有限合伙）	51,390,183	12.02	51,390,183
3	上海集成电路产业投资基金股份有限公司	16,695,965	3.9	-
4	香港中央结算有限公司	16,265,053	3.8	-
5	安克创新科技股份有限公司	16,130,128	3.77	-
6	拉萨经济技术开发区顺为资本投资咨询有限公司—杭州顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	13,861,567	3.24	-
7	深圳市瀚辰创业投资基金合伙企业（有限合伙）	12,452,584	2.91	-
8	中信证券股份有限公司—嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	6,790,569	1.59	-
9	全国社保基金四零六组合	6,193,116	1.45	-
10	上海源木信息技术合伙企业（有限合伙）	6,160,526	1.44	6,160,526
	合计	218,720,264	51.14	130,331,282

二、公司控股股东、实际控制人基本情况

（一）控股股东和实际控制人情况

截至 2025 年 12 月 31 日，阮晨杰直接持有公司 17.02% 股份，并担任辰木信息、源木信息的执行事务合伙人，有权代表辰木信息、源木信息行使公司合计 13.46% 股份的表决权，阮晨杰以直接和间接的方式合计控制公司 30.48% 的股份，为公司的控股股东、实际控制人。

阮晨杰先生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为3101151983*****。

(二) 上市以来控股股东、实际控制人变化情况

公司于2023年4月在上海证券交易所科创板上市。公司自上市以来,控股股东、实际控制人均未发生变化。

(三) 控股股东及实际控制人直接或间接持有发行人的股份被质押、冻结或潜在纠纷的情况

截至2025年12月31日,公司控股股东、实际控制人直接或间接持有发行人的股份不存在被质押、冻结或潜在纠纷的情况。

(四) 控股股东、实际控制人对其他企业的投资情况

除发行人及其子公司以外,控股股东及实际控制人对其他企业的投资情况参见募集说明书“第六节 合规经营与独立性”之“四、关联方及关联关系”中的相关内容。

第四节 财务会计信息与管理层分析

公司提请投资者注意，本节分析与讨论应结合公司财务报告和审计报告全文，以及募集说明书的其他信息一并阅读。

一、最近三年及一期审计意见类型及重要性水平

（一）审计意见类型

上市公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了容诚审字[2024]230Z0050 号、容诚审字[2025]230Z0079 号、容诚审字[2026]230Z0371 号标准无保留意见审计报告。

（二）与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准

公司根据自身业务特点和所处行业，从项目性质及金额两方面判断与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平。在判断项目性质重要性时，公司主要考虑该项目的性质是否显著影响公司财务状况、经营成果和现金流量，是否会引起特别的风险。在判断项目金额大小的重要性时，综合考虑该项目金额占总资产、净资产、营业收入、净利润等项目金额比重情况。

二、最近三年及一期财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1,706,161,329.31	1,888,129,168.93	2,876,824,819.04
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	545,434,546.27	1,053,013,212.33	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	439,642,011.95	199,930,266.48	207,203,739.94
应收款项融资	2,817,425.44		

项目	2025年 12月31日	2024年 12月31日	2023年 12月31日
预付款项	12,389,858.36	10,945,521.08	25,344,062.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	330,508,636.10	307,352,177.31	435,031,222.94
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	965,056,838.58	613,564,448.34	525,382,558.41
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	51,006,367.55	29,194,278.63	35,777,218.83
流动资产合计	4,053,017,013.56	4,102,129,073.10	4,105,563,621.90
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	10,388,482.02	9,056,081.06	
其他权益工具投资	33,240,000.00	33,240,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产	333,092,493.50	72,500,000.00	
投资性房地产			
固定资产	415,726,665.56	354,379,416.37	326,410,697.89
在建工程	83,338,261.09	25,800,516.23	777,862.51
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	33,789,507.00	13,075,862.57	10,300,016.50
无形资产	48,950,908.43	9,604,683.46	7,394,008.49
其中：数据资源			
开发支出			

项目	2025年 12月31日	2024年 12月31日	2023年 12月31日
其中：数据资源			
商誉	173,514,848.80		
长期待摊费用	30,384,381.52	7,543,773.49	7,454,161.12
递延所得税资产	3,533,924.22	3,175,949.26	11,877.09
其他非流动资产	15,756,936.53	7,524,229.49	947,629.80
非流动资产合计	1,181,716,408.67	535,900,511.93	356,296,253.40
资产总计	5,234,733,422.23	4,638,029,585.03	4,461,859,875.30
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	15,000,000.00		
衍生金融负债			
应付票据	299,200,000.00	299,200,000.00	434,000,000.00
应付账款	340,815,756.28	209,067,156.99	185,309,842.94
预收款项			
合同负债	2,946,612.55	1,641,301.31	3,649,897.64
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	171,635,198.42	132,630,506.57	89,815,398.42
应交税费	8,656,239.43	7,867,687.21	11,894,533.64
其他应付款	43,555,533.54	31,779,898.74	22,271,747.16
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	20,971,162.96	5,389,206.37	7,208,922.97
其他流动负债	255,282.31	141,860.91	469,629.03
流动负债合计	903,035,785.49	687,717,618.10	754,619,971.80

项目	2025年 12月31日	2024年 12月31日	2023年 12月31日
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	114,000,000.00		
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	14,108,104.45	8,231,518.85	2,591,724.69
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,371,725.00		
递延收益	26,583,151.64	14,222,394.70	5,611,329.04
递延所得税负债	3,933,904.26	148,792.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	159,996,885.35	22,602,705.80	8,203,053.73
负债合计	1,063,032,670.84	710,320,323.90	762,823,025.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	427,663,170.00	425,457,743.00	423,530,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,025,351,308.27	2,913,428,859.81	2,782,773,239.98
减：库存股	53,406,231.91	50,013,489.26	
其他综合收益	-14,377,787.03	2,068,827.65	1,941,489.62
专项储备			
一般风险准备			
盈余公积	125,633,831.28	99,398,283.79	69,581,369.35
未分配利润	665,093,677.18	537,519,051.31	421,210,750.82
归属于母公司所有者权益合计	4,175,957,967.79	3,927,859,276.30	3,699,036,849.77
少数股东权益	-4,257,216.40	-150,015.17	
所有者权益合计	4,171,700,751.39	3,927,709,261.13	3,699,036,849.77
负债和所有者权益总计	5,234,733,422.23	4,638,029,585.03	4,461,859,875.30

（二）合并利润表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	3,260,539,283.45	2,567,209,885.53	1,780,402,270.59
其中：营业收入	3,260,539,283.45	2,567,209,885.53	1,780,402,270.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	3,044,534,773.13	2,229,215,131.56	1,515,691,168.14
其中：营业成本	2,030,169,816.93	1,537,152,670.49	1,027,257,842.31
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	10,415,340.41	9,893,476.97	6,949,693.25
销售费用	133,790,073.73	96,977,089.82	77,925,559.22
管理费用	244,374,149.20	219,983,207.90	153,658,728.01
研发费用	647,145,107.04	436,578,653.27	292,517,099.65
财务费用	-21,359,714.18	-71,369,966.89	-42,617,754.30
其中：利息费用	1,323,393.14	398,100.38	2,873,015.16
利息收入	34,437,969.61	60,758,569.90	43,540,094.03
加：其他收益	21,476,034.48	1,929,018.45	7,335,090.39
投资收益（损失以“-”号填列）	18,063,992.48	2,396,685.81	471,972.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	500,144.56	-943,918.94	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,434,546.27	2,013,212.33	

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,742,470.03	715,214.37	1,911,497.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,457,951.85	-41,904,596.69	-11,980,648.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	242,538.37	281,098.22	244,637.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	237,021,200.04	303,425,386.46	262,693,651.65
加：营业外收入	466,610.79	2,630,520.18	3,608,168.55
减：营业外支出	524,798.95	2,212,314.97	23,986.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	236,963,011.88	303,843,591.67	266,277,834.20
减：所得税费用	2,470,035.35	-2,907,573.59	4,920,369.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	234,492,976.53	306,751,165.26	261,357,464.90
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	234,492,976.53	306,751,165.26	261,357,464.90
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	238,600,177.76	306,901,180.43	261,357,464.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,107,201.23	-150,015.17	
六、其他综合收益的税后净额	-16,446,614.68	127,338.03	1,941,489.62
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-16,446,614.68	127,338.03	1,941,489.62
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益	-16,446,614.68	127,338.03	1,941,489.62
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额	-16,446,614.68	127,338.03	1,941,489.62
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	218,046,361.85	306,878,503.29	263,298,954.52
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	222,153,563.08	307,028,518.46	263,298,954.52
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-4,107,201.23	-150,015.17	
八、每股收益			
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.56	0.72	0.64
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.56	0.72	0.63

(三) 合并现金流量表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	3,243,468,553.78	2,537,966,705.07	1,806,322,962.72
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还	129,245,345.40	103,178,737.97	43,933,744.55
收到其他与经营活动有关的现金	82,115,223.89	94,460,932.70	70,860,747.55
经营活动现金流入小计	3,454,829,123.07	2,735,606,375.74	1,921,117,454.82
购买商品、接受劳务支付的现金	2,777,163,085.82	1,796,229,234.23	1,352,101,940.59

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金	598,292,445.26	403,387,614.33	292,685,410.26
支付的各项税费	31,649,098.44	15,244,571.10	12,919,684.51
支付其他与经营活动有关的现金	125,175,514.98	77,420,158.06	55,243,168.42
经营活动现金流出小计	3,532,280,144.50	2,292,281,577.72	1,712,950,203.78
经营活动产生的现金流量净额	-77,451,021.43	443,324,798.02	208,167,251.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	7,644,000,000.00	2,315,000,000.00	216,722,413.34
取得投资收益收到的现金	19,684,566.75	3,340,604.75	504,985.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	602,376.84	255,441.40	235,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	7,664,286,943.59	2,318,596,046.15	217,462,398.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	243,984,782.43	88,657,799.24	305,475,298.05
投资支付的现金	7,397,943,000.00	3,478,740,000.00	70,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	134,591,042.22		
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	7,776,518,824.65	3,567,397,799.24	375,475,298.05
投资活动产生的现金流量净额	-112,231,881.06	-1,248,801,753.09	-158,012,899.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	37,606,270.61	33,176,569.39	2,401,055,266.04
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	116,000,000.00	219,516.92	
收到其他与筹资活动有关的现金		86,871,640.93	270,250,469.24
筹资活动现金流入小计	153,606,270.61	120,267,727.24	2,671,305,735.28

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
偿还债务支付的现金	22,720,000.00	219,516.92	301,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,219,392.62	160,775,997.82	86,750,790.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	24,193,542.70	58,341,385.89	45,598,563.79
筹资活动现金流出小计	132,132,935.32	219,336,900.63	433,349,354.07
筹资活动产生的现金流量净额	21,473,335.29	-99,069,173.39	2,237,956,381.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,994,061.20	11,959,296.54	5,374,448.88
五、现金及现金等价物净增加额	-191,203,628.40	-892,586,831.92	2,293,485,181.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,888,126,770.57	2,780,713,602.49	487,228,420.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,696,923,142.17	1,888,126,770.57	2,780,713,602.49

三、发行人财务报表的编制基础、合并报表的范围及变化情况

（一）财务报表的编制基础及遵循会计准则的声明

公司以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定，以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

公司自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

（二）合并财务报表范围

1、合并财务报表范围

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	持股比例		取得方式
	直接	间接	
南芯科技（北京）有限公司	100	-	投资设立
Southchip Semiconductor Technology Pte.Ltd.	100	-	投资设立
Southchip Semiconductor Trading Pte.Ltd.	-	100	投资设立
Southchip Semiconductor Korea Ltd.	-	100	投资设立

子公司名称	持股比例		取得方式
	直接	间接	
Powerquark Semiconductor International Trading Pte.Ltd.	-	100	投资设立
Southchip US Inc.	-	100	投资设立
SparkCore Limited	-	100	投资设立
Southchip Technik Deutschland GmbH	-	100	非同一控制下企业合并
Southchip HK Limited	-	100	投资设立
珠海楠欣半导体科技有限公司	100	-	投资设立
深圳楠欣半导体科技有限公司	100	-	投资设立
成都万智芯科技有限公司	51	-	投资设立
浙江南芯半导体有限公司	100	-	投资设立
深圳万感芯科技有限公司	71.83	-	投资设立
珠海昇生微电子有限责任公司	100	-	非同一控制下企业合并
昇生微电子（成都）有限责任公司	-	100	非同一控制下企业合并
昇生微电子（上海）有限责任公司	-	100	非同一控制下企业合并
深圳市科萨微电子有限责任公司	-	100	非同一控制下企业合并
珠海揽芯科技有限公司	-	100	非同一控制下企业合并
Southchip Technik GmbH	-	100	投资设立

2、合并财务报表范围变化情况

报告期内，公司合并财务报表范围变化情况如下：

变化期间	子公司名称	变动情况	取得方式
2025 年度	浙江南芯半导体有限公司	新增	投资设立
	Southchip Technik Deutschland GmbH	新增	非同一控制下企业合并
	Southchip HK Limited	新增	投资设立
	深圳万感芯科技有限公司	新增	投资设立
	珠海昇生微电子有限责任公司	新增	非同一控制下企业合并
	昇生微电子（成都）有限责任公司	新增	非同一控制下企业合并
	昇生微电子（上海）有限责任公司	新增	非同一控制下企业合并
	深圳市科萨微电子有限责任公司	新增	非同一控制下企业合并
	珠海揽芯科技有限公司	新增	非同一控制下企业合并
Southchip Technik GmbH	新增	投资设立	
2024 年度	成都万智芯科技有限公司	新增	投资设立

变化期间	子公司名称	变动情况	取得方式
	Southchip US Inc.	新增	投资设立
	SparkCore Limited	新增	投资设立
2023 年度	珠海楠欣半导体科技有限公司	新增	投资设立
	深圳楠欣半导体科技有限公司	新增	投资设立
	Southchip Semiconductor Trading Pte. Ltd.	新增	投资设立
	Southchip Semiconductor korea Ltd.	新增	投资设立
	Powerquark Semiconductor International Trading Pte. Ltd.	新增	投资设立

四、主要财务指标及非经常性损益明细表

(一) 主要财务指标

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	2024 年 12 月 31 日/2024 年度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额 (万元)	523,473.34	463,802.96	446,185.99
归属于母公司所有者权益 (万元)	417,595.80	392,785.93	369,903.68
流动比率 (倍)	4.49	5.96	5.44
速动比率 (倍)	3.35	5.01	4.66
资产负债率 (母公司)	19.05%	14.39%	16.80%
资产负债率 (合并)	20.31%	15.32%	17.10%
利息保障倍数 (倍)	180.06	764.23	93.68
应收账款周转率 (次/年)	10.09	12.49	11.44
存货周转率 (次/年)	2.47	2.57	2.25
归属于母公司所有者的净利润 (万元)	23,860.02	30,690.12	26,135.75
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 (万元)	19,979.95	30,022.55	25,114.07
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.18	1.04	0.49
每股净现金流量 (元/股)	-0.45	-2.10	5.42
归属于母公司所有者的每股净资产 (元/股)	9.76	9.23	8.73

注：1、流动比率=流动资产/流动负债；

2、速动比率=(流动资产-存货-预付款项-一年内到期的非流动资产-其他流动资产)/流动负债；

3、资产负债率=负债总额/总资产；

4、利息保障倍数=(利润总额+利息支出(财务费用项下))/利息支出(财务费用项下)；

5、应收账款周转率=营业收入/应收账款账面余额的平均余额；

- 6、存货周转率=营业成本/存货账面余额的平均余额；
- 7、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；
- 8、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额；
- 9、归属于母公司所有者的每股净资产=归属于母公司所有者权益/期末股本总额。

（二）每股收益和净资产收益率

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，报告期公司净资产收益率及每股收益如下：

期间	报告期利润计算口径	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
			基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
2025年度	归属于母公司所有者的净利润	5.92	0.56	0.56
	扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	4.96	0.47	0.47
2024年度	归属于母公司所有者的净利润	8.01	0.72	0.72
	扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	7.84	0.71	0.70
2023年度	归属于母公司所有者的净利润	8.77	0.64	0.63
	扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	8.43	0.62	0.61

基本每股收益= $P_0 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$

（其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。）

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

（其中： P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。）

加权平均净资产收益率= $P_0 / (E_0 + N_p \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

（其中： P_0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； N_p 为归属于公司普通股股东的净利润； E_0 为归属于公司普通股股东的期初净资产； E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； M_0 为报告期月份数； M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。）

（三）非经常性损益明细表

以下非经常性损益以合并财务报表数据为基础，并经容诚会计师出具的《上海南芯半导体科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（容诚专字[2026]230Z1199号）鉴证。报告期公司非经常性损益如下：

单位：万元

非经常性损益明细	2025年度	2024年度	2023年度
非流动性资产处置损益	24.25	28.11	24.25
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,961.80	67.29	942.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,899.84	535.38	47.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5.82	36.82	8.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-	-
非经常性损益总额	3,880.07	667.60	1,021.68
减：非经常性损益的所得税影响数		0.03	0.00
非经常性损益净额	3,880.07	667.57	1,021.68
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		-	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益	3,880.07	667.57	1,021.68

报告期各期，归属于母公司股东的非经常性损益净额分别为 1,021.68 万元、667.57 万元和 3,880.07 万元。计入当期损益的政府补助、理财产品投资收益等，是公司非经常性损益的主要组成部分。

随着公司业务规模逐年扩大，报告期内，公司营业收入规模持续增长，公司非经常性损益对经营成果不存在重大影响。

五、会计政策变更、会计估计变更及重大会计差错更正

（一）会计政策变更

1、2023 年度

①执行《企业会计准则解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

对于2022年1月1日因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定进行追溯调整。因执行该项会计处理规定，公司追溯调整了可比期间财务报表数据，调整情况如下：

单位：元

受影响的报表项目	2022年12月31日/2022年度 (合并)		2022年12月31日/2022年度 (母公司)	
	调整前	调整后	调整前	调整后
资产负债表项目：				
递延所得税资产	4,883,624.10	4,893,563.99	-	-
未分配利润	271,952,179.32	271,962,119.21	-	-
利润表项目：				
所得税费用	-4,883,624.10	-4,893,563.99	-	-

②公司按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）的规定重新界定2022年度非经常性损益，将使得2022年度扣除所得税后的非经常性损益净额减少1,697,918.33元，其中归属于公司普通股股东的非经常性损益净额减少1,697,918.33元。2022年度受影响的非经常性损益项目如下：

项 目	影响金额（元）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	-1,385,144.58
其他符合非经营性损益定义的损益项目	-312,773.75
合 计	-1,697,918.33

2、2024年度

①执行《企业会计准则解释第17号》

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号，以下简称解释17号），自2024年1月1日起施行。公司于2024年1月1

日起执行解释 17 号的规定。执行解释 17 号的相关规定对公司报告期内财务报表无重大影响。

②保证类质保费用重分类

财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。执行该规定对公司报告期内财务报表无重大影响。

3、2025 年度

2025 年，公司无重要会计政策变更。

(二) 会计估计变更

报告期内，公司不存在重要会计估计变更。

(三) 会计差错更正

报告期内，公司无重大会计差错更正。

六、主要税种和税率

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	19%、13%、10%、8%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	5%、7%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	0%、9%、15%、16%、17%、19%、20%、21%、23%、25%

执行不同企业所得税税率纳税主体的情况说明如下：

纳税主体名称	所得税税率
上海南芯半导体科技股份有限公司	0%
南芯科技（北京）有限公司	25%
珠海楠欣半导体科技有限公司	25%
深圳楠欣半导体科技有限公司	25%
Southchip Semiconductor Technology Pte.Ltd.	17%

纳税主体名称	所得税税率
Southchip Semiconductor Trading Pte.Ltd.	17%
Southchip Semiconductor Korea Ltd.	2 亿韩元以内：9%； 2 亿至 200 亿韩元：19%
Southchip Technik GmbH	23%
Powerquark Semiconductor International Trading Pte.Ltd.	17%
Southchip US Inc.	21%
Southchip Technik Deutschland GmbH	15%
Southchip HK Limited	16%
Sparkcore Limited	0%
成都万智芯科技有限公司	25%
浙江南芯半导体有限公司	25%
珠海昇生微电子有限责任公司	15%
昇生微电子（成都）有限责任公司	20%
昇生微电子（上海）有限责任公司	20%
深圳市科萨微电子有限责任公司	20%
珠海揽芯科技有限公司	20%
深圳万感芯科技有限公司	25%

（二）重要税收优惠政策及其依据

1、高新企业税收优惠

公司于 2021 年 12 月取得《高新技术企业证书》（证书编号为 GR202131005018），公司被认定为高新技术企业。按照《企业所得税法》等相关法规规定，公司 2021 年至 2023 年享受 15%的企业所得税优惠税率。

公司于 2024 年 12 月取得《高新技术企业证书》（证书编号为 GR202431006739），公司被认定为高新技术企业。按照《企业所得税法》等相关法规规定，公司 2024 年至 2026 年享受 15%的企业所得税优惠税率。

珠海昇生微电子有限责任公司于 2023 年取得高新技术企业证书（证书编号为 GR202344007754），被认定为高新技术企业，按照《企业所得税法》等相关法规规定，珠海昇生微电子有限责任公司 2023 年至 2026 年享受 15%的企业所得税优惠税率。

2、两免三减半税收优惠

根据国务院印发的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8号），国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。公司属于集成电路设计企业，并于2021年度获利，2021年度和2022年度免征企业所得税，2023年度至2025年度按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

3、五免后按十税收优惠

根据国务院印发的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8号）和《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部税务总局发展改革委工业和信息化部公告〔2020〕45号）的有关规定，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按10%的税率征收企业所得税。2023年度，公司申报成为重点集成电路设计企业，并于2021年度获利，2021年度至2025年度免征企业所得税，以后年度按照10%的税率征收企业所得税。目前公司实际执行的企业所得税优惠政策为五免后按十。

4、小微企业税收优惠

根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12号）有关规定，昇生微电子（成都）有限责任公司、昇生微电子（上海）有限责任公司、深圳市科萨微电子有限责任公司和珠海揽芯科技有限公司符合小型微利企业条件，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

5、增值税“免、抵、退”优惠

根据财政部、国家税务总局《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税〔2012〕39号）的规定，报告期内公司出口业务享受增值税“免、抵、退”优惠政策。

七、财务状况分析

（一）资产构成及其变动情况

报告期各期末，公司资产构成如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日		2024年12月31日		2023年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	405,301.70	77.43%	410,212.91	88.45%	410,556.36	92.01%
非流动资产	118,171.64	22.57%	53,590.05	11.55%	35,629.63	7.99%
资产总计	523,473.34	100.00%	463,802.96	100.00%	446,185.99	100.00%

报告期各期末，公司资产总额分别为 446,185.99 万元、463,802.96 万元和 523,473.34 万元。其中，流动资产占资产总额的比例分别为 92.01%、88.45%和 77.43%，公司流动资产占比较高，符合 Fabless 芯片设计的行业特征。

1、流动资产分析

报告期各期末，公司流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日		2024年12月31日		2023年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	170,616.13	42.10%	188,812.92	46.03%	287,682.48	70.07%
交易性金融资产	54,543.45	13.46%	105,301.32	25.67%	-	0.00%
应收账款	43,964.20	10.85%	19,993.03	4.87%	20,720.37	5.05%
应收款项融资	281.74	0.07%	-	-	-	-
预付款项	1,238.99	0.31%	1,094.55	0.27%	2,534.41	0.62%
其他应收款	33,050.86	8.15%	30,735.22	7.49%	43,503.12	10.60%
存货	96,505.68	23.81%	61,356.44	14.96%	52,538.26	12.80%
其他流动资产	5,100.64	1.26%	2,919.43	0.71%	3,577.72	0.87%
流动资产合计	405,301.70	100.00%	410,212.91	100.00%	410,556.36	100.00%

报告期各期末，公司的流动资产总额分别为 410,556.36 万元、410,212.91 万元和 405,301.70 万元。2023 年末，公司流动资产规模较 2022 年末大幅增长，主要系公司于 2023 年完成首次公开发行股票并上市，募集资金到位使得公司货币资金余额增加。2025 年末，公司流动资产规模较 2024 年末有所下降，主要系公

司对外投资增加、固定资产投入增加，导致货币资金、交易性金融资产规模减少所致。

(1) 货币资金

报告期各期末，公司货币资金明细情况如下：

单位：万元

项目	2025年 12月31日	2024年 12月31日	2023年 12月31日
库存现金	7.80	7.19	7.08
银行存款	170,447.29	188,805.49	278,988.00
其他货币资金	161.04	0.24	8,687.40
存放财务公司存款	-	-	-
合计	170,616.13	188,812.92	287,682.48
其中：存放在境外的款项总额	62,660.86	26,875.48	10,920.81

报告期各期末，公司货币资金余额分别为 287,682.48 万元、188,812.92 万元和 170,616.13 万元。其中，其他货币资金主要系质押借款保证金、银行承兑汇票保证金等。

(2) 交易性金融资产

报告期各期末，公司交易性金融资产情况如下：

单位：万元

项目	2025年 12月31日	2024年 12月31日	2023年 12月31日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	54,543.45	105,301.32	-
合计	54,543.45	105,301.32	-

报告期各期末，公司交易性金融资产余额分别为 0 万元、105,301.32 万元和 54,543.45 万元，主要系公司为提高资金使用效率，利用闲置资金投资银行理财。

(3) 应收账款

1) 应收账款基本情况

报告期各期末，公司应收账款情况如下：

单位：万元

项目	2025年 12月31日	2024年 12月31日	2023年 12月31日
应收账款余额	44,446.97	20,194.98	20,929.67
减：坏账准备	482.77	201.95	209.30
应收账款账面价值	43,964.20	19,993.03	20,720.37

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 20,720.37 万元、19,993.03 万元和 43,964.20 万元。2025 年公司应收账款余额较 2024 年末增幅较大，主要系公司业务规模持续扩大所致。

2) 应收账款余额按账龄划分

报告期各期末，公司应收账款余额的账龄分布情况如下：

单位：万元

项目	2025年 12月31日	2024年 12月31日	2023年 12月31日
0-6 个月	44,340.38	20,194.98	20,929.67
7-12 个月	0.18	-	-
1-2 年	84.37	-	-
2-3 年	13.68	-	-
3 年以上	8.37	-	-
合计	44,446.97	20,194.98	20,929.67

注：最近一期末账龄分布情况和其他报告期各期末存在一定差异，系 2025 年收购珠海昇生微所致，后同。

从应收账款账龄结构来看，报告期各期末，公司应收账款账龄主要在 6 个月以内，应收账款账龄整体较短。

3) 应收账款期后回款情况

报告期各期末，公司应收账款回款情况如下：

单位：万元

项目	应收账款余额	期后回款金额	回款占期末应收账款比例
2025 年 12 月 31 日	44,446.97	42,730.59	96.14%
2024 年 12 月 31 日	20,194.98	20,194.98	100.00%
2023 年 12 月 31 日	20,929.67	20,929.67	100.00%

注：期后回款金额为各期末下一年的回款金额，2025 年末期后回款金额为截至 2026 年 3 月 31 日的回款金额。

报告期各期末，公司应收账款期后收回比例分别为 100.00%、100.00%和 96.14%，公司应收账款期后回款比例较高，不存在大额回收风险，公司亦未发生大额坏账核销情况。

4) 应收账款坏账准备计提情况

报告期各期末，应收账款坏账准备情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
应收账款坏账准备	482.77	201.95	209.30
其中：单项计提	21.98	-	-
组合计提	460.79	201.95	209.30

① 单项计提的应收账款坏账准备情况

报告期内，公司结合客户的经营情况、财务状况、诉讼情况，综合评估其还款意愿及还款能力，对部分客户应收账款单项计提了坏账准备。

截至 2025 年 12 月 31 日，按单项计提坏账准备的应收账款情况如下：

单位：万元

名称	2025年12月31日			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
单位一	21.98	21.98	100.00%	预计无法收回
合计	21.98	21.98	100.00%	

报告期其他各期末，不存在按单项计提的应收账款坏账准备。

② 组合计提的应收账款坏账准备情况

报告期各期末，按组合计提的应收账款坏账准备情况如下：

截至 2025 年 12 月 31 日，按组合计提坏账准备的应收账款情况如下：

单位：万元

账龄	2025年12月31日			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	占比(%)
0-6个月	44,340.20	443.40	1.00	99.81
7-12个月	0.18	0.01	5.00	0.00
1-2年	84.04	16.81	20.00	0.19

账龄	2025年12月31日			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	占比(%)
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.58	0.58	100.00	0.00
合计	44,424.99	460.79	1.04	100.00

截至2024年12月31日，按组合计提坏账准备的应收账款情况如下：

单位：万元

账龄	2024年12月31日			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	占比(%)
0-6个月	20,194.98	201.95	1.00	100.00
合计	20,194.98	201.95	1.00	100.00

截至2023年12月31日，按组合计提坏账准备的应收账款情况如下：

单位：万元

账龄	2023年12月31日			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	占比(%)
0-6个月	20,929.67	209.30	1.00	100.00
合计	20,929.67	209.30	1.00	100.00

从账龄结构来看，报告期各期末，除单项计提坏账准备的应收账款外，公司账龄在6个月以内的应收账款余额占比分别为100.00%、100.00%和99.81%，应收账款账龄主要在6个月以内，应收账款总体质量较高，坏账准备计提具有充分性。

5) 应收账款前五名情况

报告期各期末，公司应收账款余额前五大客户（合并口径）情况如下：

单位：万元

时间	序号	客户名称	金额	占应收账款余额比例
2025年12月31日	1	客户C集团	13,005.39	29.26%
	2	客户E	5,311.20	11.95%
	3	客户D	3,991.68	8.98%
	4	客户A集团	3,593.73	8.09%
	5	客户B集团	2,761.56	6.21%

时间	序号	客户名称	金额	占应收账款余额比例
		合计	28,663.57	64.49%
2024年12月31日	1	客户C集团	10,732.43	53.14%
	2	客户D	2,855.63	14.14%
	3	客户A集团	1,531.85	7.59%
	4	客户B集团	965.51	4.78%
	5	客户H	583.25	2.89%
			合计	16,668.68
2023年12月31日	1	客户C集团	6,778.91	32.39%
	2	客户B集团	3,826.34	18.28%
	3	客户D	3,640.41	17.39%
	4	客户A集团	2,928.93	13.99%
	5	客户F	905.17	4.32%
			合计	18,079.76

注1：受同一实际控制或互为关联企业的客户主体已合并披露。

注2：客户B集团包括：客户B1、客户B2、客户B3、客户B4。

注3：客户A集团包括：客户A1、客户A2。

注4：客户C集团包括：客户C1、客户C2。

(4) 预付款项

报告期各期末，公司预付款项情况如下：

单位：万元

账龄	2025年12月31日		2024年12月31日		2023年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,148.70	92.72%	1,088.08	99.41%	2,527.97	99.75%
1至2年	86.27	6.96%	1.66	0.15%	3.14	0.12%
2至3年			1.50	0.14%	3.30	0.13%
3年以上	4.02	0.32%	3.30	0.30%	-	0.00%
合计	1,238.99	100.00%	1,094.55	100.00%	2,534.41	100.00%

报告期各期末，公司预付款项余额分别为 2,534.41 万元、1,094.55 万元和 1,238.99 万元，主要系预付的材料采购款等，占流动资产比例较低，1 年以内账龄的预付款项占比超过 92%。

(5) 其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	33,050.86	30,735.22	43,503.12
合计	33,050.86	30,735.22	43,503.12

报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 43,503.12 万元、30,735.22 万元和 33,050.86 万元，主要系向供应商的产能保证金、其他押金和保证金等。

报告期各期末，公司其他应收款账面余额的账龄构成情况如下：

单位：万元

账龄	2025年12月31日		2024年12月31日		2023年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	32,986.94	98.09%	30,738.92	98.67%	43,742.07	99.45%
1至2年	371.66	1.11%	186.24	0.60%	107.77	0.25%
2至3年	70.63	0.21%	107.77	0.35%	114.22	0.26%
3至4年	69.36	0.21%	101.19	0.32%	17.17	0.04%
4至5年	112.07	0.33%	16.57	0.05%	3.06	0.01%
5年以上	19.63	0.06%	3.06	0.01%	-	0.00%
合计	33,630.27	100.00%	31,153.73	100.00%	43,984.29	100.00%

从账龄结构来看，报告期各期末，公司其他应收款账龄在 1 年以内的比例较高，占各期末其他应收款账面余额比例分别为 99.45%、98.67%和 98.09%，其他应收款账龄整体相对较短。

(6) 存货

报告期各期末，公司存货的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	账面余额	占比	跌价准备	账面价值
2025年12月31日				
原材料	36,655.40	36.86%	766.34	35,889.06
库存商品	31,778.56	31.95%	2,069.21	29,709.35
委托加工物资	31,019.46	31.19%	112.19	30,907.28
在途物资	-	-	-	-
合计	99,453.42	100.00%	2,947.74	96,505.68
2024年12月31日				
原材料	15,466.10	23.87%	1,054.31	14,411.79
库存商品	26,579.25	41.02%	1,958.14	24,621.11
委托加工物资	22,754.38	35.11%	430.84	22,323.54
在途物资	-	-	-	-
合计	64,799.73	100.00%	3,443.29	61,356.44
2023年12月31日				
原材料	13,851.69	25.25%	857.56	12,994.13
库存商品	16,081.02	29.32%	1,458.79	14,622.22
委托加工物资	24,921.90	45.43%	-	24,921.90
在途物资	-	-	-	-
合计	54,854.61	100.00%	2,316.35	52,538.26

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 52,538.26 万元、61,356.44 万元和 96,505.68 万元，公司存货主要由原材料、库存商品和委托加工物资构成。报告期内，公司业务规模持续扩大，原材料稳定备货，库存商品余额总体呈上升趋势，与公司营业收入增长趋势一致。

公司在资产负债表日对存货按成本与可变现净值孰低计量。报告期各期末，公司存货跌价准备分别为 2,316.35 万元、3,443.29 万元和 2,947.74 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	2025年 12月31日	2024年 12月31日	2023年 12月31日
存货账面余额	99,453.42	64,799.73	54,854.61
存货跌价准备	2,947.74	3,443.29	2,316.35
存货账面价值	96,505.68	61,356.44	52,538.26

项目	2025年 12月31日	2024年 12月31日	2023年 12月31日
存货跌价准备计提比例	2.96%	5.31%	4.22%

报告期各期末公司存货跌价准备计提比例相对稳定。

(7) 应收款项融资

2025年末，公司应收款项融资 281.74 万元，占流动资产的 0.07%，系 2025 年新增银行承兑汇票。

(8) 其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产情况如下：

单位：万元

项目	2025年 12月31日	2024年 12月31日	2023年 12月31日
待抵扣/待认证进项税	3,956.44	1,415.78	3,129.76
预缴所得税	965.80	1,503.64	447.96
其他	178.40	-	-
合计	5,100.64	2,919.43	3,577.72

报告期各期末，公司其他流动资产分别为 3,577.72 万元、2,919.43 万元和 5,100.64 万元，主要系公司待抵扣/待认证进项税、预缴所得税。

2、非流动资产分析

报告期各期末，公司非流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日		2024年12月31日		2023年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期股权投资	1,038.85	0.88%	905.61	1.69%	-	-
其他权益工具投资	3,324.00	2.81%	3,324.00	6.20%	300.00	0.84%
其他非流动金融资产	33,309.25	28.19%	7,250.00	13.53%	-	-
固定资产	41,572.67	35.18%	35,437.94	66.13%	32,641.07	91.61%
在建工程	8,333.83	7.05%	2,580.05	4.81%	77.79	0.22%
使用权资产	3,378.95	2.86%	1,307.59	2.44%	1,030.00	2.89%
无形资产	4,895.09	4.14%	960.47	1.79%	739.40	2.08%
商誉	17,351.48	14.68%	-	-	-	-

项目	2025年12月31日		2024年12月31日		2023年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期待摊费用	3,038.44	2.57%	754.38	1.41%	745.42	2.09%
递延所得税资产	353.39	0.30%	317.59	0.59%	1.19	0.00%
其他非流动资产	1,575.69	1.33%	752.42	1.40%	94.76	0.27%
非流动资产合计	118,171.64	100.00%	53,590.05	100.00%	35,629.63	100.00%

报告期各期末，公司非流动资产总额分别为 35,629.63 万元、53,590.05 万元和 118,171.64 万元。公司非流动资产逐年增加，主要系：①公司业务规模扩张，生产设备相关投入逐步增加；②公司布局产业链产业投资和并购协同机会，投资私募基金和收购昇生微形成商誉。

（1）长期股权投资

2024 年末、2025 年末，公司长期股权投资账面价值分别为 905.61 万元和 1,038.85 万元，系公司投资行至存储科技（苏州）有限公司，并以权益法核算所致。

（2）其他权益工具投资

报告期各期末，公司其他权益工具投资分别为 300.00 万元、3,324.00 万元和 3,324.00 万元，主要系：①公司 2020 年投资南京酷科电子科技有限公司 300.00 万元；②公司 2024 年投资江苏盘古半导体科技股份有限公司 3,024.00 万元。公司持有上述股权的目的为非交易性质，报表列示其他权益工具投资。

（3）其他非流动金融资产

2024 年末、2025 年末，公司其他非流动金融资产分别为 7,250.00 万元和 33,309.25 万元，主要系增加对私募股权投资基金的投资所致。

截至报告期末，具体包括：

单位：万元

项目	拟投资总额	截至报告期末已投资金额	参与身份
杭州光合贰期创业投资合伙企业（有限合伙）	2,000.00	2,000.00	有限合伙人
北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,000.00	5,000.00	有限合伙人

项目	拟投资总额	截至报告期末已投资金额	参与身份
共青城众松聚力创业投资合伙企业（有限合伙）	3,000.00	2,550.00	有限合伙人
安徽晨晖种子创业投资合伙企业（有限合伙）	9,900.00	2,970.00	有限合伙人
嘉善伽晨一号创业投资合伙企业（有限合伙）	20,000.00	20,000.00	有限合伙人
杭州顺晖股权投资合伙企业（有限合伙）	800.00	800.00	有限合伙人
合计	40,700.00	33,320.00	-

截至报告期末，由于杭州光合贰期创业投资合伙企业（有限合伙）基金分配已返还投资款 10.75 万元，故其他非流动金融资产金额为 33,309.25 万元。

（4）固定资产

报告期各期末，公司固定资产情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
账面原值合计	49,880.91	100.00%	40,114.19	100.00%	35,009.74	100.00%
房屋及建筑物	28,887.27	57.91%	28,859.53	71.94%	27,593.25	78.82%
机器设备	10,226.01	20.50%	6,963.26	17.36%	4,750.03	13.57%
运输工具	155.42	0.31%	174.53	0.44%	173.82	0.50%
电子设备及其他	10,612.20	21.28%	4,116.87	10.26%	2,492.64	7.12%
累计折旧合计	8,308.24	100.00%	4,676.25	100.00%	2,368.67	100.00%
房屋及建筑物	1,984.84	23.89%	969.64	20.74%	-	-
机器设备	2,368.75	28.51%	1,463.89	31.30%	863.39	36.45%
运输工具	83.58	1.01%	45.07	0.96%	41.57	1.76%
电子设备及其他	3,871.08	46.59%	2,197.66	47.00%	1,463.71	61.79%
账面价值合计	41,572.67	100.00%	35,437.94	100.00%	32,641.07	100.00%
房屋及建筑物	26,902.43	64.71%	27,889.89	78.70%	27,593.25	84.54%
机器设备	7,857.27	18.90%	5,499.38	15.52%	3,886.64	11.91%
运输工具	71.84	0.17%	129.46	0.37%	132.25	0.41%
电子设备及其他	6,741.13	16.22%	1,919.21	5.42%	1,028.93	3.15%

报告期各期末，公司主要固定资产为房屋及建筑物，占固定资产账面价值的比例分别为 84.54%、78.70%和 64.71%。2023 年，公司固定资产账面价值大幅提

升，系购入房屋建筑物所致。

报告期各期末，公司固定资产未发生减值。

(5) 在建工程

报告期各期末，公司在建工程构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2025 年末			
	账面余额	占比	减值准备	账面价值
待安装软件	88.68	1.06%	-	88.68
待安装设备	3,435.67	41.23%	-	3,435.67
测试厂建设	4,809.48	57.71%	-	4,809.48
合计	8,333.83	100.00%	-	8,333.83
项目	2024 年末			
	账面余额	占比	减值准备	账面价值
待安装软件	91.83	3.56%	-	91.83
待安装设备	2,488.22	96.44%	-	2,488.22
合计	2,580.05	100.00%	-	2,580.05
项目	2023 年末			
	账面余额	占比	减值准备	账面价值
待安装软件	77.79	100.00%	-	77.79
待安装设备	-	-	-	-
合计	77.79	100.00%	-	77.79

报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为 77.79 万元、2,580.05 万元和 8,333.83 万元，主要为新增待安装软件、待安装设备、以及嘉善测试厂建设，根据达到预定可使用状态转入固定资产。

报告期末，公司主要在建工程为测试厂建设，建设期为 6 年，预算金额 71,287.30 万元，预计达到可使用状态的时间 2031 年 2 月。公司上述项目正在有序建设中，所处经济、技术或法律法规环境以及资产所处的市场在当期及近期末发生重大变化，不存在预期无法通过环保、消防等相关验收的情形，不存在证据表明在建工程相关资产投产后的经济效益明显低于预期的情形。

报告期各期末，公司在建工程未发生减值。

(6) 使用权资产

报告期各期末，公司使用权资产账面价值情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日		2024年12月31日		2023年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
房屋建筑物	3,378.95	100%	1,307.59	100%	1,030.00	100%
合计	3,378.95	100%	1,307.59	100%	1,030.00	100%

报告期各期末，公司使用权资产账面价值分别为 1,030.00 万元、1,307.59 万元和 3,378.95 万元。2025 年公司使用权资产较上年末增幅较大，主要系公司业务规模扩大，增加了场地租赁所致。

(7) 无形资产

报告期各期末，公司无形资产账面价值情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日		2024年12月31日		2023年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
软件	2,757.60	56.33%	588.37	61.26%	447.04	60.46%
专利使用权及商标权	750.30	15.33%	372.10	38.74%	292.37	39.54%
土地使用权	1,387.19	28.34%	-	-	-	-
合计	4,895.09	100.00%	960.47	100.00%	739.40	100.00%

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 739.40 万元、960.47 万元和 4,895.09 万元，主要为软件、专利使用权及商标权、土地使用权。2025 年无形资产较上年末增幅较大，主要系随着业务规模扩大购置 EDA 软件、以及测试厂建设购买土地使用权所致。

报告期内，公司不存在开发支出资本化形成无形资产的情况。报告期各期末，公司无形资产使用情况良好，未出现减值迹象。

(8) 商誉

公司 2025 年末商誉 17,351.48 万元，系收购珠海昇生微电子有限责任公司所致。报告期末，公司包含商誉的资产组可回收价值高于与商誉相关的资产组账面

价值，公司商誉不存在减值迹象，无需计提商誉减值准备。

（9）长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用分别为 745.42 万元、754.38 万元和 3,038.44 万元，2023 年至 2024 年主要由办公场地装修费形成，2025 年增加较多主要系公司模具费和装修费增加所致。

（10）递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产分别 1.19 万元、317.59 万元和 353.39 万元，主要系未弥补亏损、租赁负债账面与税法差异所致，占非流动资产的比例较小。

（11）其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
预付长期资产购置款	1,551.39	752.42	94.76
定期存单	24.30	-	-
合计	1,575.69	752.42	94.76

报告期各期末，公司其他非流动资产分别为 94.76 万元、752.42 万元和 1,575.69 万元，为预付的长期资产购置款，公司其他非流动资产逐年增加，主要系业务扩张，预付设备款等增加所致。

（二）负债构成及其变动情况

报告期各期末，公司的负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	90,303.58	84.95%	68,771.76	96.82%	75,462.00	98.92%
非流动负债	15,999.69	15.05%	2,260.27	3.18%	820.31	1.08%
负债合计	106,303.27	100.00%	71,032.03	100.00%	76,282.30	100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为 6,282.30 万元、71,032.03 万元和

106,303.27 万元，公司 2025 年末负债总额较 2024 年末上升，主要系应付账款、应付职工薪酬规模增长等所致。

1、流动负债分析

报告期各期末，公司流动负债构成具体如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	-	-	-	-	-	-
交易性金融负债	1,500.00	1.66%	-	-	-	-
应付票据	29,920.00	33.13%	29,920.00	43.51%	43,400.00	57.51%
应付账款	34,081.58	37.74%	20,906.72	30.40%	18,530.98	24.56%
合同负债	294.66	0.33%	164.13	0.24%	364.99	0.48%
应付职工薪酬	17,163.52	19.01%	13,263.05	19.29%	8,981.54	11.90%
应交税费	865.62	0.96%	786.77	1.14%	1,189.45	1.58%
其他应付款	4,355.55	4.82%	3,177.99	4.62%	2,227.17	2.95%
一年内到期的非流动负债	2,097.12	2.32%	538.92	0.78%	720.89	0.96%
其他流动负债	25.53	0.03%	14.19	0.02%	46.96	0.06%
流动负债合计	90,303.58	100.00%	68,771.76	100.00%	75,462.00	100.00%

报告期各期末，公司流动负债主要为应付票据、应付账款和应付职工薪酬等。流动负债科目分析如下：

(1) 短期借款

2022 年末，公司短期借款 30,109.12 万元，包括信用借款 12,100.00 万元、质押借款 18,000.00 万元、借款利息 9.12 万元，2023 年已全部偿还。报告期内，公司不存在逾期未偿还的银行借款，并正常支付利息费用。

(2) 应付票据

报告期各期末，公司应付票据分别为 43,400.00 万元、29,920.00 万元和 29,920.00 万元，全部为银行承兑汇票。报告期内金额呈逐渐减小趋势，主要系公司通过银行承兑汇票方式支付中芯集团产能保证金，产能保证金按协议结算减少所致。

(3) 应付账款

报告期各期末，公司应付账款按分类情况列示如下：

单位：万元

项目	2025年 12月31日	2024年 12月31日	2023年 12月31日
应付材料款	16,157.91	10,759.24	12,432.34
应付加工费	10,584.38	5,912.69	4,670.35
应付工程设备款	2,418.70	2,400.54	494.55
应付运费及其他	4,920.58	1,834.25	933.74
合计	34,081.57	20,906.72	18,530.98

报告期各期末，公司应付账款金额分别为 18,530.98 万元、20,906.72 万元和 34,081.57 万元，主要系采购原材料、加工费、工程设备款、运费等应付款项。

(4) 合同负债

报告期各期末，公司合同负债情况如下：

单位：万元

项目	2025年 12月31日	2024年 12月31日	2023年 12月31日
预收货款	294.66	164.13	364.99
合计	294.66	164.13	364.99

报告期各期末，公司合同负债余额分别为 364.99 万元、164.13 万元和 294.66 万元，系预收客户货款。

(5) 应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2025年 12月31日	2024年 12月31日	2023年 12月31日
一、短期薪酬	16,753.58	12,971.23	8,761.96
二、离职后福利-设定提存计划	304.51	229.30	179.01
三、辞退福利	105.43	62.52	40.57
合计	17,163.52	13,263.05	8,981.54

报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为 8,981.54 万元、13,263.05 万元和

17,163.52 万元，主要系应付职工工资、奖金、津贴和补贴等。

(6) 应交税费

报告期各期末，公司应交税费情况如下：

单位：万元

项目	2025年 12月31日	2024年 12月31日	2023年 12月31日
代扣代缴个人所得税	697.04	433.75	218.28
契税	-	-	781.26
其他	168.58	353.02	189.91
合计	865.62	786.77	1,189.45

报告期各期末，公司应交税费分别为 1,189.45 万元、786.77 万元和 865.62 万元，主要系代缴代扣的个人所得税、契税等。

(7) 其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款情况如下：

单位：万元

项目	2025年 12月31日	2024年 12月31日	2023年 12月31日
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	4,355.55	3,177.99	2,227.17
合计	4,355.55	3,177.99	2,227.17

报告期各期末，公司其他应付款分别为 2,227.17 万元、3,177.99 万元和 4,355.55 万元，主要系客户押金及保证金、股权收购待付款等。

(8) 一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债分别为 720.89 万元、538.92 万元和 2,097.12 万元，均系 1 年内到期的租赁负债。

(9) 其他流动负债

报告期各期末，公司其他流动负债分别为 46.96 万元、14.19 万元和 25.53 万元，系待转销项税额。

(10) 交易性金融负债

2025 年末，公司交易性金融负债 1,500 万元，系收购珠海昇生微形成的或有对价。

2、非流动负债分析

报告期各期末，非流动负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
租赁负债	1,410.81	30.67%	823.15	36.42%	259.17	31.59%
预计负债	137.17	2.98%	-	-	-	-
递延收益	2,658.32	57.79%	1,422.24	62.92%	561.13	68.41%
递延所得税负债	393.39	8.55%	14.88	0.66%	-	-
合计	4,599.69	100.00%	2,260.27	100.00%	820.31	100.00%

报告期各期末，公司非流动负债主要由递延收益、租赁负债等构成。

(1) 租赁负债

报告期各期末，公司租赁负债情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
租赁付款额	3,406.04	1,408.59	1,015.79
减：未确认融资费用	107.86	46.51	35.72
减：一年内到期的租赁负债	1887.37	538.92	720.89
合计	1,410.81	823.15	259.17

公司租赁负债系房屋租赁所形成。

(2) 预计负债

2025 年，公司预计负债 137.17 万元，系收购昇生微之后，由其待执行的亏损合同等形成。

(3) 递延收益

报告期各期末，公司的递延收益余额分别为 561.13 万元、1,422.24 万元和

2,658.32 万元，均系公司获得的政府补助，具体项目如下：

单位：万元

序号	项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
1	高效率高功率密度电荷泵手机快充系列芯片的实现与量产	-	40.00	40.00
2	新一代通信产业高质量发展补贴-IP 补贴	0.40	0.89	1.37
3	浦东财政 GZL-2023-C01 集成电路 IP	0.92	1.35	1.80
4	2022 年车规级模拟芯片制造工艺	750.00	750.00	450.00
5	成长型科技企业支持专项发展资金-张江科学城	-	330.00	-
6	成长型科技企业支持专项发展资金-高端研发奖励	-	300.00	-
7	经济和信息化产业高质量发展专项	1,575.00	-	-
8	浦东财政 GZL-2023-C07 集成电路 EDA	-	-	59.38
9	新一代通信产业高质量发展补贴-EDA 软件补贴	-	-	8.58
10	面向汽车新一代电子电气架构的智能电源研发及产业化	332.00		
合计		2,658.32	1,422.24	561.13

(4) 递延所得税负债

2024 年末、2025 年末，公司递延所得税负债分别为 14.88 万元和 393.39 万元，主要系使用权资产形成的应纳税暂时性差异所致。

(三) 偿债能力分析

1、偿债能力指标分析

报告期各期末，公司偿债能力指标如下表：

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
流动比率（倍）	4.49	5.96	5.44
速动比率（倍）	3.35	5.01	4.66
资产负债率（合并）	20.31%	15.32%	17.10%

报告期各期末，公司的流动比率分别为 5.44、5.96 和 4.49，速动比率分别为 4.66、5.01 和 3.35，资产负债率分别为 17.10%、15.32%和 20.31%。2023 年末至 2024 年末，公司流动比率和速动比率持续提升，资产负债率持续下降，主要系

公司收入持续增长，下游客户回款良好，带动流动资产进一步增长。总体而言，公司流动比率、速动比率较高，资产负债率较低，资产负债结构合理，偿债能力较强。

2、公司偿债能力与同行业可比公司的比较分析

报告期各期末，公司与同行业可比公司偿债能力相关指标对比如下：

项目	公司名称	2025年 12月31日	2024年 12月31日	2023年 12月31日
资产负债率	圣邦股份	23.40%	20.31%	18.34%
	杰华特	65.18%	49.50%	36.89%
	纳芯微	21.35%	22.50%	13.26%
	思瑞浦	9.71%	14.51%	5.57%
	艾为电子	20.86%	22.90%	26.62%
	平均值	28.10%	25.94%	20.13%
	公司	20.31%	15.32%	17.10%
流动比率（倍）	圣邦股份	3.73	4.25	5.25
	杰华特	1.27	2.05	4.02
	纳芯微	5.87	6.19	9.08
	思瑞浦	7.29	7.78	17.43
	艾为电子	3.51	3.24	3.71
	平均值	4.33	4.70	7.90
	公司	4.49	5.96	5.44
速动比率（倍）	圣邦股份	2.38	2.81	3.67
	杰华特	0.58	1.28	2.59
	纳芯微	4.20	4.79	7.23
	思瑞浦	6.23	6.88	15.72
	艾为电子	2.66	2.61	2.67
	平均值	3.21	3.67	6.38
	公司	3.35	5.01	4.66

注：同行业可比公司相关指标取自 iFind 金融数据终端、定期报告或招股说明书，后同。

报告期各期末，公司资产负债率、流动比率、速动比率均处于同行业可比公司的指标区间之内，最近一年一期指标优于可比公司平均值。报告期内，公司执行较为稳健的财务政策，保持较为安全的财务结构，努力规避财务风险，变现能

力与长期偿债能力均相对较强。随着未来募集资金的到位，公司资本结构将进一步优化，抗风险能力将得到增强。

（四）资产周转能力分析

1、资产周转能力指标分析

报告期内，公司的主要资产周转能力指标如下：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应收账款周转率（次/年）	10.09	12.49	11.44
存货周转率（次/年）	2.47	2.57	2.25

报告期内，公司应收账款周转率分别为 11.44 次/年、12.49 次/年和 10.09 次/年，总体呈上升趋势，公司主要客户为行业知名经销商，资质良好，回款风险较小。报告期内，公司存货周转率分别为 2.25 次/年、2.57 次/年和 2.47 次/年，随着业务规模的增长，公司存货周转率保持相对稳定，存货管理能力良好。

2、与同行业上市公司的比较分析

公司与同行业上市公司的应收账款周转率和存货周转率比较情况如下：

项目	公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应收账款周转率（次/年）	圣邦股份	12.79	16.46	18.51
	杰华特	5.08	4.09	3.86
	纳芯微	6.21	6.50	6.77
	思瑞浦	9.02	6.08	5.63
	艾为电子	26.70	41.18	54.00
	平均值	11.96	14.86	17.76
	公司	10.09	12.49	11.44
存货周转率（次/年）	圣邦股份	1.20	1.27	1.30
	杰华特	1.42	1.04	0.98
	纳芯微	1.78	1.51	1.09
	思瑞浦	2.10	1.32	1.38
	艾为电子	2.54	2.73	2.16
	平均值	1.81	1.57	1.38
	公司	2.47	2.57	2.25

报告期各期，公司应收账款周转率分别为 11.44 次/年、12.49 次/年和 10.09 次/年，公司应收账款周转率位于同行业可比公司的指标区间内，且回款情况相对较好。

报告期各期，公司存货周转率分别为 2.25 次/年、2.57 次/年和 2.47 次/年。公司存货周转率高于行业平均水平，存货周转情况良好。

综上，报告期内公司应收账款周转率、存货周转率不存在重大异常的情形，收入质量、采购及库存管理水平以及整体经营效率良好。

（五）财务性投资情况

1、财务性投资的认定依据

根据《上市公司证券发行注册管理办法》第九条，“除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资。”

根据《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定，“截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况”是指：

“1、财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资或投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。

2、围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

3、上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。

4、基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的财务性投资，不纳入财务性投资计算口径。

5、金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。

6、本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。投入是指支付投资资金、披露投资意向或者签订投资协议等。

7、发行人应当结合前述情况，准确披露截至最近一期末不存在金额较大的财务性投资的基本情况。”

关于类金融业务，根据《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，“除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款等业务。与公司主营业务发展密切相关，符合业态所需、行业发展惯例及产业政策的融资租赁、商业保理及供应链金融，暂不纳入类金融业务计算口径。”

2、截至最近一期末，公司财务性投资的情况

截至2025年12月31日，公司可能涉及财务性投资的会计科目如下：

单位：万元

序号	会计科目	金额	财务性投资金额
1	交易性金融资产	54,543.45	-
2	衍生金融资产	-	-
3	其他应收款	33,050.86	-
4	其他流动资产	5,100.64	-
5	长期应收款	-	-
6	长期股权投资	1,038.85	-
7	其他权益工具投资	3,324.00	-
8	其他非流动金融资产	33,309.25	33,309.25
9	其他非流动资产	1,575.69	-
10	投资性房地产	-	-

截至2025年12月31日，出于谨慎性考虑，公司持有财务性投资33,309.25万元，具体分析如下：

(1) 交易性金融资产

截至2025年12月31日，公司交易性金融资产余额为54,543.45万元，主要

系公司为提高资金使用效率，利用闲余资金投资银行理财，风险相对较低，不属于财务性投资范畴。

(2) 衍生金融资产

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未持有衍生金融资产，不涉及财务性投资。

(3) 其他应收款

截至 2025 年 12 月 31 日，公司其他应收款账面价值为 33,050.86 万元，主要系向供应商的产能保证金、其他押金和保证金等，不涉及财务性投资。

(4) 其他流动资产

截至 2025 年 12 月 31 日，公司其他流动资产余额为 5,100.64 万元，主要系公司待抵扣/待认证进项税、预缴所得税，不涉及财务性投资。

(5) 长期应收款

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在长期应收款，不涉及财务性投资。

(6) 长期股权投资

截至 2025 年 12 月 31 日，公司长期股权投资 1,038.85 万元，系公司 2024 年投资行至存储科技（苏州）有限公司股权，并委派一名董事，对其存在重大影响。行至存储科技（苏州）有限公司从事独立式铁电存储器（FRAM）芯片的设计、研发、销售和嵌入式存储 IP 服务。本项投资系对产业链上下游的战略投资，报告期内公司向其采购相关服务，符合公司主营业务及战略发展方向。不涉及财务性投资。

(7) 其他权益工具投资

截至 2025 年 12 月 31 日，公司其他权益工具投资 3,324.00 万元，主要系：

①公司 2020 年投资南京酷科电子科技有限公司 300.00 万元，该公司主营移动电源、充电器、数据线等品类研发与销售，属于公司芯片的下游终端应用场景；

②公司 2024 年投资江苏盘古半导体科技股份有限公司 3,024.00 万元；该公司系华天集团控股的子公司，主营先进封装业务，属于公司芯片的上游采购环节。

公司持有上述非上市公司股权的目的为非交易性质，对两家标的企业的投资

属于围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资。不涉及财务性投资。

(8) 其他非流动金融资产

截至 2025 年 12 月 31 日，公司其他非流动资产余额为 33,309.25 万元，主要系投资私募股权投资基金。

虽然该等私募股权投资基金已投项目或拟投资方向主要为半导体相关产业链、或围绕集成电路上下游领域，公司的投资目的也系围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，符合公司主营业务及战略发展方向。但考虑到发行人作为有限合伙人对该等基金的决策影响力相对有限、以及部分基金下游投资标的不完全与发行人主营业务协同，故基于谨慎性原则，仍然将上述基金均认定为财务性投资。

(9) 其他非流动资产

截至 2025 年 12 月 31 日，公司其他非流动资产 1,575.69 万元，为预付的长期资产购置款，不涉及财务性投资。

(10) 投资性房地产

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在投资性房地产，不涉及财务性投资。

综上所述，截至 2025 年 12 月 31 日，公司持有财务性投资 33,309.25 万元，未超过报告期末合并报表归属于母公司净资产 417,595.80 万元的百分之三十，公司不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资（包括类金融业务）的情形。

八、盈利能力分析

(一) 整体经营情况

报告期内，公司利润表主要项目如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入	326,053.93	256,720.99	178,040.23
营业成本	203,016.98	153,715.27	102,725.78
营业利润	23,702.12	30,342.54	26,269.37

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
利润总额	23,696.30	30,384.36	26,627.78
净利润	23,449.30	30,675.12	26,135.75
归属于母公司股东的净利润	23,860.02	30,690.12	26,135.75

公司致力于成为全球领先的模拟与嵌入式芯片设计厂商，专注于为消费电子、工业和汽车电子领域提供高性能的电源和电池管理解决方案。公司持续深化技术积累，增加研发投入，不断升级现有产品，持续扩充产品线，使得公司收入保持较快增长。报告期各期，公司分别实现营业收入 178,040.23 万元、256,720.99 万元和 326,053.93 万元，公司营收规模呈持续增长趋势。

（二）营业收入分析

1、营业收入构成

报告期内，公司营业收入总体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	325,755.66	99.91%	256,299.05	99.84%	178,030.91	99.99%
其他业务收入	298.27	0.09%	421.94	0.16%	9.32	0.01%
合计	326,053.93	100.00%	256,720.99	100.00%	178,040.23	100.00%

报告期内，公司主营业务收入分别为 178,030.91 万元、256,299.05 万元和 325,755.66 万元，主营业务收入主要来自模拟与嵌入式芯片业务。公司主营业务收入占营业收入的比例均在 99%以上，主营业务突出。

报告期内，公司其他业务收入分别为 9.32 万元、421.94 万元和 298.27 万元，主要为技术服务费产生的收入，占营业收入的比例较低。

2、主营业务收入按产品类别分析

报告期内，公司分业务类型的主营业务收入情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
移动设备电源管理芯片	204,988.47	62.93%	180,024.95	70.24%	138,081.41	77.56%
智慧能源电源管理芯片	49,974.04	15.34%	34,667.62	13.53%	16,422.05	9.22%
通用电源管理芯片	43,011.79	13.20%	33,055.51	12.90%	20,463.36	11.49%
汽车电子电源管理芯片	20,583.95	6.32%	8,550.97	3.34%	3,064.10	1.72%
微控制器	7,197.40	2.21%	-	-	-	-
合计	325,755.66	100.00%	256,299.05	100.00%	178,030.91	100.00%

凭借在集成电路先进设计行业多年的耕耘，公司在模拟与嵌入式芯片技术上积累了丰富的经验并保持行业领先地位，目前已形成以移动设备电源管理芯片为主，智慧能源电源管理芯片、通用电源管理芯片、汽车电子电源管理芯片、微控制器等业务快速发展的良好格局。

(1) 移动设备电源管理芯片收入变动分析

公司移动设备电源管理芯片包括有线充电管理芯片、无线充电管理芯片、锂电管理芯片、显示电源管理芯片，报告期各期实现营业收入分别为 138,081.41 万元、180,024.95 万元和 204,988.47 万元，占主营业务收入比例分别为 77.56%、70.24%和 62.93%。

移动设备电源管理芯片销售收入整体呈上升趋势，主要系公司依托在电源管理芯片领域多年来的积累，通过持续研发和产品迭代，新产品推广得以不断满足品牌客户产品需求，持续丰富端到端全链路的产品矩阵，进一步加强公司在移动设备电源管理领域的核心竞争力。

随着消费电子产品的快速更新换代，新兴智能设备终端推动消费电子领域电源管理芯片持续发展。报告期内，公司推出了压电驱动芯片、内置 MOS 升降压充电芯片、高集成度移动电源 SoC 等产品。其中，压电驱动芯片驱动的微泵液冷方案可大幅提升移动智能终端散热性能，填补了国产技术空白，除了液冷应用，该芯片还可广泛适用于触觉反馈、固态按键等压电驱动应用，在智能手机等设备中均能实现低功耗和高精度的控制。

此外，公司已积累了小米、荣耀、OPPO、vivo 等众多优质最终品牌厂商资源，保持长期稳定的合作，公司芯片得到了广泛市场认可和持续规模化应用，为报告期内移动设备电源管理芯片业务的快速增长提供了有力支持。

(2) 智慧能源电源管理芯片收入变动分析

公司智慧能源电源管理芯片包括 AC-DC 控制芯片、智能控制芯片、全集成芯片，报告期各期实现营业收入分别为 16,422.05 万元、34,667.62 万元和 49,974.04 万元，占主营业务收入比例分别为 9.22%、13.53%和 15.43%。

智慧能源电源管理芯片销售收入整体呈上升趋势，主要系报告期内公司顺应电源适配器小型化、集成化、通用化的发展趋势，持续推动全新 GaN 合封 PFC，逐步切入工业电源领域，受到市场认可。该等产品广泛适用于显示器电源模组、LED 驱动、电动工具和 e-Bike 充电器等对体积、效率和功耗均有严格要求的工业级电源应用场景。

例如，公司自研的全集成反激方案 POWERQUARK®能够进一步大幅减小适配器体积的同时提高转换效率，得到市场认可，未来有望持续带动公司智慧能源业务板块持续快速成长。

(3) 通用电源管理芯片收入变动分析

公司通用电源管理芯片包括通用充电管理芯片、DC-DC 芯片，报告期各期实现营业收入分别为 20,463.36 万元、33,055.51 万元和 43,011.79 万元，占主营业务收入比例分别为 11.49%、12.90%和 13.20%。

通用电源管理芯片销售收入整体呈上升趋势，主要系报告期内公司在储能、光伏、通信等应用领域推出了多款充电芯片，同时布局机器人、AI power 等新兴应用领域，积极拓展工业应用市场，产品谱系和竞争力不断提升。

(4) 汽车电子电源管理芯片收入变动分析

公司汽车电子电源管理芯片包括车载电源管理芯片、车载智能驱动芯片，报告期各期实现营业收入分别为 3,064.10 万元、8,550.97 万元和 20,583.95 万元，占主营业务收入比例分别为 1.72%、3.34%和 6.32%。

汽车电子电源管理芯片销售收入呈快速上升趋势，主要系汽车电动化、智能

化趋势对汽车电子芯片提出了新的需求，报告期内公司重点投入资源、积极布局汽车业务场景。公司从车载充电切入汽车头部厂商，打造了涵盖不同功率等级、支持多种公私有协议的全面车载充电产品组合，推出了多款功率高、协议兼容性强的车载充电芯片；通过持续新品研发，公司陆续推出了车规级高速 CAN/CAN FD 收发器、全新车规级升降压转换器及高边开关等产品，进一步扩大了公司在车载电源、驱动、传输领域的业务版图；目前，公司产品已覆盖车载电源管理芯片和车载智能驱动芯片。

（5）微控制器收入变动分析

2025 年收购昇生微以来，公司开始形成微控制器收入，2025 年实现营业收入 7,197.40 万元，占主营业务收入比例为 2.21%。

3、主营业务收入按销售区域划分

报告期内，公司的主营业务收入按销售区域划分情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内	171,260.35	52.57%	126,322.68	49.29%	98,506.74	55.33%
境外	154,495.30	47.43%	129,976.37	50.71%	79,524.17	44.67%
合计	325,755.66	100.00%	256,299.05	100.00%	178,030.91	100.00%

报告期内，公司境内收入分别为 98,506.74 万元、126,322.68 万元和 171,260.35 万元，占比分别为 55.33%、49.29%和 52.57%，占比保持相对稳定。

4、主营业务收入按销售模式划分

报告期内，公司的主营业务收入按销售模式划分情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
经销	254,044.60	77.99%	195,798.34	76.39%	149,524.85	83.99%
直销	71,711.06	22.01%	60,500.71	23.61%	28,506.06	16.01%
合计	325,755.66	100.00%	256,299.05	100.00%	178,030.91	100.00%

报告期内，公司经销收入分别为 149,524.85 万元、195,798.34 万元和

254,044.60 万元，占比分别为 83.99%、76.39%和 77.99%，收入占比有所下降，主要是由于 OPPO 等终端客户切换为直销客户、以及直销客户业务规模提升所致。

5、营业收入季节性分布情况

报告期内，公司营业收入的季节性分布情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第一季度	68,462.44	21.02%	60,184.98	23.44%	28,566.82	16.05%
第二季度	78,417.88	24.07%	64,824.60	25.25%	37,479.15	21.05%
第三季度	90,885.55	27.90%	64,900.35	25.28%	54,539.64	30.63%
第四季度	87,989.79	27.01%	66,811.06	26.02%	57,454.62	32.27%
合计	325,755.66	100.00%	256,720.99	100.00%	178,040.23	100.00%

报告期内，公司各季度营业收入占比受终端需求和交付周期的影响略有波动。

（三）营业成本分析

1、营业成本构成

报告期内，公司营业成本总体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	202,863.42	99.92%	153,491.31	99.85%	102,725.78	100.00%
其他业务成本	153.57	0.08%	223.95	0.15%	-	-
合计	203,016.99	100.00%	153,715.27	100.00%	102,725.78	100.00%

报告期内，公司主营业务成本分别为 102,725.78 万元、153,491.31 万元和 202,863.42 万元，与主营业务收入增长相匹配。公司营业成本主要由主营业务成本构成，报告期内主营业务成本占比分别为 100.00%、99.85%和 99.92%。

2、主营业务成本明细构成

报告期内，公司主营业务成本构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
材料成本	143,061.70	70.52%	109,147.32	71.11%	74,513.42	72.54%
委外加工	58,502.08	28.84%	42,900.36	27.95%	27,291.28	26.57%
其他成本	1,299.63	0.64%	1,443.63	0.94%	921.08	0.90%
合计	202,863.42	100.00%	153,491.31	100.00%	102,725.78	100.00%

报告期内，公司主营业务成本包括材料成本、委外加工和其他成本。其中材料成本和委外加工占比约为 99%，是公司主营业务成本的主要组成部分。报告期各期，公司主营业务成本结构基本保持稳定。

3、主营业务成本按产品类别划分情况

报告期内，公司主营业务成本按产品类别构成如下所示：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
移动设备电源管理芯片	123,571.07	60.91%	103,050.67	67.14%	78,245.51	76.17%
智慧能源电源管理芯片	36,587.15	18.04%	26,611.18	17.34%	11,348.40	11.05%
通用电源管理芯片	25,388.76	12.52%	19,183.19	12.50%	11,469.25	11.16%
汽车电子电源管理芯片	12,214.98	6.02%	4,646.28	3.03%	1,662.61	1.62%
微控制器	5,101.45	2.51%	-	-	-	-
合计	202,863.41	100.00%	153,491.31	100.00%	102,725.78	100.00%

报告期内，公司主营业务成本构成与其主营业务收入构成基本一致，变动趋势基本匹配。

（四）毛利率分析

1、营业毛利构成

报告期内，公司营业毛利构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	毛利率	金额	毛利率	金额	毛利率
主营业务毛利	122,892.24	37.73%	102,807.73	40.11%	75,305.13	42.30%
其他业务毛利	144.70	48.51%	197.99	46.92%	9.32	100.00%
合计	123,036.94	37.74%	103,005.72	40.12%	75,314.44	42.30%

报告期内，公司营业毛利金额分别为 75,314.44 万元、103,005.72 万元和 123,036.94 万元，其中主营业务毛利占比在 99%以上。报告期内，公司营业毛利不断提升，主营业务系公司毛利的主要来源。

2、主营业务毛利构成

报告期内，公司主营业务毛利构成情况如下所示：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
移动设备电源管理芯片	81,417.40	66.25%	76,974.28	74.87%	59,835.89	79.46%
智慧能源电源管理芯片	13,386.89	10.89%	8,056.44	7.84%	5,073.65	6.74%
通用电源管理芯片	17,623.03	14.34%	13,872.32	13.49%	8,994.10	11.94%
汽车电子电源管理芯片	8,368.97	6.81%	3,904.69	3.80%	1,401.49	1.86%
微控制器	2,095.95	1.71%	-	-	-	-
合计	122,892.24	100.00%	102,807.73	100.00%	75,305.13	100.00%

报告期内，公司主营业务毛利主要来自移动设备电源管理芯片，该产品类型下游主要面向消费电子领域，其毛利金额分别为 59,835.89 万元、76,974.28 万元和 81,417.40 万元，占主营业务毛利比例超过 65%。

3、毛利率分析

报告期内，公司综合毛利率及构成情况如下：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
主营业务毛利率	37.73%	40.11%	42.30%
其他业务毛利率	48.51%	46.92%	100.00%

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
合计	37.74%	40.12%	42.30%

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 42.30%、40.11%和 37.73%，存在一定波动，主要系在下游需求、产品售价、产品结构、材料及加工成本等多种因素影响下，毛利率出现一定下降。

4、主营业务毛利率分析

(1) 按产品类别分析

公司提供的芯片类型较多，毛利率水平存在一定差异，不同毛利率水平的产品的收入结构变化，将直接影响各产品或服务对综合毛利率的贡献度。报告期内，公司主营业务各产品线毛利率情况如下表所示：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
移动设备电源管理芯片	39.72%	42.76%	43.33%
智慧能源电源管理芯片	26.79%	23.24%	30.90%
通用电源管理芯片	40.97%	41.97%	43.95%
汽车电子电源管理芯片	40.66%	45.66%	45.74%
微控制器	29.12%	-	-
合计	37.73%	40.11%	42.30%

报告期内，移动设备电源管理芯片毛利率分别为 43.33%、42.76%以及 39.72%，2025 年移动设备电源管理芯片毛利率存在一定波动，主要系受产品结构、以及终端市场移动设备竞争加剧传导的降价压力综合影响所致。

报告期内，智慧能源电源管理芯片毛利率分别为 30.90%、23.24%以及 26.79%。智慧能源电源管理芯片毛利率下降主要系所属适配器等市场较为传统，受产品结构影响，毛利率存在一定波动。

报告期内，通用电源管理芯片毛利率分别为 43.95%、41.97%以及 40.97%。通用电源管理芯片应用场景广泛，如工业、通信等领域，毛利率最近一年一期保持相对稳定。

报告期内，汽车电子电源管理芯片毛利率分别为 45.74%、45.66%以及 40.66%。

随着公司新品持续迭代，产品结构不断丰富，汽车电子电源管理芯片毛利率维持在相对较高水平。2025年，汽车电子电源管理芯片毛利率存在一定波动，主要受产品结构影响所致。

2025年，完成收购昇生微之后，公司微控制器毛利率为29.12%。

(2) 分销售区域分析

报告期内，公司主营业务毛利率按销售区域分布情况如下：

单位：万元

项目	2025年度		2024年度		2023年度	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
境内	64,869.32	37.88%	49,567.35	39.24%	43,174.33	43.83%
境外	58,022.92	37.56%	53,240.38	40.96%	32,130.80	40.40%
合计	122,892.24	37.73%	102,807.73	40.11%	75,305.13	42.30%

报告期内，公司境内外销售毛利率存在一定差异，主要系产品结构、客户结构存在不同所致。2025年，毛利率波动主要受市场环境竞争激烈和产品结构变动的综合影响。

(3) 分销售模式分析

报告期内，公司主营业务毛利率按销售模式情况如下：

单位：万元

项目	2025年度		2024年度		2023年度	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
经销	94,521.92	37.21%	76,659.27	39.15%	62,956.51	42.10%
直销	28,370.32	39.56%	26,148.46	43.22%	12,348.62	43.32%
合计	122,892.24	37.73%	102,807.74	40.11%	75,305.13	42.30%

报告期内，公司经销、直销毛利率存在一定差异，主要系产品结构、客户结构存在不同所致，趋势上均与主营业务毛利率保持一致。

5、与同行业上市公司的对比分析

报告期内，公司与同行业可比公司毛利率对比情况如下：

可比公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
圣邦股份	50.94%	51.46%	49.60%
杰华特	26.37%	27.35%	27.40%
纳芯微	34.95%	32.70%	38.59%
思瑞浦	46.64%	48.19%	51.79%
艾为电子	35.43%	30.43%	24.85%
平均值	38.87%	38.03%	38.45%
公司	37.74%	40.12%	42.30%

报告期各期，公司毛利率位于同行业可比公司范围区间内。公司毛利率波动主要系移动设备电源管理芯片收入占比较高，该产品应用领域以手机、笔记本/平板电脑、电源适配器、智能穿戴设备等消费电子为主，虽然目前公司在工业、汽车等领域收入占比已持续扩大，但由于报告期内消费电子领域市场竞争激烈，且最终品牌方议价能力较强，毛利率容易承压。可比公司之中，圣邦股份、思瑞浦在工业控制、汽车电子等市场领域的收入占比较高，该等领域毛利率普遍高于消费电子领域，故上述公司毛利率水平相对较高。

（五）税金及附加分析

报告期内，公司税金及附加情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
城市维护建设税	322.94	325.38	301.01
房产税	218.75	200.52	-
教育费附加	189.01	191.19	179.36
印花税	182.33	142.43	94.91
地方教育附加	126.00	127.46	119.57
土地使用税	2.41	2.21	-
车船使用税	0.07	0.13	0.09
其他	0.03	0.03	0.03
合计	1,041.53	989.35	694.97

报告期内，公司税金及附加占营业利润比例较小，对经营业绩影响较小。

（六）期间费用分析

报告期内，公司期间费用情况如下表：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	13,379.01	4.10%	9,697.71	3.78%	7,792.56	4.38%
管理费用	24,437.41	7.49%	21,998.32	8.57%	15,365.87	8.63%
研发费用	64,714.51	19.85%	43,657.87	17.01%	29,251.71	16.43%
财务费用	-2,135.97	-0.66%	-7,137.00	-2.78%	-4,261.78	-2.39%
合计	100,394.96	30.79%	68,216.90	26.57%	48,148.36	27.04%

注：上表占比为占同期营业收入的比例。

报告期内，公司的期间费用占营业收入的比例分别为 27.04%、26.57%和 30.79%，随着公司业务规模不断扩大，销售费用、管理费用、研发费用金额均呈逐年增长趋势。

1、销售费用

报告期内，公司销售费用具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
职工薪酬	10,076.15	7,504.01	5,987.91
业务招待费	1,326.92	776.12	547.86
办公差旅费	732.16	834.31	535.93
折旧及摊销	486.44	362.16	356.61
广告和业务宣传费	5.61	88.49	76.11
样品及耗材费	127.93	76.67	215.41
租赁及物业费	30.07	0.85	46.40
其他	593.73	55.10	26.32
销售费用合计	13,379.01	9,697.71	7,792.56

报告期内，公司销售费用分别为 7,792.56 万元、9,697.71 万元和 13,379.01 万元，占各期营业收入的比重分别为 4.38%、3.78%和 4.10%，销售费用随收入规模的扩大总体呈上升趋势。

公司销售费用主要由职工薪酬构成。2023 年至 2025 年，公司销售费用中职工

工薪酬分别为 5,987.91 万元、7,504.01 万元和 10,076.15 万元，主要系公司业务规模和订单规模增长，扩充了销售及支持人员数量，职工薪酬相应增长。

2、管理费用

报告期内，公司管理费用具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
股份支付费用	7,568.93	9,940.68	7,135.18
职工薪酬	9,015.49	6,447.94	4,840.53
折旧及摊销	2,844.95	1,871.48	1,049.34
办公及差旅费	1,480.49	707.39	470.86
中介机构费	1,064.50	1,364.96	717.68
物料报废	626.40	535.88	273.61
物业费	429.05	354.11	189.24
业务招待费	512.93	247.58	190.89
短期租赁费用	315.17	34.49	3.21
上市杂费	0.00	-	267.06
其他	579.50	493.82	228.26
管理费用合计	24,437.41	21,998.32	15,365.87

报告期各期，公司管理费用分别为 15,365.87 万元、21,998.32 万元和 24,437.41 万元，股份支付费用和职工薪酬是主要组成内容。公司对核心员工进行股权激励。报告期各期，股份支付金额分别为 7,135.18 万元、9,940.68 万元和 7,568.93 万元。此外，报告期内，随着业务规模持续增加，公司扩充管理人员以完善管理架构，职工薪酬随之增加。

3、研发费用

报告期内，公司研发费用具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
职工薪酬	44,875.73	30,895.51	21,638.10
材料及测试费	14,627.96	9,415.26	5,440.84
折旧及摊销	1,635.21	1,462.71	1,510.66

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
其他	3,575.61	1,884.39	662.11
研发费用合计	64,714.51	43,657.87	29,251.71

公司高度重视技术和持续的产品研发创新，研发投入持续增加。报告期各期，公司研发费用分别为 29,251.71 万元、43,657.87 万元和 64,714.51 万元，主要由职工薪酬、材料及测试费构成，随着业务规模的持续扩大，研发人员数量逐步提升，带动研发费用金额逐渐增加。

4、财务费用

报告期内，公司财务费用具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
利息支出	132.34	39.81	287.30
其中：租赁负债利息支出	109.00	39.81	91.94
减：利息收入	3,443.80	6,075.86	4,354.01
利息净支出	-3,311.46	-6,036.05	-4,066.71
汇兑损失	1,446.49	810.57	4,218.50
减：汇兑收益	341.93	1,969.65	4,481.63
汇兑净损失	1,104.56	-1,159.09	-263.13
银行手续费	70.93	58.14	68.06
财务费用合计	-2,135.97	-7,137.00	-4,261.78

报告期各期，公司财务费用分别为-4,261.78 万元、-7,137.00 万元和-2,135.97 万元。公司财务费用主要受利息收入、汇兑损益影响，占营业收入比例相对不高。

(七) 其他收益

报告期内，公司其他收益具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
直接计入当期损益的政府补助	1,291.80	62.29	675.05
与递延收益相关的政府补助	670.92	68.89	35.01
个税扣缴税款手续费	184.88	61.72	23.45

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
合计	2,147.60	192.90	733.51

报告期内，公司其他收益分别为 733.51 万元、192.90 万元和 2,147.60 万元，主要来源于与日常活动相关的政府补助和个税扣缴税款手续费。

（八）投资收益

报告期内，公司的投资收益构成明细如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
权益法核算的长期股权投资收益	50.01	-94.39	-
理财产品收益	1,653.03	334.06	47.20
处置长期股权投资产生的投资收益	103.36	-	-
合计	1,806.40	239.67	47.20

报告期内，公司投资收益分别为 47.20 万元、239.67 万元和 1,806.40 万元，主要系交易性金融资产持有期间取得的理财产品投资收益。

（九）公允价值变动收益

报告期内，公司公允价值变动收益明细如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
交易性金融资产	143.45	201.32	-
合计	143.45	201.32	-

报告期内，公司公允价值变动收益分别为 0 万元、201.32 万元和 143.45 万元，系公司持有的交易性金融资产公允价值变动所致。

（十）信用减值损失和资产减值损失

报告期内，公司信用减值损失和资产减值损失情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度	
信用减值损失	应收账款坏账损失	-223.56	8.89	-106.88
	其他应收款坏账损失	-150.68	62.63	298.03

项目		2025 年度	2024 年度	2023 年度
合计		-374.25	71.52	191.15
资产减值损失	存货跌价损失	-1,645.80	-4,190.46	-1,198.06

报告期内，公司信用减值损失分别为 191.15 万元、71.52 万元和-374.25 万元，主要系计提的应收账款及其他应收款坏账准备，2023、2024 年其他应收款坏账损失为正，主要系其他应收款产能保证金减少、计提坏账准备冲回所致。

报告期内，公司资产减值损失分别为-1,198.06 万元、-4,190.46 万元和-1,645.80 万元，主要系随着业务规模扩大产生的存货跌价损失。

（十一）资产处置收益

报告期内，公司资产处置收益情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失	24.25	28.11	24.46
其中：固定资产	-5.73	1.27	23.50
使用权资产-租赁提前终止	29.98	26.84	0.96
合计	24.25	28.11	24.46

报告期各期，公司资产处置收益为处置固定资产、使用权资产租赁提前终止取得的收益。

（十二）营业外收支

报告期内，公司营业外收入情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
与企业日常活动无关的政府补助	-	5.00	350.40
赔偿款	46.00	209.42	-
其他	0.66	48.63	10.42
合计	46.66	263.05	360.82

报告期内，公司营业外收入主要为政府补助及赔偿款，赔偿款主要系公司物料报废相关的保险赔偿。报告期内营业外收入对公司经营业绩情况影响较小。

报告期内，公司营业外支出情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
非流动资产毁损报废损失	-	-	0.22
物料报废	25.89	211.49	-
捐赠支出		-	-
滞纳金	11.38		
其他	15.21	9.74	2.18
合计	52.48	221.23	2.40

公司营业外支出主要为物料报废，报告期内营业外支出对公司经营业绩情况影响较小。

九、现金流量分析

报告期内，公司现金流量的构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经营活动产生的现金流量净额	-7,745.10	44,332.48	20,816.73
投资活动产生的现金流量净额	-11,223.19	-124,880.18	-15,801.29
筹资活动产生的现金流量净额	2,147.33	-9,906.92	223,795.64
汇率变动对现金的影响额	-2,299.41	1,195.93	537.44
现金及现金等价物净增加额	-19,120.36	-89,258.68	229,348.52

（一）经营活动产生的现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	324,346.86	253,796.67	180,632.30
收到的税费返还	12,924.53	10,317.87	4,393.37
收到其他与经营活动有关的现金	8,211.52	9,446.09	7,086.07
经营活动现金流入小计	345,482.91	273,560.64	192,111.75
购买商品、接受劳务支付的现金	277,716.31	179,622.92	135,210.19
支付给职工以及为职工支付的现金	59,829.24	40,338.76	29,268.54

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
支付的各项税费	3,164.91	1,524.46	1,291.97
支付其他与经营活动有关的现金	12,517.55	7,742.02	5,524.32
经营活动现金流出小计	353,228.01	229,228.16	171,295.02
经营活动产生的现金流量净额	-7,745.10	44,332.48	20,816.73

报告期各期，公司经营活动现金流入金额分别为 192,111.75 万元、273,560.64 万元和 345,482.91 万元，主要来源于销售商品、提供劳务收到的现金。报告期内，公司销售回款情况良好，经营活动现金流入持续增长。公司收到其他与经营活动有关的现金分别为 7,086.07 万元、9,446.09 万元和 8,211.52 万元，主要为收到的押金及保证金。

报告期各期，公司经营活动现金流出金额分别为 171,295.02 万元、229,228.16 万元和 353,228.01 万元，主要为购买商品、接受劳务支付的现金和支付的职工薪酬。

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 20,816.73 万元、44,332.48 万元和-7,745.10 万元。2025 年，公司经营活动产生的现金流量净额为负，主要系备货增加支付的采购款、人员增加支付的薪酬增长综合所致。

（二）投资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司投资活动产生现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
收回投资收到的现金	764,400.00	231,500.00	21,672.24
取得投资收益收到的现金	1,968.46	334.06	50.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60.24	25.54	23.50
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	766,428.69	231,859.60	21,746.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,398.48	8,865.78	30,547.53
投资支付的现金	739,794.30	347,874.00	7,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,459.10	-	-
投资活动现金流出小计	777,651.88	356,739.78	37,547.53

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
投资活动产生的现金流量净额	-11,223.19	-124,880.18	-15,801.29

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-15,801.29 万元、-124,880.18 万元和-11,223.19 万元，主要是投资支付的现金、投资收回的现金所产生。

（三）筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司筹资活动产生现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
吸收投资收到的现金	3,760.63	3,317.66	240,105.53
取得借款收到的现金	11,600.00	21.95	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	8,687.16	27,025.05
筹资活动现金流入小计	15,360.63	12,026.77	267,130.57
偿还债务支付的现金	2,272.00	21.95	30,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,521.94	16,077.60	8,675.08
支付其他与筹资活动有关的现金	2,419.35	5,834.14	4,559.86
筹资活动现金流出小计	13,213.29	21,933.69	43,334.94
筹资活动产生的现金流量净额	2,147.33	-9,906.92	223,795.64

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 223,795.64 万元、-9,906.92 万元和 2,147.33 万元，筹资活动现金流出主要包括分配股利、利润或偿付利息支付的现金，偿还债务支付的现金等。2023 年度公司吸收投资收到的现金主要为公司首次公开发行并上市募集资金。

十、资本性支出分析

（一）报告期内重大资本性支出情况

报告期内，公司资本性支出紧密围绕主营业务进行，主要用于采购机器设备等。报告期各期，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 30,547.53 万元、8,865.78 万元和 24,398.48 万元。

（二）未来重大资本性支出计划及资金需求量

1、本次募集资金投资项目

公司未来重大资本性支出包括本次募集资金投资项目支出，具体详见募集说明书“第七节 本次募集资金运用”的相关内容。

2、芯片测试产业园建设项目

2025年2月28日，公司召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额以实施募投项目的议案》，并经2025年3月25日召开的公司2025年第一次临时股东会审议通过同意公司将原募投项目“测试中心建设项目”，变更为“芯片测试产业园建设项目”。具体详见募集说明书“第八节 历次募集资金运用”的相关内容。

（三）重大资本性支出与科技创新之间的关系

报告期内，公司资本性支出均围绕主营业务进行，通过持续的资本性支出投入，公司产品种类得以丰富、研发创新能力和运营管理能力得以提升，为公司的持续发展经营奠定了基础。

1、本次募集资金投资项目

本次募投项目聚焦公司模拟和嵌入式芯片主营业务，通过研发智能算力领域电源管理芯片、扩宽车载芯片产品线、开发工业应用的传感及控制芯片，能够满足公司研发布局与业务扩张需求，持续强化公司的科创实力，进一步助力公司突破国外厂商垄断，增强公司产品的市场竞争能力。本次募投项目系公司现有业务的延伸和拓展，所属领域属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024年修订）》第五条规定的“新一代信息技术领域”，符合科创板的行业范围。本次募投项目服务于科技创新领域，符合国家战略方向和行业发展趋势。

2、芯片测试产业园建设项目

“测试中心建设项目”变更主要是基于对市场和行业发展趋势的把握，为满足公司发展战略的规划，将“测试中心建设项目”变更成“芯片测试产业园建设

项目”，能够为公司研发和生产国产芯片提供基础保障；通过芯片测试研发和生产的一体化，提高公司产品测试技术能力；能够更有效地控制产品质量，提高生产效率，降低不良率和售后服务成本，提升公司产品质量管理水平；同时自主可控的测试产线有利于保障公司产品稳定供应，有利于公司降低产品测试成本；能够提升公司的核心竞争力，支持公司经营规模的提升，尤其是车规业务规模的发展，符合公司长期发展战略。

十一、技术创新分析

（一）技术先进性及具体表现

公司核心技术先进性及具体表现参见募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、公司主要技术与研发情况”之“（三）公司核心技术来源及其对发行人的影响”部分。

（二）正在从事的研发项目及进展情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司正在从事的研发项目如下：

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	高性能车载充电芯片项目	研发及量产阶段（非单一项目，下同）	1.USB 充电支持 PD、QC、UFCS、BC1.2、小米、OPPO 等协议。功率范围 15-100W； 2.无线充电支持 Qi2.0、MPP、小米、OPPO 等协议。功率范围 5-80W； 3.通过车规认证。	车载充电芯片进一步提高集成度，单芯片支持功率等级和转换效率将达到行业领先水平，具备高效率、高可靠性、高性价比的优点。	车载手机有线、无线充电、投屏等汽车电子领域
2	高性能车载驱动芯片项目	研发及试产阶段	1.集成温度、电流和电压等保护的智能驱动芯片； 2.支持 Limp Home 等智能保护模式； 3.导通阻抗从 2mohm-100mohm，支持 SPI 通讯模式。产品覆盖 1ch 到 6ch； 4.通过车规认证。	智能驱动芯片全面覆盖应用中所需的保护功能，达到行业领先水平。	车身控制和智能座舱等汽车电子领域
3	高性能车载电源管理芯片项目	研发及试产阶段	1.通用电源芯片集成 MOS 管，低静态电流，支持抖频功能； 2.专用电源芯片，集成多路 Buck, LDO, Boost，支持功能安全：ASIL_B 或者 ASIL_D。	车规级高集成电源芯片，低静态电流、支持抖频，满足 ASIL B/D 功能安全。	智能座舱与车身域、ADAS 与安全域
4	通用高性能充电管理芯片	研发及量产阶段	1、针对 1-18S 电池的各类充电拓扑架构，各种充电功率，各类	提供行业领先的充电效率和系统	消费电子、储能电源等领域

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
	片项目		主流应用的全系列覆盖； 2、充电效率的优化达到业界领先地位； 3、更高的集成度。	集成度。	
5	高性能 DC-DC 芯片项目	研发及量产阶段	1. 覆盖从 5V 输入到 100V 输入的应用； 2. 高集成度； 3. 高效率。	提供行业领先的电源效率、动态响应和系统集成度。	消费电子、工业、汽车等领域
6	面向消费类无线充电管理芯片项目	研发及送样阶段	1、手机接收端覆盖 15W-80W 全功率段； 2、发射端可为高端消费提供完整的 MPP/EPP 解决方案。	预期新产品可以实现更高的集成度及成本优势达到行业领先水平。	消费电子无线充电领域
7	面向消费类电子领域的高效率 AMOLED PMIC 芯片项目	研发及试产阶段	1. 针对手机应用的不同亮度范围进行效率优化，延长手机的续航时间，减少手机在亮屏情况下的发热情况； 2. 支持更大电流，提升手机屏幕亮度 ($\geq 2000\text{nit}$)，提升用户对手机屏幕的体验； 3. 针对未来新的屏幕技术，延长屏幕寿命，提前做好相关技术布局，兼容支持现在和未来不同手机屏幕的技术需求； 4. 针对笔电/平板等较大屏幕的消费类电子提供更高效更大电流的 AMOLED 屏幕供电解决方案； 5. 针对可穿戴等小尺寸 AMOLED 屏幕提供更高效更高续航更高亮度的 AMOLED 屏幕供电解决方案。	预期新产品在效率，功耗，最大亮度以及兼容不同种类屏幕等方面做到国际领先水平。	智能手机、平板、笔记本电脑等
8	有线充电管理芯片项目	研发及量产阶段	1. 针对单串和双串电池供电的设备提供大功率电荷泵充电方案，单颗芯片的充电功率覆盖 25W 到 120W。实现更高的功率密度和更高的效率； 2. 集成充电协议、功率路径管理和反向升压功能。实现更简化的系统设计。	1. 在不同充电功率挡位的芯片上达到领先的效率水平和功率密度。 2. 实现充电管理芯片的功能集成度和性能市场领先。	智能手机、平板电脑等消费电子领域
9	高性能充电管理芯片项目	研发及量产阶段	1、针对单串电池的充放电管理芯片，支持在各充电功率段使用并实现更高的集成度； 2. 针对 2 串或 2 并电池的充放电管理芯片，提供多元化的管理和更复杂的控制逻辑。	1. 实现行业领先的充电效率和系统集成度 2. 提供行业领先的电池充放电管理配套方案。	消费电子领域
10	面向智能终端的 DC-DC 芯片项目	研发阶段	1. 适配智能终端及其搭配的外部设备； 2. 高集成度；	提供行业领先的电源效率，动态响应和系统集成度。	消费电子领域

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
			3. 高效率。		
11	低功耗的电源芯片项目	研发阶段	1. 超低功耗的电源器件, 支持用小电池供电的系统, 以达到长续航; 2. 高集成度以降低外围成本。	提供行业领先的低功耗解决方案。	智能穿戴设备领域
12	面向消费电子的锂电管理芯片项目	研发及量产阶段	1、具备过压, 欠压, 过流保护功能; 2、最高支持 $\pm 15\text{mV}$ 的过压精度, 及 $\pm 0.75\text{mV}$ 过流检测精度; 3. 集成 ADC 的模拟前端产品, 支持高精度; 4、支持多串电池的采样, 计量, 保护及认证功能的电量计方案, 实现在高低温, 动态负载等多场景下 SOX 预估, 提供有利于电池循环寿命的充电算法; 5. 集成高精度, low offset ADC, 支持多通道轮询采样, 支持多种模数转换模式。达成 3mV 以内的全温范围电压采样精度, 及高精度电流转换; 6、可支持多种功耗模式匹配应用场景, 增加产品运行时间。	提高了保护精度, 支持更低的电流检测电阻, 实现国产芯片在大功率充电手机锂电应用上的突破; 提供电量计量软硬件方案, 进入锂电管理高端应用领域并实现技术突破。	智能手机
13	面向工业应用的电源管理芯片项目	研发及试产阶段	1、开发高性能数模混合控制器; 2、开发支持第三代半导体功率器件应用的控制器; 3、满足能效标准; 4、从系统应用的角度优化整体方案的性价比。	预期新产品具备创新性, 进入工业电源管理应用领域, 达到行业先进水平, 在系统整体成本方面体现优势。	充电器、储能电源等工业应用领域
14	面向消费类市场的 AC-DC 芯片项目	研发及试产阶段	1、丰富产品矩阵, 产品覆盖全功率段; 2、开发更高能效的产品, 并提高系统性价比; 3、在该领域应用第三代半导体, 并充分发挥其优势。	预期新产品具备创新性, 覆盖全功率应用领域, 达到行业领先水平, 在系统整体成本方面体现优势。	消费电子领域
15	面向消费类市场的快速充电协议芯片项目	研发及试产阶段	1、支持 USB PD、UFCS 以及其他私有快充协议并实现多协议兼容方案; 2、片上实现快充适配器系统的 LPS、AC 电压监测和 AC 输入状态监测等功能, 简化系统设计; 3、布局移动电源、磁吸充电宝、储能市场实现双向全快充协议如 PD、UFCS、SCP 以及主流的快充协议, 简化系统设计。	预期新产品的快充协议兼容性将达到国内领先地位, 满足高性能高可靠性的应用要求。	消费电子领域

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
16	面向便携电器的微控制器芯片项目	研发及试产阶段	MCU 整系统最低功耗做到 1uA 以内。 集成 2.5A 开关充的 MCU，充电效率超过 92%。 轻量级 GUI MCU 在同等资源消耗下做到业界领先的分辨率和刷新率。	预期新产品达到业界领先的低功耗水平，在产品成本方面体现优势	消费电子领域
17	传感器芯片	研发及试产阶段	研发高灵敏度、低噪声、低功耗通用传感器信号处理芯片，实现微弱信号高精度采集与数字化输出，具备强抗干扰能力与宽温适应性，满足工业与消费多场景应用。	集成度高、信噪比优异、功耗控制领先，达到国内先进、对标国际主流通用传感芯片性能水平	可广泛应用于工业监测、物联网终端、智能家居、医疗健康设备、消费电子及智能硬件
18	高压 DC-DC 芯片	研发及试产阶段	面向 AI 算力与数据中心研发高压大电流 DC-DC 电源芯片，实现宽电压输入、高效率电能转换，具备低纹波、高可靠性、快速瞬态响应，支撑高密度算力设备供电。	高压输入、大电流输出、高能效比、低电磁干扰、超高功率密度，达到算力领域高端电源芯片技术水准	主要用于 AI 服务器、GPU 加速卡、数据中心电源、边缘计算节点及高性能计算平台
19	多相电源管理芯片	研发及试产阶段	研发面向 AI 算力的多相电源管理芯片，实现多相交错精准控制、高效均流与快速动态调压，高功率密度、低损耗，满足大电流 AI 处理器核心供电需求。	多相协同控制精度高、动态响应快、稳压性能优异，达到国内领先、对标国际一线算力电源水平	为 GPU、AI 加速芯片、高端 CPU、算力 SoC 供电，广泛配套智算中心、AI 训练推理设备、高性能服务器

（三）保持持续技术创新的机制和安排

具体参见募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、公司科技创新水平及保持科技创新能力的机制或措施”之“（二）保持科技创新能力的机制或措施”。

十二、重大担保、诉讼或仲裁、其他或有事项和重大期后事项对发行人的影响

（一）重大担保事项

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在重大对外担保事项。

（二）重大诉讼、仲裁事项

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人不存在尚未了结的或可预见的对财务状况、盈利能力及持续经营产生重大影响的重大担保、仲裁、诉讼、其他或有负债和重

大期后事项。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》，募集说明书所指的“重大诉讼、仲裁”系指涉案金额超过1,000万，且占公司最近一期经审计总资产或者市值1%以上的未决诉讼、仲裁案件。

（三）其他或有事项

截至2025年12月31日，公司不存在需要披露的其他重大或有事项。

（四）重大期后事项

截至2025年12月31日，公司不存在需要披露的重大期后事项。

十三、本次发行对发行人的影响情况

（一）本次发行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合计划

本次发行完成后，本次募集资金投资项目将围绕公司主营业务展开，符合国家相关产业政策，具有较好的发展前景和经济效益。本次发行有利于进一步提高公司的盈利能力，巩固公司的行业领先地位，增强市场竞争力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

本次发行完成后，公司的资产规模有所提高，资金实力得到提升，为公司的后续发展提供有力保障。本次可转债转股前，公司使用募集资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。本次可转债的转股期开始后，若本次发行的可转债大部分转换为公司股票，公司的净资产将有所增加，资本结构将得到改善。

（二）本次发行完成后，上市公司新旧产业融合情况的变化

本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。因此，本次募投项目与现有业务密切相关，上市公司不存在本次发行完成后新旧产业融合情况发生重大变化的情况。

（三）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化

本次发行完成后，公司的实际控制人不会发生变化。

十四、经营业绩下滑的相关情况

（一）2025 年度、2026 年一季度经营业绩情况

1、2025 年度经营业绩

2025 年度，公司实现营业收入 326,053.93 万元，同比增长 27.01%；实现归属于母公司所有者的净利润 23,860.02 万元，同比下降 22.26%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 19,979.95 元，同比下降 33.45%，超过 30%。

公司 2025 年营业收入实现同比增长，主要系凭借在集成电路先进设计行业多年的耕耘，公司在模拟与嵌入式芯片技术上积累了丰富经验并保持行业领先地位，目前产品已覆盖消费电子、汽车电子、工业应用领域等核心赛道，并深度布局云网边端 AI 全场景，各条产品线均实现了较快收入增长态势。

公司 2025 年归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比下降，主要原因包括：（1）在下游需求、产品售价、产品结构、材料及加工成本等多种因素影响下，毛利率出现一定波动；（2）持续高强度研发投入，研发费用持续增长；（3）随着业务规模持续增加，公司员工人数快速增长，职工薪酬随之增加。

2025 年度，发行人经营业绩相关具体各个科目分析详见募集说明书“第五节 财务会计信息与管理层分析”的相关内容。

2、2026 年一季度经营业绩

根据发行人于 2026 年 4 月 30 日披露的《2026 年第一季度报告》（未经审计，后同），2026 年一季度，发行人实现营业收入 75,707.95 万元，同比增长 10.48%；实现归属于母公司所有者的净利润 333.83 万元，同比下降 94.74%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 132.66 万元，同比下降 97.64%。具体如下：

发行人 2026 年一季度主要经营数据及其变动情况具体如下：

单位：万元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动情况	
			金额	比例
营业收入	75,707.95	68,524.05	7,183.90	10.48%
营业成本	47,360.66	42,372.89	4,987.77	11.77%
销售费用	4,226.29	2,386.51	1,839.78	77.09%
管理费用	5,459.16	5,108.00	351.16	6.87%
研发费用	17,886.65	12,376.71	5,509.94	44.52%
财务费用	505.64	-560.30	1,065.94	-190.24%
营业利润	293.60	6,288.45	-5,994.85	-95.33%
利润总额	325.73	6,305.74	-5,980.01	-94.83%
所得税费用	130.00	8.95	121.05	1,352.51%
净利润	195.73	6,296.79	-6,101.06	-96.89%
归属于母公司所有者的净利润	333.83	6,349.26	-6,015.43	-94.74%
归属于公司普通股股东的非经常性损益	201.17	723.03	-521.86	-72.18%
扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润	132.66	5,626.23	-5,493.57	-97.64%

3、2026年一季度经营业绩变动分析

(1) 毛利额同比增长、毛利率与2025年度基本稳定，公司主营业务未发生重大不利变化

2026年1-3月，公司营业收入、营业成本同步增长上涨，毛利率基本稳定，主营业务毛利额同比增长。其中，主营业务毛利额较上年同期增长2,190.93万元；2026年1-3月主营业务毛利率37.44%，较2025年1-3月下降0.72个百分点，与2025年度37.73%基本持平。

公司毛利额和毛利率变动情况如下：

单位：万元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动情况
主营业务毛利额	28,341.73	26,150.80	增长2,190.93万元
其他业务毛利额	5.56	0.36	增长5.2万元
主营业务毛利率	37.44%	38.16%	下降0.72个百分点
其他业务毛利率	49.90%	50.25%	下降0.35个百分点

从主营业务各产品分类角度分析毛利率按业务类型划分及变动情况如下：

项目	2026年1-3月		2025年1-3月	
	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
移动设备电源管理芯片	37.84%	67.04%	39.28%	66.50%
智慧能源电源管理芯片	28.61%	12.41%	29.35%	14.74%
通用电源管理芯片	48.91%	11.45%	40.40%	12.36%
汽车电子电源管理芯片	36.19%	6.82%	42.55%	6.40%
微控制器	19.99%	2.29%	-	-
合计	37.44%	100.00%	38.16%	100.00%

公司主营业务毛利率同比小幅下降主要原因系：①虽然目前公司在工业、汽车等领域的产品收入占比已持续扩大，但公司移动设备电源管理芯片收入占比仍然最高，该产品应用领域以手机、笔记本/平板电脑、电源适配器、智能穿戴设备等消费电子为主，由于2026年1-3月消费电子市场竞争仍然激烈，导致上游芯片价格承压，进而使得移动设备电源管理芯片毛利率承压，影响公司整体毛利率水平；②公司提供的芯片类型较多、并持续丰富产品类型，不同种类的芯片由于市场定价、成本构成等原因，其毛利率水平本身存在一定差异，不同产品的收入占比发生变化，将直接影响综合毛利率；例如，公司微控制器毛利率相对较低，随着该等产品的收入占比提升，一定程度上导致了整体毛利率存在波动。

从整体来看，公司2026年1-3月毛利率与2025年度基本稳定，随着业务规模的扩大、营业收入持续同比增长，毛利额也同比实现了增长。因此，公司主营业务未发生重大不利变化。

(2) 随着持续高强度研发投入、员工人数和职工薪酬大幅增长等因素，费用增速超过营业收入和营业毛利增速，导致经营业绩出现下滑

2026年1-3月，公司扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润132.66万元，较2025年同期减少5,493.57万元，主要原因为：

①持续高强度研发投入，研发费用大幅增长

公司研发费用、研发人员数量变化情况如下表所示：

单位：万元、人

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动额	变动率
研发费用	17,886.65	12,376.71	5,509.94	44.52%
其中：研发人员薪酬	14,534.69	9,517.31	5,017.38	52.72%
期末研发人员数量	849	587	262	44.63%

2026年一季度公司研发费用为17,886.65万元，较上年同期增加5,509.94万元，增幅44.52%；主要系公司密切跟踪最新市场需求，持续展开产品迭代和技术创新，持续加大研发投入，研发队伍继续壮大，研发人员持续增加，2026年一季度末研发人员数量较上年同期末增加262人，同比增长44.63%，研发人员薪酬较同期增长5,017.38万元，同比增长52.72%。研发投入的持续增加，是公司布局核心技术、强化产品竞争力的战略选择，但也在短期对盈利表现产生了直接影响，由于研发支出的增长，叠加相关投入的效益释放存在一定周期，从而降低公司2026年一季度净利润水平。

②员工人数和职工薪酬大幅增长

除研发人员外，公司整体员工人数亦持续增长，导致职工薪酬大幅增加。

1) 销售费用

公司销售费用、销售人员数量变化情况如下表所示：

单位：万元、人

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动额	变动率
销售费用	4,226.29	2,386.51	1,839.78	77.09%
其中：销售人员薪酬	3,415.65	2,157.77	1,257.88	58.30%
期末销售人员数量	171	113	58	51.33%

2026年一季度公司销售费用为4,226.29万元，较上年同期增加1,839.78万元，增幅77.09%。主要原因系公司业务规模与订单规模持续增长，公司相应扩充销售及支持人员，职工薪酬随之增加。其中，销售人员数量由2025年同期期末的113人扩充至171人；销售人员薪酬较上年同期增长1,257.88万元，增幅58.30%。

2) 管理费用

公司管理费用、管理费用对应员工数量变化情况如下表所示：

单位：万元、人

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动额	变动率
管理费用	5,459.16	5,108.00	351.16	6.87%
其中：管理费用职工薪酬	2,688.91	1,928.92	759.99	39.40%
期末管理费用员工数量	222	162	60	37.04%

2026年一季度公司管理费用为5,459.16万元，较上年同期增加351.16万元，增幅6.87%。其中，随着公司整体业务规模扩大，管理及支持相关人员数量从2025年同期期末162人扩充至222人，管理费用职工薪酬较上年同期增长759.99万元，增幅39.40%。

③财务费用增长

公司财务费用各项目变动情况如下：

单位：万元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动额	变动率
利息支出	104.22	10.81	93.41	864.11%
减：利息收入	625.65	263.20	362.45	137.71%
汇兑净损失	1,014.71	-320.24	1,334.95	416.86%
银行手续费	12.36	12.33	0.03	0.24%
财务费用合计	505.64	-560.30	1,065.94	190.24%

公司2026年一季度财务费用较2025年度同期增长190.24%，主要原因系2026年一季度公司汇兑产生净损失1,014.71万，而上年同期汇兑净收益320.24万元，波动幅度较大，主要系公司的日常经营及采购涉及美元结算较多，常年会维持一定规模的美元净敞口；2026年美元兑人民币汇率呈现单边下跌态势，对公司美元净敞口形成较大影响，导致本期汇兑损失显著增加。

(3) 归属于公司普通股股东的非经常性损益的影响

2026年一季度公司归属于公司普通股股东的非经常性损益201.17万元，较上年同期减少521.86万元，主要是公司2025年一季度将闲置资金配置于收益率相对更高的结构性存款，而本期结构性存款减少，导致理财产品收益较上年减少530.35万元，进而导致相应的经常性损益较上年度增加、非经常性损益相应减少。

综上所述，2026年一季度公司扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润

较 2025 年一季度同比下降超过 30%，其中：①公司主营业务未出现重大不利变化，营业收入、主营业务毛利额、其他业务毛利额均实现同比增长；②由于公司持续高强度研发投入，且随着业务规模扩大、员工人数大幅增长、职工薪酬特别是研发人员薪酬随之增加等因素，短期内费用增速超过营业收入和营业毛利增速，对盈利表现产生了直接影响，而相关投入的效益释放存在一定周期，故在相关因素叠加影响下，公司 2026 年一季度净利润水平有所下降。

因此，公司经营业绩下滑的情况具有其合理性。

（二）经营业绩下滑相关情况在上市委会议前已合理预计并充分提示风险

2026 年 4 月 1 日上市委会议前，公司经营业绩下滑相关情况已合理预计，公司于 2026 年 2 月 28 日披露《2025 年业绩快报公告》，并且公司已对 2025 年度财务数据及其相关风险因素在《募集说明书》“重大事项提示”之“四、特别风险提示”之“（一）公司业绩下滑的风险”充分披露。

（三）经营业绩下滑相关情况不会对公司当年及以后年度经营、本次募投项目、上市公司的持续经营能力产生重大不利影响

1、经营业绩下滑相关情况不会对公司当年及以后年度经营、持续经营能力的产生重大不利影响

2025 年度、2026 年 1-3 月，发行人营业收入同比增长，但净利润同比下降主要是由于市场竞争导致毛利率波动、持续高强度研发投入、员工人数快速增长导致职工薪酬大幅增长、而研发投入的经济效益释放存在一定周期所致。随着未来公司产品持续迭代，相关投入的效益逐步释放，发行人盈利能力将会得到改善和提升，经营业绩下滑的情况对发行人当年及以后年度经营、持续经营能力不会产生重大不利影响。

2、经营业绩下滑相关情况对本次募投项目的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策和行业发展趋势，与公司主营业务契合，具有良好的市场前景和经济效益。本次募集资金投资项目有助于提升公司管理经营能力，优化公司业务结构，实现新的盈利增长点，进一步增强公司盈利能力和行业竞争力。本次募集资金投资项目的实施是公司发展的切实需要，符合公司未来战略发展方向。同时，本次募集资金投资项目将为公司后续发展提

供有力支持，未来将会进一步增强公司的可持续发展能力。公司短期经营业绩变动不会对本次募投项目造成重大不利影响。

综上所述，经营业绩下滑相关情况不会对公司当年及以后年度经营、本次募投项目、上市公司的持续经营能力产生重大不利影响。

第五节 本次募集资金运用

一、本次发行募集资金使用计划

(一) 本次募集资金投资项目概况

本次发行的募集资金总额不超过人民币 158,688.10 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金额	备案项目代码	备案时间
1	智能算力领域电源管理芯片研发及产业化项目	45,923.95	39,109.08	2512-310115-04-05-482724	2025 年 12 月
2	车载芯片研发及产业化项目	84,334.43	66,363.24	2512-310115-04-04-567309	2025 年 12 月
3	工业应用的传感及控制芯片研发及产业化项目	63,079.74	53,215.78	2512-310115-04-04-303092	2025 年 12 月
合计		193,338.11	158,688.10	-	-

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施的重要性、紧迫性等实际情况先行投入自有或自筹资金，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，经公司股东会授权，公司董事会（或董事会授权人士）将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

(二) 本次募集资金投资项目与现有业务或发展战略的关系

公司是国内领先的平台型模拟与嵌入式芯片设计企业，主营业务为模拟与嵌入式芯片的研发、设计和销售。公司现有产品已覆盖移动设备电源管理芯片（含有线充电管理芯片、无线充电管理芯片、锂电管理芯片、显示电源管理芯片、其他移动设备电源管理芯片）、智慧能源电源管理芯片、通用电源管理芯片、汽车电子芯片和微控制器（MCU），通过打造完整的产品矩阵，满足客户系统应用

需求。

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目为智能算力领域电源管理芯片研发及产业化项目、车载芯片研发及产业化项目、工业应用的传感及控制芯片研发及产业化项目，是在现有主营业务的基础上，结合市场需求和未来发展趋势，加强公司研发实力，加大对公司核心业务领域重点产品及重要研究方向实施的投资。本次募投项目建成投产后，将丰富和拓展公司各个产品线的系列谱系，进一步提高公司产品的竞争力和市场份额，带动半导体产业链上下游的协同发展。

二、募集资金投资项目的基本情况及可行性分析

（一）智能算力领域电源管理芯片研发及产业化项目

1、项目基本情况

项目名称	智能算力领域电源管理芯片研发及产业化项目
实施主体	上海南芯半导体科技股份有限公司
项目总投资	45,923.95 万元
项目建设期	3 年
项目建设内容	本项目将基于公司现有电源管理产品技术，解决大电流场景下多相架构电流均衡、精确移相等技术问题，开发多相控制器、DrMOS、大电流 DC-DC、大电流 PMIC、高压电源等针对大电流应用需求场景的电源管理产品，为 CPU/GPU 等各类大负载芯片/终端提供电源管理方案。项目计划在上海浦东租赁场地并购置研发、检测及办公所需相关设备，引入项目研发所需人员，在三年左右的研发周期内完成新产品的的设计、验证，最终实现量产。 项目产品将运用于 PC、数据中心、带边缘计算的智能终端、能源等大电流环境下的多个领域。公司将按照“云、网、边、端”构筑多维度的产品体系，覆盖各类算力应用领域的需求；此外，公司还将开发应用于工业电脑、安防、光伏、储能等多领域的大电流电源管理产品。项目的实施有助于公司抓住市场发展窗口期，拓宽业务范围，提升公司盈利能力。同时，项目的实施也是公司顺应国家政策及行业发展趋势的决策，有助于重塑行业当前竞争格局，推动技术突破。
项目建设地点	上海市浦东新区

2、项目必要性分析

（1）打破国外厂商的垄断，提升公司行业地位

随着 AI 大模型参数规模从百亿级迈向万亿级、多模态应用（文本+图像+音频+视频）普及，以及边缘 AI 场景（自动驾驶、工业质检等）的渗透，传统算力

供给模式已难以满足“高吞吐、低延迟、低能耗”的需求，算力跃升成为 AI 技术落地与产业升级的核心支撑。AI 算力的跃升对包括 CPU、GPU 在内的大芯片提出了更高性能（更高主频/更大算力）的要求，其主板对供电系统的要求也随之升级。因此，传统的供电方案无法满足其需求，行业逐步衍生出多相电源方案及其他大电流场景的供电方案。多相电源方案是较主流的 CPU/GPU 等各类大负载芯片/终端的供电方案，其优势在于通过多相轮流工作可将每一路应力降低，输出纹波更小、器件更紧凑、效率更高、发热更低。此外，多相电源还可以根据 CPU/GPU 负载实时调整供电相数，既可以满足高负载时的供电需求，也可以在低负载状态下起到节能的作用。

目前大电流场景的供电方案核心供应商以 MPS、英飞凌、瑞萨、AOS 等国际厂商为代表，凭借技术积累、产品成熟度及长期客户合作优势，在市场份额与技术话语权上保持领先。国内部分厂商也已在该领域开始布局，但产品研发到产业化落地仍需要一定时间。从行业趋势来看，随着国内企业在芯片设计、可靠性验证、供应链整合等环节的持续发力，叠加下游终端厂商对供应链安全的重视度提升，后续大电流场景的供电方案的国产替代进程有望加速推进。同时，在 PC、服务器等领域，我国均是全球最主要的消费市场及生产基地，因此，国内电源管理芯片厂商更贴近终端客户，在产品的协同开发、售后响应速度等方面具备优势，市场格局存在进一步优化的空间。

公司需把握下游市场发展的战略机遇期，推进面向大电流场景的供电方案的研发进程，确保技术与市场需求同频。同时，可依托政策红利，抓准下游市场放量时机，通过快速渗透核心客户，驱动收入规模与市场占有率的跃升，以推动公司发展更上一个台阶。

（2）增加技术储备，提升公司核心竞争力

本项目将聚焦于大电流场景下的电源管理技术的开发，开发多相架构的电源管理等产品。多相电源由多相控制器和 DrMOS 组成，是专为 CPU/GPU 等大负载芯片供电的大电流 DC-DC，属于模拟芯片中门槛较高的核心赛道。

多相控制器的技术难点在于控制各相支路电流均衡以及驱动信号精确移相。相对于单相变换器，多相交错并联变换器控制策略更加复杂。一方面受制造工艺

的影响，多相电源内每一相的元器件实际参数很难做到完全一致，参数差异将会导致各相支路电流不均衡，降低系统稳定性和使用寿命，为解决并联均流问题需要在电源拓扑设计上进行改良，往往需要增加额外电路进而导致电路复杂度提升。另一方面，单相变换器只需要一路驱动信号，而多相交错并联变换器需要多路驱动信号，并且多路驱动信号之间需要有一定的相位差，这对于控制器的信号控制策略提出较高要求。

DrMOS 的主要难点在于制造工艺，需要长时间的积累和迭代。根据封装及制造工艺，DrMOS 可分为单晶(单 Die)及合封两类方案，前者将驱动 IC、MOSFET 等器件集成在同一颗 Die 上，后者是将多颗 Die 封装在一颗芯片中。其中，合封方案可针对驱动 IC 及 MOSFET 采用不同工艺制造，以达到性能（如大电流）与成本优化的目的，缺陷在于堆叠封装的方式可能导致器件散热面积有限，其难点在于封装技术以及供应链整合。单晶方案优势在于：更高集成度、强驱动能力、快速开关能力等，但其难点在于高压 BCD 工艺、设计、封装等环节构成的综合性壁垒。

本项目将在公司已经积累的电源管理技术的基础上，针对上述开发难点，探索可扩展的先进拓扑结构设计与工艺技术。项目旨在沉淀适用于 PC、AI 服务器、边缘计算智能终端等大电流场景下的电源管理方案设计能力，为公司构筑长期竞争壁垒，提升公司核心竞争力。

(3) 丰富公司产品矩阵，打造新的业务增长极

公司长期深耕电源管理赛道，已构建起覆盖消费电子、汽车、储能、光伏、通信等多领域的成熟产品矩阵，凭借高性能、高可靠性、高性价比和快速交付能力，稳居国内模拟芯片第一梯队，为公司构筑了持续而稳健的业务根基。然而，与国际龙头企业相比，公司在产品品类丰富度、市场渗透深度和广度仍存在显著差距。为实现更远大的发展突破，公司近年来努力夯实现有产品的产业护城河，巩固基本盘优势；同时，积极主动拓宽产品能力边界，加速向具备高价值、高增长潜力的泛人工智能领域（PC、AI 服务器、AI 端侧产品等）延伸，打造新增长曲线。

本项目实施后，公司将新增大电流场景下的电源管理产品。在算力领域，公

公司将构筑运用于“云、网、边、端”多维度的丰富产品线，搭建覆盖数据中心、网络设备、边缘计算终端等应用场景的产品体系；此外，公司将开发应用于工业电脑、安防、光伏、储能等多领域的大电流场景的电源管理产品。随着 AI 算力需求的跃升，公司将以技术迭代为核心动力，持续挖掘下游增量市场空间，不断丰富现有产品矩阵，构建新的成长曲线，提升公司在未来市场中的竞争优势。

3、项目可行性分析

（1）项目契合国家政策导向，具备政策可行性

人工智能行业的发展是国家科技自主与产业升级重要抓手，是国家的战略核心产业之一。2017 年 7 月，国务院印发《新一代人工智能发展规划》，将人工智能上升到国家战略层面，明确到 2025 年人工智能基础理论实现重大突破，部分技术与应用达到世界先进水平，带动相关产业规模 5 万亿元，到 2030 年中国人工智能理论、技术与应用总体达到世界先进水平，核心产业规模超过 1 万亿元，带动相关产业规模 10 万亿元。2021 年 3 月，中共中央发布《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二零三五年远景目标》，推动大数据、人工智能等产业融合发展，培育新技术、新产品、新业态、新模式。2023 年 4 月，网信部印发《针对生成式人工智能服务出台管理办法》，支持人工智能基础技术的自主创新和推广应用。2024 年 6 月，工信部、网信办、发改委和标准化委员会四部门联合发布了《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024 版）》，提出到 2026 年，标准与产业科技创新的联动水平持续提升，新制定国家标准和行业标准 50 项以上，引领人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。

本项目围绕 AI 领域设计多个研发课题，将形成多相控制器、DrMOS 等应用于大电流环境的多品类电源管理产品，填补国内在 AI 芯片领域的技术空缺，与国家顶层设计高度同频，属于国家和地方政府高度支持的产业，因此，项目的建设具备政策可行性。

（2）大电流环境电源管理产品市场将持续放量，项目具备市场可行性

PC 和服务器是对大电流环境下的电源产品（如多相电源）的主要出货渠道。根据 IDC 数据，预估 2025 年全球传统 PC（包括台式机、笔记本和 workstation，不含平板和 x86 服务器）出货量达到 2.74 亿台，按照单位多相电源价值量约 4~5

美元(若考虑独显则单机价值量或提升至 6~7 美元),对应市场空间约 10.96~13.70 亿美元;另一方面,根据中商产业研究院数据,2025 年预计全球服务器出货量达 1,630 万台,按照单台服务器的多相电源价值量约为 50~70 美元测算,当前服务器市场约对应 8.15~11.41 亿美元的多相电源需求。

此外,多相电源产品在 AI 服务器中单机价值增量显著,GPU 算力升级进一步推动量价齐升。AI 服务器与通用服务器主要区别在于 AI 服务器配备 4/8 颗 CPU/GPU,以满足高性能计算需求。根据 IDC&浪潮信息联合发布的《2025 年中国人工智能算力发展评估报告》,2024 年全球 AI 服务器市场规模预计为 1,251 亿美元,2025 年将增至 1,587 亿美元,2028 年有望达到 2,227 亿美元;2024 年中国 AI 服务器市场规模达到 190 亿美元,2025 年将达到 259 亿美元,同比增长 36.2%,2028 年将达到 552 亿美元。随着 AI 服务器需求的持续释放,智能算力领域芯片在服务器领域的市场空间有望进一步扩大。

同时,多相电源芯片通过“高效转换-动态控制-智能管理”三位一体,成为 AI 端侧产品动力革新的核心引擎。随着宽禁带半导体与 AI 算法的深度结合,其在 AI 端侧产品领域的渗透将加速向“超低损耗、超高响应”演进。

传统 PC、服务器市场容量庞大,叠加 AI 服务器带来的新市场需求将为多相等大电流电源产品带来较大的市场增量,光伏、储能等多领域的应用更增加了大电流电源产品的市场规模。良好的市场前景为本项目产品构建起坚实的市场基础与广阔的发展空间,确保产品能够顺利推向市场,保障项目的顺利实施。

(3) 项目依托公司优秀的研发及工艺开发实力,具备技术可行性

大电流场景下的电源管理芯片的研发具有较高的技术壁垒,公司目前已在技术、人才、工艺研发方面有充分储备,能够应对项目产品开发过程中的技术难题。在技术储备方面,公司经过多年技术积累,已储备了“多相控制技术”等相关技术。在人才方面,公司截至 2025 年末,公司研发人员数量增至 840 人,研发人员数量占公司员工总数的比例为 68.13%,且公司目前已拥有核心专家及自研工艺团队,为项目的开展奠定了人才基础。在工艺方面,公司拥有从工艺器件开发到 SPICE 模型和 PDK 的全流程自研能力。近年来,公司积极开展与供应商的合作共研,发展 BCD 特色工艺,同时具备多样化的封装工艺,将赋能 DrMOS 的

工艺研发与技术迭代。

本项目依托公司人才优势、技术积累、自主可控的工艺开发平台能够顺利完成项目研发、流片、验证、工艺开发及量产的全流程，降低项目实施风险，确保项目技术可行、风险可控、保障项目的顺利实施。

4、项目实施和投资概算

本项目建设总投资 45,923.95 万元，具体投资明细如下：

序号	项目	项目资金（万元）	占比
1	建设投资	11,055.13	24.07%
1.1	场地租赁及装修费	2,196.00	4.78%
1.2	设备购置费用	8,333.13	18.15%
1.3	预备费	526.00	1.15%
2	研发费用	31,579.95	68.77%
2.1	人员费用	25,524.80	55.58%
2.2	其他研发费用	6,055.15	13.19%
3	铺底流动资金	3,288.88	7.16%
4	项目总投资	45,923.95	100.00%

5、项目建设进度安排

本项目建设期为 36 个月，项目实施进度安排具体如下：

序号	项目	T+1				T+2	T+3
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1-Q4	Q1-Q4
1	房屋租赁及装修						
2	设备购置与安装调试						
3	人员的招聘与培训						
4	产品研发						
5	产品测试及试产						

6、效益预测的假设条件及主要计算过程

本次募投项目预计所有收入全部来源于产品销售收入，本项目营业收入的测算系以公司或市场同类型产品的销售单价为基准，基于谨慎性原则，完全达产年度预计销售收入为 80,750.00 万元。

本项目的成本主要包括产品的晶圆成本、封测成本，系参考公司或市场同类型产品的采购价格及趋势确定。销售费用、管理费用系参考公司历史费用占比确定，研发费用系根据项目相关人员成本、流片费、测试试制费、折旧摊销费等确定。折旧摊销费用按平均年限法计算，机器设备折旧年限按 5 年计算，残值率为 0.00%；计算机及电子设备按 5 年折旧，残值率 0.00%，装修按 5 年摊销，残值率 0.00%，软件按 3 年摊销，残值率 0.00%。

增值税按照 13%测算；城市维护建设税、教育费附加税、地方教育附加税分别按照增值税的 7%、3%、2%进行计提；企业所得税率按 15%测算。

经测算，本项目税后财务内部收益率为 15.10%，项目税后静态投资回收期为 6.74 年（含建设期），具有良好的经济效益。

7、项目备案、环评事项及进展情况

截至本募集说明书摘要出具之日，本项目已完成项目备案手续（项目代码：2512-310115-04-05-482724）；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，本项目无需环评；本项目不涉及新增用地。

（二）车载芯片研发及产业化项目

1、项目基本情况

项目名称	车载芯片研发及产业化项目
实施主体	上海南芯半导体科技股份有限公司
项目总投资	84,334.43 万元
项目建设期	3 年
项目建设内容	<p>本项目围绕汽车车身系统、座舱系统和智驾系统多领域，布局传感芯片、通信芯片、驱动芯片、控制芯片、和电源管理芯片多种功能的芯片，开发自有车规工艺的电源管理产品和整合车规工艺的功率器件产品、高速传输类产品、面向车身控制的 MCU 产品、多模传感芯片及其他产品，助力公司拓宽在汽车芯片领域的产品布局，逐步形成从供电、充电管理到传输、感知、决策、执行的完整车载芯片生态系统。</p> <p>项目的实施有助于公司把握汽车电动化趋势叠加智能驾驶的技术导入窗口期，扩大市场份额，提升公司在车载芯片领域的市场地位，提升盈利能力。同时，项目顺应政策导向，增强公司在汽车芯片产业方面的技术积累，并助力汽车芯片的国产替代进程加速。</p>
项目建设地点	上海市浦东新区

2、项目必要性分析

(1) 提高芯片国产化率，保障汽车芯片供应链自主可控

随着我国新能源汽车产业的蓬勃发展，进一步凸显了车载芯片自主化的战略紧迫性。根据北京半导体行业协会数据，我国汽车芯片行业整体国产化率偏低，各类产品的国产化率均不足 10%，部分品类如计算、控制类芯片国产化率甚至小于 1%。核心原因在于汽车芯片行业准入门槛较高，企业需经过长期技术积淀与生产经验积累才可实现关键技术与量产能力的突破。长期以来，国际大型汽车电子企业如英飞凌、恩智浦、瑞萨、德州仪器、意法半导体等国际头部汽车电子企业凭借其深厚的技术积累与丰富的产业经验，在全球汽车芯片市场中占据主导地位，国内厂商目前仍处于追赶阶段。

当前，汽车已成为重要的移动信息终端，其芯片需处理动力控制、自动驾驶、座舱娱乐、云端通信等多维度核心数据。若长期大量依赖国外芯片，将面临数据泄露与远程操控的安全隐患。与此同时，近年来受贸易摩擦、地缘政治冲突等因素影响，国外汽车芯片及相关零部件供应稳定性显著下降，供应链断供风险持续攀升。因此，从供应链安全出发，下游整车厂商亟需加快寻找国产替代芯片，逐步实现汽车芯片供应链的自主可控化。

本项目将在传感芯片、通信芯片、驱动芯片、控制芯片、电源管理芯片等核心领域聚焦突破，开展包括自有车规工艺的电源管理产品和整合车规工艺的功率器件产品、高速传输类产品、面向车身控制的 MCU 产品、多模传感芯片等多个系列产品的研发及产业化落地，推动汽车芯片产业的国产化发展。项目的实施符合国家政策及产业发展导向，契合公司自身发展战略，具有必要性。

(2) 紧跟汽车行业发展趋势，提升公司产品市场占有率

根据中国汽车工业协会统计数据，2024 年，我国汽车产销量分别完成 3,128.2 万辆和 3,143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%。其中，我国新能源汽车产销分别为 1,288.8 万辆和 1,286.6 万辆，同比分别增长 34.4%和 35.5%，新能源新车销量达到汽车新车总销量的 40.9%，同比增长 9.3%。

新能源汽车渗透率的提升及车辆智能化的发展将持续打开汽车芯片的增长空间。与传统燃油车相比，纯电动车动力系统更多依赖电动机和电动系统，对芯

片的需求量也相应提升。另外随着车辆智能化的发展，自动驾驶级别升高，传感器、主控芯片、存储芯片、功率半导体等多类型芯片的搭载量也将随之提升。据德勤的分析，L3 级别自动驾驶平均搭载 8 个传感器，而 L5 级别自动驾驶所需传感器芯片数量提升至 20 个。中国汽车工业协会数据显示，传统燃油车所需汽车芯片数量为 600-700 颗，电动车所需数量则提升至 1,600 颗/辆，而智能汽车对芯片的需求量约为 3000 颗/辆。

目前，汽车电动化趋势叠加智能驾驶的应用正在推动汽车芯片行业的发展，持续打开汽车芯片市场的增量空间。未来，全球整车厂将快速进入下一代技术的研发与供应链选型时期。对于车载芯片企业而言，这既是技术卡位的关键时期，也是扩大市场份额重要机会，业内企业已纷纷布局相关产品的研发及产业化落地。

本项目聚焦汽车车身系统、座舱系统和智驾系统等核心赛道，深化产品在汽车电动化、智能化方面等应用，借下游行业发展东风，逐步扩大市场占有率，为公司打造可持续、高壁垒的利润增长极。

(3) 完善汽车芯片产品矩阵，拓展公司产品应用范围

公司在消费电子领域的电源管理芯片已形成技术积累与规模优势；现有汽车电子电源管理芯片虽已布局，但车载芯片布局尚处拓展阶段，现有产品对汽车车身系统、座舱系统和智能驾驶等核心场景的覆盖范围较为有限，在产品品类、功能和性能等维度仍有较大提升空间。

从公司现有产品来看，车载电源管理芯片主要聚焦基础电源电压转换与保护，在满足智能驾驶系统对“千瓦级功率支撑、微秒级瞬态响应、车规级高可靠性”电源的需求上还有技术提升空间；车载智能驱动芯片则是侧重负载通断控制，还需再对车身控制、ADAS 域控等领域的复杂驱动与协同控制支持上进一步提升。而感知系统所需的车用传感芯片，智能驾驶场景下的高速传输芯片，以及面向车身控制的高集成 MCU 等，均为被国外巨头高度垄断、国内供给严重不足或技术门槛极高领域。

因此，本项目针对上述领域设置了相关研发方向。项目将围绕汽车车身系统、座舱系统和智驾系统三大应用领域，布局传感芯片、通信芯片、驱动芯片、控制芯片、电源管理芯片五大板块，开发自有工艺的电源管理产品、高速传输类产品、

面向车身控制、电源系统等领域的 MCU、多模传感芯片及其他产品。

本项目研发完成后，公司将大幅拓展在汽车各应用领域的产品覆盖范围，完善车载领域的产品矩阵，有效填补技术空白并强化产业链协同能力，为公司打开车载电子领域的增量市场空间奠定技术基础。本项目的实施符合公司未来发展战略，有助于公司继续拓展产品在车载领域的应用范围，增强盈利能力。

3、项目可行性分析

(1) 项目契合国家政策导向，具备政策可行性

2020年10月，国务院《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》首次将车规芯片与动力电池列为新能源汽车两大核心技术，并提出到2025年“车规级芯片等关键核心技术取得重大突破”，2035年实现“产业链供应链安全可控”的发展规划。2023年12月，工信部《国家汽车芯片标准体系建设指南》明确提出“2025年初步建立汽车芯片标准体系，2030年全面覆盖各类芯片及应用环节”的建设目标，并将“车载计算、功率驱动、传感器、通信及信息安全芯片”列为优先攻关方向。

项目研发方向围绕汽车传感芯片、通信芯片、驱动芯片、控制芯片、电源管理芯片等方向展开，与国家顶层设计高度同频，属于国家和地方政府集成电路产业支持的范围，能够获得国家及政府的政策支持。

(2) 项目拥有广阔市场前景及丰富客户资源，产能消化具备可行性

公司从车载充电切入汽车头部厂商，打造了涵盖不同功率等级、支持多种公私协议的全面车载充电产品组合。目前，公司已切入大部分整车厂的供应体系，形成了稳定的合作惯性，正在逐步拓展客户群体，车规认证体系完整，产品逐步处于放量阶段。公司凭借快速迭代和持续创新能力，不断拓展产品品类，目前产品覆盖智能座舱应用领域的升/降压的 DC-DC 芯片、线性电源 LDO、智能负载开关，ADAS 应用场景的电源管理芯片如摄像头、雷达等传感器的电源管理芯片和主控里面的 MCU、SOC 电源管理芯片，车身控制相关的高低边驱动控制芯片、eFuse、马达驱动芯片、带功能安全的电源管理芯片、CAN/LIN 接口芯片等。

本项目将拓展汽车传感芯片、通信芯片、驱动芯片、控制芯片、电源管理芯片等多个方向，开发自有工艺的电源管理产品、高速传输类产品、面向车身控制、

电源系统等领域的 MCU、多模传感芯片等多条产品线。本项目开发的车载电源管理产品可以作为智能驾驶系统等领域的电源管理方案，未来市场前景广阔；开发的车规级 MCU 主要聚焦车身控制、电源管理等领域，是推动汽车智能化和电动化发展的关键组件，其单车用量和价值将大幅提升；车规级传感芯片将在智能汽车的多类型传感器中使用，随着新能源车和智能车的发展未来必将迎来新的市场机遇。此外，高速传输芯片及电源功率芯片等多个产品线也会随着智能汽车在通讯、电控领域需求的增加而大幅增长，未来市场容量可期。

本项目实施后，公司能够导入现有客户资源，逐步拓展产品品类，保障项目产品产能消化的同时提升现有客户的黏性。同时，项目生产的新产品能与公司现有产品形成协同效应，进一步增强公司产品的综合竞争力。

(3) 项目依托公司优秀的研发及工艺开发实力，具备技术可行性

公司已在车载芯片领域深耕多年，在人才、技术、IP 层面、自研工艺等方面有较多积累。在人才方面，公司截至 2025 年末，公司研发人员数量增至 840 人，研发人员数量占公司员工总数的比例为 68.13%；其中车载领域拥有 150 人以上的研发团队，其核心带头人平均拥有十年以上的研发经验。

技术方面，经过多年技术积累，公司已在汽车电子领域拥有 Smart High Side Driver 技术、ASIL-D 电源管理芯片技术等，并通过持续不断的研发迭代积累自身技术优势。此外，公司已拥有部分车规级 IP，可支持汽车电子领域项目的研发。

自研工艺方面，公司采用 FOT 模式与 COT 模式相结合的生产制造模式，拥有从工艺器件开发到 SPICE 模型和 PDK 的全流程自研能力，且已拥有数十人的工艺团队。

本项目依托公司人才优势、技术积累、自主可控的工艺平台和严格的车规级质量控制体系，能够顺利完成项目研发、流片、验证、工艺开发及量产的全流程，降低项目实施风险，确保项目技术可行、风险可控、保障项目产品质量。

4、项目实施和投资概算

本项目建设总投资 84,334.43 万元，具体投资明细如下：

序号	项目	项目资金（万元）	占比
1	建设投资	16,210.08	19.22%
1.1	场地租赁及装修费	3,220.80	3.82%
1.2	设备购置费用	12,217.28	14.49%
1.3	预备费	772.00	0.92%
2	研发费用	60,925.17	72.24%
2.1	人员费用	39,124.80	46.39%
2.2	其他研发费用	21,800.37	25.85%
3	铺底流动资金	7,199.19	8.54%
4	项目总投资	84,334.43	100.00%

5、项目建设进度安排

本项目建设期为 36 个月，项目实施进度安排具体如下：

序号	项目	T+1				T+2	T+3
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1-Q4	Q1-Q4
1	房屋租赁及装修						
2	设备购置与安装调试						
3	人员的招聘与培训						
4	产品研发						
5	产品测试及试产						

6、效益预测的假设条件及主要计算过程

本次募投项目预计所有收入全部来源于产品销售收入，本项目营业收入的测算系以公司或市场同类型产品的销售单价为基准，基于谨慎性原则，完全达产年度预计销售收入为 169,520.00 万元。

本项目的成本主要包括产品的晶圆成本、封测成本，系参考公司或市场同类型产品的采购价格及趋势确定。销售费用、管理费用系参考公司历史费用占比确定，研发费用系根据项目相关人员成本、流片费、测试试制费、折旧摊销费等确定。折旧摊销费用按平均年限法计算，机器设备折旧年限按 5 年计算，残值率为 0.00%；计算机及电子设备按 5 年折旧，残值率 0.00%，装修按 5 年摊销，残值率 0.00%，软件按 3 年摊销，残值率 0.00%。

增值税按照 13% 测算；城市维护建设税、教育费附加税、地方教育附加税分

别按照增值税的 7%、3%、2%进行计提；企业所得税率按 15%测算。

经测算，本项目税后财务内部收益率为 15.42%，项目税后静态投资回收期为 6.69 年（含建设期），具有良好的经济效益。

7、项目备案、环评事项及进展情况

截至本募集说明书摘要出具之日，本项目已完成项目备案手续（项目代码：2512-310115-04-04-567309）；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，本项目无需环评；本项目不涉及新增用地。

（三）工业应用的传感及控制芯片研发及产业化项目

1、项目基本情况

项目名称	工业应用的传感及控制芯片研发及产业化项目
实施主体	上海南芯半导体科技股份有限公司
项目总投资	63,079.74 万元
项目建设期	3 年
项目建设内容	公司拟通过本项目，聚焦工业应用的传感及控制芯片研发，重点开发光学传感器、惯性传感器、磁传感器、高速高精度数字控制器的芯片架构设计，并自研工艺平台，购置测试设备，储备从芯片设计、工艺设计到交付的完整技术能力。本项目将利用公司在模拟电路设计、传感、控制、工艺等领域积累的能力，在减少环境干扰控制、提升算法可靠性方面进一步实现突破，研发高精度、低功耗的传感及控制解决方案。 项目计划在上海浦东租赁场地并购置研发、检测及办公所需相关设备，建设传感器实验室，完善研发软硬件条件。项目将引入研发人才，通过三年左右的研发周期完成新产品的设计、验证，最终实现量产。项目实施后，公司将构建从工艺平台搭建、测试验证到控制优化的深度技术开发能力，可向更高精度要求的工业机器人及各形态的智能传感终端等不同应用领域拓展，为公司业务增长提供助力。同时项目顺应国家顶层设计，为行业发展提供更多技术方案支撑，为加速我国传感及控制芯片的国产替代赋能。
项目建设地点	上海市浦东新区

2、项目必要性分析

（1）提高传感芯片国产化率与技术水平，保障产业链安全

当前，我国传感芯片市场高度依赖进口。核心技术与高端产品供给高度受制于海外企业，各细分领域“卡脖子”问题突出：光传感领域，艾迈斯、博通、威世的环境光、ToF 传感器在工业安全防护、物流智能分拣精密制造检测、车载电子中市场份额较高；惯性传感领域，东电化、博世、意法半导体的六轴/九轴 IMU，

凭借高精度、高可靠性优势几乎垄断高端无人机、工业自动化及汽车电子稳定程序（ESC）、高级辅助驾驶（ADAS）市场；磁传感领域，东电化、英飞凌、埃戈罗的 TMR/AMR 磁阻传感器长期占据高端位置。

国内企业虽已在中低端霍尔开关、简单三轴加速度计等单品上取得突破，但仍在灵敏度、温漂控制、长期稳定性等核心指标上表现不足，与海外高端产品仍存在明显差距，无法满足高端整机厂商的技术要求。导致高端整机厂被迫采用“碎片化”进口模式，需从不同海外厂商采购各类传感芯片，不仅推高了供应链管理成本，更面临地缘政治、贸易摩擦等带来的断供风险，严重制约下游高端制造业的稳定发展。

本项目拟开发具有自主知识产权的磁传感、光传感、惯性传感三大系列芯片及高速高精度数字控制器等产品。填补国产高端传感芯片空白，打破国外垄断，强化智能终端、工业装备产业链安全，项目的实施符合行业发展趋势，契合公司自身发展战略，具有必要性。

（2）传感及控制芯片应用场景持续增加，将成为公司创收的重要抓手

随着汽车电子、人形机器人、低空经济、AI 终端设备与工业互联网等行业的爆发式增长，下游行业对传感器的需求激增，传感芯片的应用场景也随之增加。

光传感芯片作为光电信号转换的核心器件，已成为自动驾驶、消费电子、医疗成像等领域的底层支撑。2025 年全球市场迈入加速扩容与技术裂变的关键阶段。在工业场景中，光传感芯片可用于精确测量光线的各种参数，包括强度、波长等；在自动控制系统中，光学传感芯片可以作为感知元件，实现对光线的自动控制和调节；在光通信系统中，光学传感芯片用于接收和转换光信号，实现信息的传输和交换。2025 年全球光电传感器市场规模预计突破 300 亿美元，中国贡献超 40% 的份额，成为全球最大单一市场。工业自动化、智能家居、新能源汽车三大应用场景驱动需求爆发，其中工业领域占比达 55%。国内市场渗透率从 2020 年的 28% 提升至 2025 年的 42%，政策推动的智能制造升级和“双碳”目标成为核心增长引擎。

惯性传感器目前以 MEMS 惯性传感器为主，可应用于惯性导航、惯性测量、惯性稳控等方面。惯性导航系统一般包含三轴陀螺仪和三轴加速度计，分别测量

三个自由度的角速率和线加速度。惯性导航不借助外源信息，也不向外发送任何信号，可免受外界干扰影响。除独立使用外，惯性导航还可以与卫星导航结合使用，形成组合导航系统。惯性测量系统利用陀螺仪、加速度计等惯性敏感元件和电子计算机测量载体相对于地面运动的角速率和加速度，以确定载体的位置和地球重力场参数的组合系统。目前已被应用于石油测斜、城市测绘、地质监测、寻北仪表等领域。惯性稳控系统通过连续监测系统姿态与位置变化，利用伺服机构动态调整系统姿态，使被稳定对象与设定目标保持相对稳定。根据最新行业数据分析，全球惯性传感器市场正保持稳定增长趋势。2024 年市场规模已达 120.36 亿美元（约合人民币 868 亿元），预计到 2031 年将增长至 175.08 亿美元，期间年复合增长率（CAGR）为 5.5%。

磁传感器主要分为霍尔效应磁传感器和磁阻（xMR）传感器。霍尔效应磁传感器主要利用霍尔效应，即当电流垂直于外磁场通过半导体时，垂直于电流和磁场的方向会产生附加电场，从而在半导体的两端产生电势差，来检测磁场的强度；磁阻传感器主要是在器件内构造薄膜，即给通以电流的材料加以与电流垂直或平行的外磁场，其电阻值会有所增加或减少。通过应用上述物理效应，磁阻传感器能够精确测量电流、位置、方向、角度等物理信号。磁传感器可应用于工业机器人的高精度运动和定位，如用于机械臂运动和控制、服务机器人的导航系统及手术机器人的高精度操控系统中。据 Yole 统计，2023 年全球磁传感器市场为 29 亿美元，预计 2029 年有望增长至 37 亿美元，CAGR 为 4%。其中工业控制是磁传感器最大的应用市场之一，2023 年工业领域磁传感器市场规模分别为 6.1 亿美元，到 2029 年各市场规模有望增长至 8.3 亿美元，2023-2029 年间 CAGR 可达 5%。

智能控制器是为实现特定功能而设计的嵌入式计算机控制单元，广泛应用于工业自动化、医疗设备及智慧建筑等多元化、专业化下游场景中，并形成了相对分散的行业格局。随着 AIoT 技术不断发展，智能控制器产品正持续向高集成度、自适应算法、低功耗设计方向升级，推动行业边界不断扩容。根据 Frost & Sullivan 等机构数据，全球智能控制器市场呈现稳步增长态势，规模从 2015 年的 1.23 万亿美元提升至 2024 年的 1.96 万亿美元，年均复合增长率达 5%。

公司依托本项目的全品类布局，可快速切入上述高成长赛道。项目开发的相

关产品将成为公司下一轮业绩增长的核心引擎与创收的有力抓手。

(3) 储备传感器芯片设计能力，提升公司 MEMS 工艺能力

当前，智能终端、新能源汽车、机器人与低空经济等新兴赛道的兴起，使得传感器市场发展日渐增速，国际龙头企业凭借其领先优势在 IP、专利、生态等方面逐步构建高准入壁垒，留给国内企业的发展窗口期正在收窄。公司长期深耕电源管理芯片领域，是国内领先的芯片设计企业，拥有人才、管理、供应链等优势，具备传感器芯片的研发设计能力，正可趁此机会布局传感器芯片的研发设计，跻身国内领先传感及控制芯片供应商行列。

传感芯片的研发难点主要有：1) 微弱信号的检测——环境噪声比目标信号高百倍以上，需对环境光、声、电磁、震动等进行干扰抑制，从而识别到微弱信号；2) 跨域干扰耦合——高温、振动、电磁场同时作用，温漂、机械应力、EMI 交叉影响，补偿算法与封装协同难度极大。3) 高度集成与低功耗——在毫米级封装层面整合传感、ADC、DSP、接口与安全岛等，功耗降至毫瓦级，同时还需保持高带宽实时响应。

面对以上研发难题，本项目以“储备传感器芯片深度设计能力”为核心目标，通过构建传感器实验室、购置研发及测试设备、搭建工艺设计平台，对光传感、惯性传感、磁传感三条技术路线进行研发，并开发高速高精度控制器芯片。在光传感芯片领域，项目将聚焦于环境光干扰抑制、动态场景算法+相位控制以及平衡功耗方面的研发；惯性传感领域，公司将进一步攻克漂移控制、震动干扰等问题，并实现多传感器融合技术；磁传感芯片领域，项目将主要在电磁干扰抑制、运动算法补偿与误差控制、平衡灵敏度与精度等方面实现提升；高速高精度数字控制器方面，项目将主要攻克实时响应与低延迟、功能安全与可靠性、高算力与能效平衡问题，为前三类传感器提供实时、低延迟、高可靠的技术底座。

该项目的建设，不仅有利于公司突破国外企业对技术的垄断，更重要的是能使公司形成相关技术从芯片设计、工艺设计到交付的完整技术能力，显著提升议价能力与客户黏性。未来面对客户“一站式传感方案”的集采需求，公司可凭借跨品类协同优势快速响应，同时通过自研形成技术组合壁垒，从而在传感器产业链中拥有优势，提升公司的核心竞争力及盈利能力。

3、项目可行性分析

(1) 项目契合国家政策导向，具备政策可行性

中央政府在传感器领域密集出台了一系列支持政策，旨在推动该行业的技术创新和产业升级。2021年12月，国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》强调了提升传感器及其他战略性前瞻性领域的数字技术研发能力，致力于增强核心产业竞争力，特别是在基础软硬件、核心电子元器件等产品的供给水平上，强化关键产品自给保障能力，提升产业链关键环节的竞争力。

2022年6月，工信部等五部门联合发布的《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》指出，要加快关键技术突破，特别是在家用电器和自行车钟表衡器领域的关键技术，如智能物联网技术、健康家电技术、中置电机力矩传感器、动态电子衡器等，以促进轻工业的高质量发展。

2023年1月，工信部等六部门发布的《关于推动能源电子产业发展的指导意见》则聚焦于发展小型化、低功耗、集成化、高灵敏度的敏感元件，以及集成多维度信息采集能力的高端传感器，如新型MEMS传感器和智能传感器，旨在突破微型化、智能化的电声器件和图像传感器件，推动能源电子产业的进步。

2023年10月，工信部发布的《人形机器人创新发展指导意见》提出，要聚焦人形机器人专用传感器，突破视、听、力、嗅等高精度传感关键技术，提升环境综合感知能力。这包括开发高精度仿生视觉传感器、宽频响高灵敏的仿生听觉传感器、高分辨率多点接触检测能力的仿人电子皮肤，以及高灵敏检测多种气体的仿生嗅觉传感器，形成人形机器人专用传感器产品谱系。

2023年8月，工信部等五部门发布的《元宇宙产业创新发展三年行动计划》要求加强关键技术集成创新，突破高端电子元器件，加快图形计算芯片、高端传感器、声学元器件、光学显示器件等基础硬件的研发创新，为元宇宙产业提供坚实的技术支撑。

2023年6月，工信部等五部门发布的《制造业可靠性提升实施意见》则重点提升仪器仪表用控制部件、传感器、源部件、探测器等通用基础零部件的可靠性水平，以提高制造业的整体质量。

2023年12月，国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》

鼓励发展微纳位移传感器、柔性触觉传感器、高分辨率视觉传感器、可加密传感器等具有无线通信功能的低功耗智能传感器，以促进产业结构的优化升级。

项目研发方向涉及传感及控制芯片，是传感器行业的重要组成部分，与国家对于传感器领域发展的支持政策吻合，属于国家和地方政府集成电路产业支持的范围，能够获得国家及政府的政策支持。

(2) 项目市场前景广阔，产能消化具备可行性

根据 Frost & Sullivan 数据，中国传感器市场规模 2024 年为 2,725 亿人民币，预计 2025-2029 年 CAGR 为 18.2%。工业领域传感器市场的发展主要受益于工业自动化、智能化发展的影响，智能工厂产线大规模导入机器人、AGV、检测设备、数控设备等，对各类传感器的需求量大幅增加。在实际生产中，传感器广泛应用于机器人、AGV 等设备的导航和防撞、机械设备的精确控制、设备故障诊断、产线自动检测等场景中，以减少设备故障、排除安全隐患、提升产线效能。因此，伴随智能工厂的进一步升级，传感器应用边界将不断外扩，市场空间同步放大。

根据 Frost & Sullivan 等机构数据，中国智能控制器市场延续强劲增长势头，2016 至 2023 年期间规模从 1.36 万亿元增至 3.42 万亿元，CAGR 达到约 14%，2024 年中国市场规模预计达 3.87 万亿元，同比增长 13.1%，显著高于全球增速，占全球市场份额约为 29%。

下游市场持续放量将为本项目的建设提供广阔的市场空间，助力项目产能消化，因此，本项目的建设具有市场可行性。

另一方面，公司部分原有电源管理产品客户在传感器采购上，仍以国外产品为主导。这使得客户会面临供应链风险、成本压力以及服务响应滞后的问题。公司可依托与部分已有电源管理产品合作的客户进行项目联动合作，快速建立合作信任与对接通道。当前双方在电源项目中已形成成熟的需求沟通、技术适配、交付协作机制，这一既有合作基础能大幅降低传感器产品的市场切入成本，无需从零搭建客户对接体系，可直接基于现有合作链路，同步推进传感器产品的需求调研、样品测试与方案落地，实现“从电源合作到多品类配套”的自然延伸，为项目的产能消化提供可行途径。

(3) 项目依托公司优秀的研发及工艺开发实力，具备技术可行性

公司目前已在传感器赛道拥有研发经验、技术积累及人才储备优势，有助于项目的顺利实施。研发经验方面，公司目前已积累了低精度光学传感器和电源控制器的相关开发经验，相关产品已量产应用于消费级客户，拥有该领域产品研发、流片、验证、试产到量产的完整经验。技术积累方面，公司已拥有传感器的功耗控制与小型化相关的技术储备，并在电源管理芯片领域积累了大量技术。人才方面，公司截至 2025 年末，公司研发人员数量增至 840 人，研发人员数量占公司员工总数的比例为 68.13%。现有传感芯片研发团队具备光传感、惯性传感、磁传感、模数混合相关项目的开发背景。

此外，公司拥有自研工艺平台，可在项目开发过程中实现部分产品的工艺定制，实现核心技术与工艺的完全自研。本项目依托公司人才优势、技术积累、自主可控的工艺平台和严格的质量控制体系，能够顺利完成项目研发、流片、验证、工艺开发及量产的全流程，降低项目实施风险，确保项目技术可行、风险可控、保障项目产品质量。

4、项目实施和投资概算

本项目建设总投资 63,079.74 万元，具体投资明细如下：

序号	项目	项目资金（万元）	占比
1	建设投资	17,232.24	27.32%
1.1	场地租赁及装修费	5,920.80	9.39%
1.2	设备购置费用	10,490.44	16.63%
1.3	预备费	821.00	1.30%
2	研发费用	40,424.43	64.08%
2.1	人员费用	29,594.40	46.92%
2.2	其他研发费用	10,830.03	17.17%
3	铺底流动资金	5,423.07	8.60%
4	项目总投资	63,079.74	100.00%

5、项目建设进度安排

本项目建设期为 36 个月，项目实施进度安排具体如下：

序号	项目	T+1				T+2	T+3
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1-Q4	Q1-Q4
1	房屋租赁及装修						
2	设备购置与安装调试						
3	人员的招聘与培训						
4	产品研发						
5	产品测试及试产						

6、效益预测的假设条件及主要计算过程

本次募投项目预计所有收入全部来源于产品销售收入，本项目营业收入的测算系以公司或市场同类型产品的销售单价为基准，基于谨慎性原则，完全达产年度预计销售收入为 118,610.00 万元。

本项目的成本主要包括产品的晶圆成本、封测成本，系参考公司或市场同类型产品的采购价格及趋势确定。销售费用、管理费用系参考公司历史费用占比确定，研发费用系根据项目相关人员成本、流片费、测试试制费、折旧摊销费等确定。折旧摊销费用按平均年限法计算，机器设备折旧年限按 5 年计算，残值率为 0.00%；计算机及电子设备按 5 年折旧，残值率 0.00%，装修按 5 年摊销，残值率 0.00%，软件按 3 年摊销，残值率 0.00%。

增值税按照 13% 测算；城市维护建设税、教育费附加税、地方教育附加税分别按照增值税的 7%、3%、2% 进行计提；企业所得税率按 15% 测算。

经测算，本项目税后财务内部收益率为 15.64%，项目税后静态投资回收期为 6.64 年（含建设期），具有良好的经济效益。

7、项目备案、环评事项及进展情况

截至本募集说明书摘要出具之日，本项目已完成项目备案手续（项目代码：2512-310115-04-04-303092）；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，本项目无需环评；本项目不涉及新增用地。

三、本次募集资金投资于科技创新领域的说明，以及募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式

（一）本次募集资金主要投向科技创新领域

公司主营业务为模拟与嵌入式芯片的研发、设计和销售。本次募集资金投资项目为智能算力领域电源管理芯片研发及产业化项目、车载芯片研发及产业化项目、工业应用的传感及控制芯片研发及产业化项目，资金投向围绕主营业务进行。

集成电路行业是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。其中，集成电路设计行业属于国家重点支持的科技创新领域，《战略性新兴产业分类（2018）》将集成电路芯片设计及服务认定为“新一代信息技术产业”，《产业结构调整指导目录（2024年本）》将集成电路设计划分为“鼓励类”的信息产业。

智能算力领域电源管理芯片研发及产业化项目将基于公司现有电源管理产品技术，解决大电流场景下多相架构电流均衡、精确移相等技术问题，开发多相控制器、DrMOS、大电流 DC-DC、大电流 PMIC、高压电源等针对大电流应用需求场景的电源管理产品，为 CPU/GPU 等各类大负载芯片/终端提供电源管理方案。项目计划在上海浦东租赁场地并购置研发、检测及办公所需相关设备，引入项目研发所需人员，在三年左右的研发周期内完成新产品的的设计、验证，最终实现量产。项目产品将运用于 PC、数据中心、带边缘计算的智能终端、能源等大电流环境下的多个领域。公司将按照“云、网、边、端”构筑多维度的产品体系，覆盖各类算力应用领域的需求；此外，公司还将开发应用于工业电脑、安防、光伏、储能等多领域的大电流电源管理产品。项目的实施有助于公司抓住市场发展窗口期，拓宽业务范围，提升公司盈利能力。同时，项目的实施也是公司顺应国家政策及行业发展趋势的决策，有助于重塑行业当前竞争格局，推动技术突破。

车载芯片研发及产业化项目将围绕汽车车身系统、座舱系统和智驾系统多领域，布局控制芯片、传感芯片、通信芯片、驱动芯片和电源管理芯片多种功能的芯片，开发自有车规工艺的电源管理产品和整合车规工艺的功率器件产品、高速传输类产品、面向车身控制的 MCU 产品、多模传感芯片及其他产品，助力公司拓宽在汽车芯片领域的产品布局，逐步形成从供电、充电管理到传输、感知、决

策、执行的完整车载芯片生态系统。项目的实施有助于公司把握汽车电动化趋势叠加智能驾驶的技术导入窗口期，扩大市场份额，提升公司在车载芯片领域的市场地位，提升盈利能力。同时，项目顺应政策导向，增强公司在汽车芯片产业方面的技术积累，并助力汽车芯片的国产替代进程加速。

工业应用的传感及控制芯片研发及产业化项目拟聚焦工业应用的传感及控制芯片研发，重点开发光学传感器、惯性传感器、磁传感器、高速高精度数字控制器的芯片架构设计，并自研工艺平台，购置测试设备，储备从芯片设计、工艺设计到交付的完整技术能力。本项目将利用公司在模拟电路设计、传感、控制、工艺等领域积累的能力，在减少环境干扰控制、提升算法可靠性方面进一步实现突破，研发高精度、低功耗的传感及控制解决方案。项目计划在上海浦东租赁场地并购置研发、检测及办公所需相关设备，建设传感器实验室，完善研发软硬件条件。项目将引入研发人才，通过三年左右的研发周期完成新产品的的设计、验证，最终实现量产。项目实施后，公司将构建从工艺平台搭建、测试验证到控制优化的深度技术开发能力，可向更高精度要求的工业机器人及各形态的智能传感终端等不同应用领域拓展，为公司业务增长提供助力。同时项目顺应国家顶层设计，为行业发展提供更多技术方案支撑，为加速我国传感及控制芯片的国产替代赋能。

综上，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务开展，募集资金主要投向属于国家战略及政策重点支持发展的科技创新领域。

（二）本次募投项目促进公司科技创新水平提升

通过本次募投项目的实施，公司拟在智能算力领域电源管理芯片、车载芯片、工业应用的传感及控制芯片加大研发投入，提升公司在该等领域的研发设计及产业化能力，提高核心技术水平和产品竞争力，促进主营业务发展，并促进公司科技创新水平的持续提升。

未来，公司将坚持持续研发和技术创新，不断提升研发创新能力与核心技术水平，推动产品竞争力不断提升。

第六节 备查文件

- 一、发行人最近三年的财务报告及审计报告；
- 二、保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- 三、法律意见书和律师工作报告；
- 四、董事会编制、股东会批准的关于前次募集资金使用情况的报告以及会计师出具的鉴证报告；
- 五、资信评级报告；
- 六、其他与本次发行有关的重要文件。

（本页无正文，为《上海南芯半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》之盖章页）

上海南芯半导体科技股份有限公司

2026年6月16日

